

INTERNATIONAL TECHNOLOGY ROADMAP FOR SEMICONDUCTORS

2009 年版

メトロロジ

THE ITRS IS DEVISED AND INTENDED FOR TECHNOLOGY ASSESSMENT ONLY AND IS WITHOUT REGARD TO ANY COMMERCIAL CONSIDERATIONS PERTAINING TO INDIVIDUAL PRODUCTS OR EQUIPMENT.

訳者まえがき

この文書は International Technology Roadmap for Semiconductors 2009 Edition(国際半導体技術ロードマップ 2009 年版)本文の全訳である。

国際半導体技術ロードマップ(以下 ITRS と表記)は、米国、日本、欧州、韓国、台湾の世界5極の専門家によって編集・作成されている。日本では、半導体技術ロードマップ専門委員会(STRJ)が電子情報技術産業協会(JEITA)内に組織され、日本国内で半導体技術ロードマップについての調査活動を行うとともに、ITRS の編集・作成に貢献している。STRJ 内には 14 のワーキンググループ(WG: Working Group)が組織され、半導体集積回路メーカ、半導体製造装置メーカ、材料メーカ、大学、独立行政法人、コンソーシアなどから専門家が集まり、それぞれの専門分野の調査活動を行っている。

ITRS は改版を重ねるごとにページ数が増え、2009 年版は英文で約 1000 ページの文書となった。このような大部の文書を原文で読み通すことは専門家でも多大な労力を要するし、専門家であっても技術分野が少し異なると ITRS を理解することは必ずしも容易でない。STRJ の専門委員がその専門分野に応じて ITRS を訳出することで、ITRS をより親しみやすいものにすることができるのではないかと考えている。

なお、ITRS 2005 年版(英語の原書)までは、ウェブ公開とともに、印刷された本としても出版していたが、ITRS 2007 年版以降、は印刷コストが大きくなってきたこと、ウェブ上で無料公開されている文書の出版版を本の形で有償頒布しても需要が限られることなどのため、印刷物の形での出版を断念し、ウェブ公開のみとなった。ITRS の読者の皆様にはご不便をおかけするが、ご理解願いたい。ITRS 2009 年版の作成にあたっては、当初から電子媒体で ITRS を公開することを前提に編集を進めた。ITRS の表は原則として、Microsoft Excel のファイルとして作成し、そのまま公開することにした。

ITRS は英語で書かれている。日本語訳の作成は、STRJ 委員が分担してこれにあたり、JEITA の STRJ 担当事務局が全体の取りまとめを行った。訳語については、できる限り統一するように努めたが、なお、統一が取れていないところもある。また、訳者によって、文体が異なるところもある。ITRS の原文自体も多くの専門家による分担執筆であり、そもそも原文の文体も一定していないことも、ご理解いただきたい。誤訳、誤字、脱字などが無いよう、細心の注意をしているが、短期間のうちに訳文を作成しているため、なお間違いが含まれていると思う。また、翻訳の過程で原文のニュアンスが変化してしまうこともある。訳文についてお気づきの点や、ITRS についてのご批判、ご意見などを事務局まで連絡いただけますよう、お願い申し上げます。

今回の訳出にあたっては、ITRS の本文の部分のみとし、ITRS 内の図や表の内部の英文は訳さないでそのまま掲載することとした。Executive Summary の冒頭の謝辞(Acknowledgments)に、ITRS の編集にかかわった方々の氏名が書かれているが、ここも訳出せず、原文のままの表記とした。原文中の略語については、できるかぎり、初出の際に、「ITRS(International Technology Roadmap for Semiconductors)」のように()内に原義を示すようにした。英文の略号をそのまま使わないで技術用語を訳出する際、原語を引用したほうが適切と考えられる場合には、「国際半導体技術ロードマップ(ITRS: International Technology Roadmap for Semiconductors、以下 ITRS と表記)」「国際半導体技術ロードマップ(International Technology Roadmap for Semiconductors)」のように和訳の後に()内に原語やそれに対応する略語を表示した。Executive Summary の用語集(Glossary)も参照されたい。原文の括弧()があつてそれを訳するために括弧を使った場合もあるが、前後の文脈の関係で判別できると思う。また訳注は「【訳者注:この部分は訳者の注釈であることを示す】」のように【】内に表記した。また□内の部分は、訳者が原文にない言葉をおぎなった部分であることを示している。訳文は厳密な逐語訳ではなく、日本語として読んで意味が通りやすいように意識している。ITRS のウェブ版ではハイパーリンクが埋め込まれているが、今回の日本語版ではハイパーリンクは原則として削除した。読者の皆様には不便をおかけするが、ご理解いただければ幸いである。

今回の日本語訳全体の編集は全体のページ数が膨大であるため、大変な作業となってしまいました。編集作業を担当いただいた、JEITA 内 STRJ 事務局の古川昇さん、関口美奈さんに大変お世話になりました。厚くお礼申し上げます。

より多くの方に ITRS をご活用いただきたいとの思いから、今回の翻訳作業を進めました。今後とも ITRS と STRJ へのご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。

2010年5月

訳者一同を代表して

電子情報技術産業協会 (JEITA) 半導体部会 半導体技術ロードマップ専門委員会 (STRJ) 委員長

石内 秀美 (株式会社 東芝)

版權について

ORIGINAL (ENGLISH VERSION) COPYRIGHT © 2009 SEMICONDUCTOR INDUSTRY ASSOCIATION

All rights reserved

ITRS • 2706 Montopolis Drive • Austin, Texas 78741 • 512.356.7687 • <http://public.itrs.net>

Japanese translation by the JEITA, Japan Electronics and Information Technology Industries Association under the license of
the Semiconductor Industry Association

—引用する場合の注意—

原文(英語版)から引用する場合： ITRS 2009 Edition page XX, Figure(Table) YY

この日本語訳から引用する場合： ITRS 2009 Edition (JEITA 訳) XX 頁, 図(表) YY
と明記してください。

問合せ先：

社団法人 電子情報技術産業協会
半導体技術ロードマップ専門委員会 事務局
Tel: 03-5218-1068 mailto: roadmap@jeita.or.jp

TABLE OF CONTENTS

計測(Metrology)	1
概要	3
産業基盤の必要性 (Infrastructure needs)	4
計測で考慮すべきこと(Critical Metrology Considerations)	4
精密さと不確かさ (Precision and Uncertainty)	4
サンプリングの要件 (Sampling Requirement)	5
困難な技術課題	6
顕微鏡観察 (Microscopy)	7
リソグラフィにおける計測 (Lithography Metrology)	9
ラインラフネス (Line Roughness)	12
計測の不確かさ (Measurement Uncertainty)	13
Table MET3、MET4における不確かさの説明	15
FEPにおける計測 (Front End Processes Metrology)	24
配線における計測 (Interconnect Metrology)	33
Cu-Low- κ 膜のメッキ配線問題と計測技術への要求	34
Cuメッキ配線の問題	34
Cuメッキ配線の計測	35
低誘電率(Low- κ)膜の課題と計測要求	37
低誘電率(Low- κ)膜の課題	37
低誘電率(Low- κ)膜の計測	38
材料と汚染の評価・解析	39
標準計測システム	44
標準試料/標準物質	45
統合計測と先端プロセス制御 (APC)	46
新探求材料とデバイスの為の計測	49
3次元原子イメージングと分光法	50
走査プローブ顕微鏡を含む他の顕微鏡の必要性	51
ナノ物質の光学特性	52
新材料とデバイスの為の電気的特性評価	53
参考文献	54

LIST OF FIGURES

Figure MET1	Relations of Time, Tool and Sample Dependent Components of Uncertainty and Bias.....	5
Figure MET2a	Lithography Metrology Potential Solutions: CD.....	23
Figure MET2b	Lithography Metrology Potential Solutions: Overlay	24
Figure MET3	Review of Stress/Strain Measurement Methods	31
Figure MET4	3D Metrology Requirements	32
Figure MET5	FEP Metrology Potential Solutions.....	33
Figure MET6	Interconnect Metrology Potential Solutions	39
Figure MET7	Materials and Contamination Potential Solutions	44

LIST OF TABLES

Table MET1	Metrology Difficult Challenges.....	6
Table MET2	Metrology Technology Requirements	7
Table MET3a	Lithography Metrology (Wafer) Technology Requirements—Near-term Years.....	17
Table MET3b	Patterning Metrology (Wafer) Technology Requirements—Long-term Years	18
Table MET4a	Lithography Metrology (Mask) Technology Requirements: Optical—Near-term Years	19
Table MET4b	Patterning Metrology (Mask) Technology Requirements: Optical—Long-term Years	19
Table MET4c	Lithography Metrology (Mask) Technology Requirements: EUV—Near-term Years.....	21
Table MET4d	Patterning Metrology (Mask) Technology Requirements: EUV—Long-term Years.....	22
Table MET5a	Front End Processes Metrology Technology Requirements—Near-term Years.....	26
Table MET5b	Front End Processes Metrology Technology Requirements—Long-term Years.....	27
Table MET6	Interconnect Metrology Technology Requirements.....	37

計測 (METROLOGY)

計測は測定の科学と定義される。ITRS では、計測ロードマップが“CMOS を延命させたり CMOS 代替デバイスの実用化を加速させたりするために必要とされる計測”の研究・開発方向を示している。計測は半導体技術において日常的にナノエレクトロニクスの領域を扱うようになった最初の分野である。ITRS の活動によって進歩が促された結果、CMOS を延命させるためのプロセスの開発や計測の開発が加速されている。CMOS 以降に向けた材料やデバイスの最新研究から、課題を解決するための新しい戦力が生まれつつある。計測方法は、原子程度の大きさを測ることが当たり前のことになる。収差補正透過電子顕微鏡観察のような材料解析の手法を用いれば単層グラフェンの像を形成することはできるが、ナノメートル程度の精密さでパターン寸法を測ることは難しい。精密さを考える際の手引きとしては、これまでと同じような考え方をを用いることができる。たとえば、形状が名目寸法値の 1/10 ばらつくと、デバイス特性に重大な変動をもたらすことがある。物質の性質の中には原子程度の特定領域に集中していないものがあると云う事実は注目に値する。原子レベルの測定では、ナノスケールの物性や測定に係わる物理を完全に理解していることが必要になる。工場における計測の基本的な課題は、大量生産に適した方法で原子程度の大きさの測定・制御が行えることであろう。

CMOS 以降に向けた計測の中ではグラフェンの像形成と特性解析についての取り組みが目まぐるしく。シリコン上に形成された厚さ 30nm の二酸化シリコンの上に置かれたグラフェン層を観る手段として光学顕微鏡観察法が重要な地位を占め続けている。高分解能の収差補正 TEM を用いることで初めてカーボン原子層の像を形成することができるようになった。収差補正(注: 球面収差の補正)に加えて、電子ビーム損傷を軽減するための低ビームエネルギー (80keV) および色収差を減らすためのモノクロメータと高輝度電子源が採用された; これらの手段を全て使ったとしても、データの解釈には注意深い解析やシミュレーション像との比較が要る。さらに、グラフェンの原子像を観るために原子レベルの解像度を得ようとすると念入りに試料の準備をしなければならない、またデバイスに組み込まれたグラフェン層では原子像を見ることができないかもしれない。ラマン分光法や低エネルギー電子顕微鏡観察法 (LEEM) を用いると多層試料の中のグラフェン層を特定することができる。単電子トランジスタの原理に基づけば走査プローブ顕微鏡を使って電子正孔パドルのような新しい現象を像として観ることができる。低エネルギー電子線回折や電子回折 TEM を用いることでグラフェン層のうねりの情報が得られるようになりつつある。ホール測定の結果、驚くほど高いキャリア移動度が示され半古典的量子力学的輸送理論へのベリー位相補正が観察された。次世代デバイスを開発するために緊急に必要とされると云うことでその他の物質についての計測も進歩している。しかし、孤立した薄膜あるいは表面層を対象とした計測が多く、機能デバイスに組み込まれた物質の計測に使うことができないかもしれない。

計測のお陰で IC の研究・開発・製造が続けられる。測定能力に係る課題は、パターン寸法縮小の速さと新材料や新構造の導入に応えることである。現行の方法で多世代に対応し得る場合もあるし、不十分な装置で測定せざるを得ない場合もある。重ね合わせ測定法や寸法測定法の開発が不完全なままでスペーサ-二重露光のような新しいリソグラフィプロセスが製造に使われた。デバイス設計の先の見通しがはっきりしないことが、上記の課題に加わる。ナノデバイスに向けての長期の研究は、新しい測定方法を提供してくれるうえに、計測にとって絶好の試走車になってくれる。引き続きその場計測やプロセス装置に一体化された計測が製造に導入されて行く。全ての計測は工場規模の自動化システムに接続されており、その自動化システムにはデータベースがあってデータ処理された情報が蓄えられている。オフラインの材料解析も工場規模の自動化システムに接続される方向へと進んでいる。先行的な顕微鏡観察法やプローブ技術は、使い方や得られたデータの解釈について理解ができていない部分はあるにしても、市販品として速やかに手に入れられるようになってきている。新しい材料解析法を上手く使えるか否かは、迅速な前処理法の開発にかかっている。全ての材料解析法が材料開発やプロセス開発にとって欠かせないものである、しかし製造時に必要となる計測を予測することはできない。プロセスの課題がプロセス改良に因って解決しても、“信頼性を保証するために、“製造時に何を測るべきか”という問題が未解決のまま残されている。

基板表面に応力層を設けたりチャネルにプロセス誘起応力を加えたりして移動度を高くすることのようなトランジスタ

2 メトロロジ

特性を制御することの多くが、困難な課題のまま残っている。表面に形成された歪シリコン層の応力や歪みを測定することはできる。しかし、小さなゲートのチャネルのような“ナノサイズかつ埋め込まれた層に加わる応力や歪み”を直接測ることは、もっと難しい仕事になる。透過型電子顕微鏡を用いた破壊測定は断面試料を必要とするし、その断面試料の応力が構造全体の応力を代表しているとは限らない。大抵は、表面にある薄膜あるいは構造の性質を測った結果から、モデルを使って内部の層の性質を決めなければならない。ウェーハ表面での形状測定とモデル化とを組み合わせることで計測することが今後の動向になる。

計測ロードマップでは、“先行的研究・開発と装置メーカーの財政的基盤を固めることの必要性”を何年にもわたり繰り返し述べてきた。計測とプロセス技術開発との関係を根本から再構築しなければならない。かつての課題は、対象とするプロセス技術に先行して計測を開発することであった。今日の問題は、“材料が全く新しくなり デバイス設計が劇的に変わると言うのに、何が選ばれるかを予測できない”という予測の困難さである。“計測データおよび情報”と“最適フィードバック、フィードフォワードプロセス制御および実時間プロセス制御”との相互関係を理解することが、計測とプロセス技術との関係を再構築する際に重要となる。“スピントロニクスや分子エレクトロニクスのような根本的な変化をもたらす新技術に必要とされる計測”の節が、新しく計測ロードマップに書き加えられた。

新しい計測技術は勿論、革新的な計測技術も、“3 年計画で導入される新しい技術世代”に歩調を合わせて研究・開発されなければならない。パターン寸法縮小のロードマップが、新しい材料、プロセスおよび構造に係わる計測の解決予定表を引き延ばしている。SOI や歪みシリコンのような基板材料は、測定をより複雑にする。計測は、これらのことを踏まえて開発されなければならない。計測は、装置開発、試作ラインや新しい生産ラインの垂直立上げ、および生産ラインでの歩留り向上を可能にする。計測は、プロセス装置やプロセスをより正確に評価できることから、“製造コストの削減”や“新製品を市場に投入するまでの時間の短縮”を可能にしてくれる。チップ種類の多様化が進むことは、課題の範囲をさらに広げることになり、すでに限界にある計測研究・開発のリソースを分散させることになる。装置メーカー、半導体メーカー、コンソーシアムおよび研究機関の計測に携わっている人達は、ITRS で示された要求期限に間に合わせるために、協力して研究・開発および装置試作を行わなければならない。開発された最先端の計測技術は、時宜にかなったやり方で製品化されなければならない。パターン寸法と材料は 2003 年 ITRS 以来プロセスおよび材料開発用計測にとっての大きな課題である。

計測の短期的な課題は、“トランジスタ・配線用の新材料・プロセス・構造”および“寸法の比例縮小を制御すること”に係る要求が中心となる。16nm 世代およびそれ以降の技術が確定していないことは、計測技術の開発に大きな影響を与えている。FINFET および その他の新しい構造は、側壁薄膜などのような非常に難しい形状の測定を必要としている。技術世代毎に、数多くの材料が使用候補として考えられており、材料を開発し処理する過程で必要とされる評価や制御を行うために、これら材料の特性を評価することが必須になる。さらに、或る技術世代についてみると、“半導体メーカーに依っては異なった材料が使われる”ということも十分考えられ、異なった計測が必要とされることも有り得る。high-k と low-k 誘電体膜の電気計測および物理計測を今までと同じように短期間で進歩させなければならない。FEP ロードマップで議論されている最も確からしい情報に拠ると、極薄かつ恐らくは絶縁膜上歪シリコンの上に形成されたデバイスの測定技術が必要になる。新しい計測ニーズとして、スクライブライン上のテスト構造の代わりにアクティブエリア上の構造を測定したいとの要求が増えている。16nm 以下の技術世代を対象とする長期的な課題は、デバイス設計や配線技術の動向が明確でないことから、今述べることは難しい。Cu 配線に代る技術の選択は、研究課題のまま残されている。材料評価や現行インライン計測の幾つかは新しいデバイスや配線の構造に使えるけれども、生産に適用可能な計測を開発するためには“材料、デバイスおよび配線構造についての或る程度以上の知識”が必要である。

3 次元配線の計測は新規の緊急課題になっている。ウェーハアライメントおよびボンディングやその他の欠陥の観察には空間分解能の向上が必要である。シリコン貫通ビア(TSV)ではエッチや充填の欠陥を調べなければならない。

あらゆる分野の測定技術(特に“歩留り向上の章”に記載されている測定技術)が、情報に基づいたプロセス制御を

行うために、コンピュータ統合製造(CIM; computer integrated manufacturing)やデータ管理システムと組み合わせられつつある。組込み計測は、未だ普遍的な定義が成されていないけれども、“オフラインからインライン および その場測定への漸進的な移行”を表わす用語である。オフライン、インライン および その場測定を適当に組み合わせて用いることに依り、“最新のプロセス制御(APC)”および“歩留りの垂直立上げ”が可能になる。

計測装置の開発を成功させるためには、“新材料や新構造の計測に使えるようにすること”が必要である。実用化するためには、“必要とされる標準試料の製作”および“生産に先立つ計測方法の開発”に最新の技術・設備を活用できるようにしなければならない。活用するためには、計測技術開発とプロセス開発との関係をより緊密にするための注意が要る。計測がプロセス装置およびプロセスに上手く適合していれば、試作ラインや生産ラインの立上げ期間が短縮される。妥当な CoO(Cost Of Ownership)を維持しながら最大の生産性を得るためには、上手く設計・製作された装置と適切な計測を適当に組み合わせることが必要になる。

概要

2009 年の計測ロードマップに記載されている項目は、顕微鏡観察;パターン寸法(CD;Critical Dimension)と重ね合わせ;膜厚とプロファイル;材料と汚染解析;ドーナツプロファイル;プロセス制御に用いる その場計測用センサとクラスター用計測ステーション;標準試料/標準物質(訳者注:寸法・形状に係わる Reference Materials を標準試料、その他の Reference Materials を標準物質とした);物理測定と電気測定との相関;そしてパッケージング(封止技術)である。これらの話題はこの章の以下の節で述べられる:顕微鏡観察法;リソグラフィ計測;FEP 計測;統計限界に直面しているプロセスおよび原子サイズに近づきつつある物理構造の計測;配線における計測;材料および汚染の評価・解析;組込み計測;基準測定システム(RMS;Reference Measurement Systems)、標準試料/標準物質;および新材料・デバイスの評価・解析と計測。

新しい計測技術および標準(訳者注:国家的あるいは国際的な規格および標準試料/物質)の開発には、国際的な協力が必要になるであろう。計測およびプロセスの研究・開発機関は、装置メーカーおよびICメーカーなどの産業界と共同して動かなければならない。ICメーカーと計測装置メーカーが早い時期から協力することで、“測定装置を最も効果的に使用できるような技術ロードマップ”が作られるであろう。計測・プロセスおよび標準の研究機関、標準の推進組織、計測装置メーカー、および大学で計測に携わる人々は、計測方法の標準化・改善および標準試料/標準物質の製作に関し、引き続き協力して行かねばならない。尺度に関する標準化された定義と手順があるにも拘らず、測定の精密さ対プロセス許容度比(P/T比;Measurement Precision to Tolerance Ratio)のように、尺度を個々に用いることが普通である¹。P/T比は、統計的プロセス制御(SPC;Statistical Process Control)に不可欠な自動測定能力を評価するためのものであり、測定ばらつきすなわち測定の精密さを製造ばらつきと関連付けるものである。測定装置の測定ばらつきは、当該製品あるいは当該プロセスとは無関係の標準試料/標準物質を用いて求められることが多い。したがって、公称測定精度は製品ウェーハを測定する際の装置起因測定ばらつきを反映していないかも知れない。装置感度が不十分なため、“小さいけれども許容することができないプロセス変動”を見逃すことも有り得る。計測装置の分解能を統計的プロセス制御に使用するためには、分解能を正確に表わす尺度が必要である。“測定の精密さ対プロセスの変動し易さの比”の逆数は、信号対雑音比(S/N比)あるいは弁別比と云われることもある。しかしながら、何の分解能かは対象プロセスに依るので(厚さや幅の測定には空間分解能、表面汚染金属のレベル測定には原子パーセントの違いを弁別するための分解能が要ることなど)、分解能の尺度を測定項目毎に定めることが必要になるかも知れない。新しいニーズとして、“計測装置が連続的なデータではなく離散的なデータを出力する場合の測定精度の決め方”を標準化することが挙げられる。このようなことは、例えば、有意差が装置分解能よりも小さい時に起こる。

組込み計測の考え方は、スタンドアローン計測および“センサに基づいた計測(Sensor Based Metrology)”自体にも適用

¹ For example, refer to SEMI E89-0999 “Guide For Measurement System Capability Analysis.”

4 メトロロジ

される。雰囲気温度や湿度の僅かな変動のように 装置校正および測定精度に影響を与える要因は、監視され、計測装置の性能については統計的なプロセス制御を改善するために用いられる。

ウェーハメーカ、プロセス装置メーカ、試作ライン、および新しく立ち上げる生産ラインの夫々で、測定への要求内容および必要時期が異なる。試作ラインでは、より短い期間で立ち上げることが必要であり、試作開始前にプロセス装置やプロセスを十分に評価・把握できるようにしなければならない。しかし、プロセスの完成度が高くなるにつれて、計測の必要性は減小するはずである。デバイス寸法が縮小して行くにつれて、物理計測の課題は重要な電気特性データを与えてくれるインラインでの電気テストと歩調を合わせて行くことになる。

産業基盤の必要性 (INFRASTRUCTURE NEEDS)

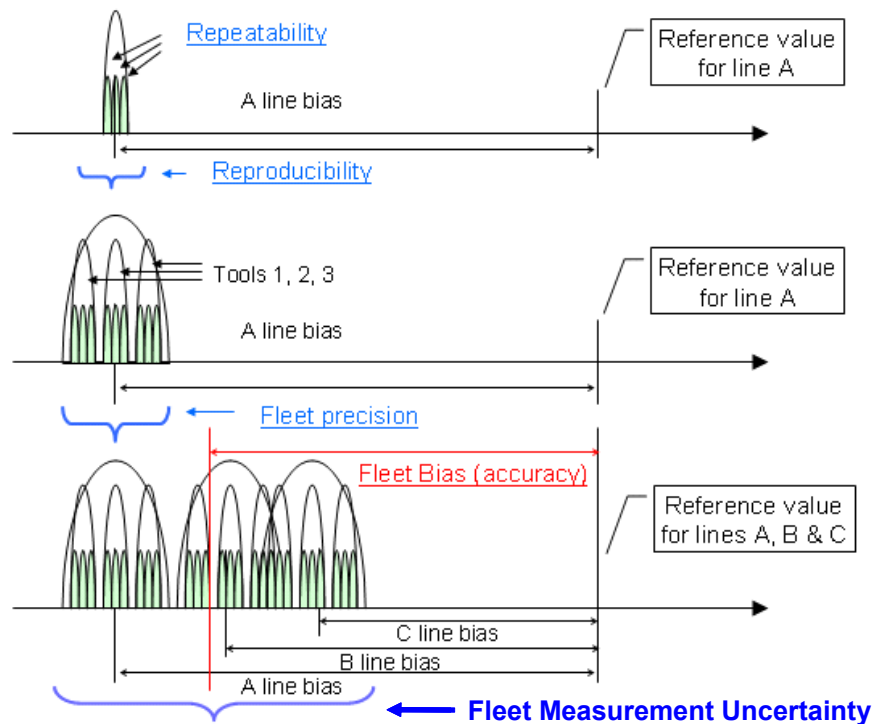
メーカが計測装置、センサ、制御装置、および標準試料／標準物質を合理的な価格で提供しようとするならば、健全な産業基盤が必要となる。MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) を用いた計測やナノテクノロジーのような芽を R&D から製品にまで育て上げようとするならば、新規の研究や開発が必要となるであろう。多くの計測装置メーカは、小さな企業であり、先端的な用途向けに新しい装置を開発するための費用を負担できない。計測装置が当初に売れるのは、装置開発用やプロセス開発用だけである。開発した計測装置が半導体メーカに数多く・継続して売れるようになるまで、数年間を待たねばならない。装置メーカが新しい技術を設計概念の証明から装置試作・製品化を経て数多く売れるようにするまでの投資金額に見合う資金助成が必要である。

計測で考慮すべきこと (CRITICAL METROLOGY CONSIDERATIONS)

精密さと不確かさ (PRECISION AND UNCERTAINTY)

ロードマップ中の数値と測定結果を比較する場合に留意すべき点が幾つかある。比較の妥当性は比較がどのようになされたかに強く依存する。IIRS に記載されている精密さは、従来どおりの解釈²をすると、 3σ で表わされた単に一台の装置での再現性である。しかしながら³、よく調べると、“精密さ”という用語は恐らく“不確かさ”すなわち“話し言葉で誤差範囲と云われる測定誤差”のような広義の用語に置き換えた方が良いように思われる。Figure MET1 に示すように、測定誤差は時間(再現性)、装置(装置間差)および試料(試料間のバイアス変化)の複雑な関数である。したがって、測定の不確かさは測定間・装置間そして試料間の変動成分を含んだ合計のバイアス変化として定義される。これらの成分は装置や使い方に依って重みが変わるかも知れない。これら成分についてのより厳密な定義と吟味は別の書を参考にできる。

バイアスは試料に依存しているので、正確さを標準試料/標準物質を使って正当に評価することはできない。標準試料/標準物質は対象とする製品やプロセスを代表するものではない。詳細については、後述する“標準試料/標準物質”および“標準測定システム”の節を参照されたい。



Special attention should be paid to ensure that optimized sampling plans are used to align test and the reference data (see “Sampling Error” section below).

Figure MET1 Relations of Time, Tool, and Sample Dependent Components of Uncertainty and Bias

サンプリングの要件 (SAMPLING REQUIREMENT)

製造やリソグラフィに係る測定では、測定点数が不十分なことに因って誤差を生じることもある。良い例として、先行的プロセス制御 (APC) を考えてみよう; フィードバックループは、入力データがそのプロセスの正しい統計的な平均値であることを必要とする。異なるパターンを一つずつ測定することは、平均値を高い確度で見積もるのに十分でないかもしれない。逆に、或る場合には、プロセス平均値が非常に重要であるばかりでなく、プロセス変動の情報も必要になる。これらの影響に因る誤差が“標本誤差”である。²

変わり易さということでは、ナノ領域の観察において真に完全な試料というものは無い。集積回路には多くのパターンが含まれており、これらパターンの名目寸法は設計ルール上ぎりぎりの値に決められている; しかし現実には僅かと云えども必ず寸法ばらつきがある。これらパターンを一つずつ測定する CD-SEM 或いは周期的 (格子状) パターンを測定するスキヤトロメータ、これ等の装置は夫々の試料を測定した結果、数値の上で同じ精密さ或いは同じ不確かさを示すかも知れない、しかし試料を変えた時 CD-SEM の測定値はスキヤトロメータの測定値よりも大きく変化するのである。CD-SEM はスキヤトロメータよりもラフネスに対する感度が高いからである。一方の測定装置が他の測定装置よりも不正確だと云うことではない、試料の採り方が違うのである: しばしば“測定限度”の違いと云われる。CD-SEM は形成したラインパターン像の一部を利用してパターン両端の距離を測る、一方スキヤトロメータは格子パターンの広い照射領域から散乱光を集めてそのモデル解から平均寸法を求める。簡単に書けば、装置はプローブサイズが異なることによって異なった物を測ることになる: このことは精密さのみでは量れない。これら試料に因る違いの、もう一つの考え方は、試料がラフネス周期の関数であり CD 変動が“ラフネス周期のフーリエ・パワースペクトル”のように連続体になることである。計測装置が異なるとこのスペクトルに対する感度範囲が異なる; そして、観測される測定変動は装置の感度範囲でパワースペクトルを積分した値になる。スキヤトロメータは非常に大きな周期に比較的敏感であり、CD-SEM は小さな周期および局所的な変

動に対して感度が高い。しかし、注意すべきは、CD-SEMがスキヤトロメータを真似られることである：大きな試料を測るために、一組の大量なデータを平均化することになる。CD-SEMでMFM(Multiple Feature Measurement)を使えば、CDデータを得るための像を大きくできるので、実際のプロセス変動に対する感度を維持しながらより大きなラフネス周期やライン幅変動を測ることができ、得られたプロセス平均値の信頼度が高くなる。⁴

APC を実行する時の手法が異なるとプロセス平均値を見積もる際の誤差が違うために異なった結果が得られる。もし測定点数が十分で無かったとしたら、測定値の変動が大きくなり(すなわちサンプリングノイズが大きくなり)、APC が上手く機能しないかも知れない。与えられたサンプリング計画で如何に測定結果を定量化するかは将来の調査テーマになろう。答えは問題の与え方に大きく依存するであろう。測定目的(相関校正、SPC、プロセス評価)、どの程度の変動が見込まれているか、そしてプロセスの変動およびあるいは平均値についての知識が如何に重要であるかのよう、適用の必要性を理解することが非常に重要となるであろう。より深い議論は別の書を参照されたい。

困難な技術課題

以下に挙げられている“計測に関する短期的課題”の多くは、16nm 技術世代以降も課題として残るであろう。2016 年以降の計測ニーズは、これから明らかとなるであろう新材料および新プロセスの在り方に応じて変わるであろう。従って、将来の計測ニーズの全てを明らかにすることは難しい。パターン寸法を縮小すること、しきい値電圧やリーク電流のようなデバイスパラメータをより厳しく制御すること、そして 3 次元配線のような新しい配線技術は、物理計測技術に大きな挑戦的課題を与えることになるであろう。所望のデバイス・スケーリングを成し遂げるために、計測装置は原子スケールでの特性測定ができなければならない。Table MET1 に、計測の 10 大課題を示す。

Table MET1 Metrology Difficult Challenges

困難な技術課題 ≥ 16nm ノード	問題の内容
実時間その場計測装置、組み込み計測装置、およびインライン計測装置の計測データを工場および会社規模で統合すること;頑丈なセンサ(robust sensors、訳者注:測定精度に余裕があり、環境の変動などに強いセンサ) およびプロセスコントローラの開発;センサの追加が可能なデータ管理。	プロセスコントローラおよびデータ管理の標準規格が必要である。大量な生データを半導体製造の歩留り向上に役立つ情報に転換することが必要である。トレンチエッチング時の終点、およびイオン注入時のイオン種/エネルギー/ドーズ量(電流)を検出するために、より良いセンサの開発が必要である。
SOI のような新しい基板が導入されると、シリコンウェーハの計測や製造での計測に影響を受ける。必要とされる感度でのシリコンウェーハの不純物検出(特に微粒子)およびウェーハ周辺部の検査不能領域の削減。薄い、SOI の光学的性質および電子ビームやイオンビームによる帯電は、CD、膜厚、および欠陥検出に影響を及ぼす。	現在の計測能力では、ロードマップの目標レベルを達成することができない。極微小粒子を検出してサイズ分類しなければならない。SOI ウェーハの計測性能を向上しなければならない。課題は、SOI 構造からの余分な光散乱と表面の品質に因るものである。
二度露光のような新しいプロセス技術、メモリ素子の容量やコンタクト穴のように複雑な 3 次元構造、および 3 次元配線の制御は、素早く立ち上げるための準備ができていない。	二度露光に対する重ね合わせ測定は、より厳しい制御を要求される。重ね合わせが CD を決める。3 次元配線には多くの実現方法がある。新しいプロセスを制御するために必要とされることが明確になっていない。たとえば、容量・デバイス・コンタクトを含めてトレンチ構造には 3 次元(CD と深さ)測定が必要であろう。

複雑な積層材料の測定、および界面における物理的性質や電氣的性質の計測。	制御された薄膜と界面層を含む新 high-k ゲート／容量誘電膜、配線バリアのような薄膜と low-k 誘電膜、およびその他のプロセスニーズに対応する標準試料／標準物質と標準測定方法。ゲートや容量誘電膜の光学的測定結果は広い領域の平均であり、界面層の評価・解析が別に必要になる。歪 Si や SOI 基板あるいはバリア層の測定で積層構造に対するキャリア移動度評価が必要になるだろう。メタルゲートの仕事関数の評価は、もう一つの大きなニーズである。
測定用のテスト構造と標準試料／物質。	特にスクライブラインでテスト構造に割当てられる面積が縮小している。スクライブライン上に置かれたテスト構造ではチップ内の特性変化と相関が取れないという懸念がある。重ね合わせその他のテスト構造はプロセス変化に敏感であり、テスト構造はスクライブライン上とチップ内の対応が取れるように設計を改善する必要がある。標準化機関は最先端の開発・製造ラインを使って標準物質を作ることができるように早急に働きかける必要がある。
困難な技術課題 <16nm	問題の内容
ウェーハおよびマスクに関する 3 次元構造の寸法測定／重ね合わせ精度測定／欠陥検出／解析に使用する非破壊の生産用顕微鏡観察技術。	表面帯電およびコンタミネーションは SEM 像形成時の障害となる。寸法測定ではパターン側壁の形状を考慮しなければならぬ。ダマシンプロセスにおけるトレンチ構造の寸法測定が必要である。ステップの焦点と露光量、エッチバイアス(エッチ後寸法とレジスト寸法の差)などのプロセス制御は高精度化と 3 次元対応が必要である。
チップ内特性を測ることでチップ間やウェーハ間ばらつきを反映できるように新しい計測法を考える必要がある。	デバイス縮小に伴って、テスト構造を変えた場合の特性とチップ内の特性との相関を取るのが難しくなっている。測定試料の採り方を最適化することが、これ等の問題を解く鍵である。
統計変動が顕在化する 32nm ノード以降でのプロセス制御。	自然現象としてのゆらぎが計測を制限する領域では、プロセスを制御することが困難となる。たとえば、低ドーズのイオン注入、薄いゲート絶縁膜、および極微細構造でのエッジラフネスである。
デバイススケールでの構造や組成の解析、および CMOS 以降のデバイスの測定。	界面層制御、ドーパント位置、欠陥、元素濃度に関して、デバイススケールとの対応が取れるような材料評価や計測方法が必要。一例は、3 次元のドーパントプロファイル測定。自己組織化プロセスの測定も必要である。
デバイス構造と配線技術が明確にならない段階で製造における計測を決める必要がある。	現在のトランジスタに代る新デバイス構造や Cu 配線に代る材料が検討されている。

Table MET2

Metrology Technology Requirements

顕微鏡観察 (MICROSCOPY)

顕微鏡観察は、“2 次元分布”すなわち“集積回路 (IC) パターンの形状や外観を示すデジタル画像”が重要な情報を与えてくれるので、核となるプロセス技術の多くに用いられている。通常、“先ず画像形成ありき”ではあるが、画像形成は多くの場合“それを観察し、測り、そして制御することができる”という一連の過程の第 1 段階に過ぎない。顕微鏡は、一般的には光、電子ビーム、あるいは走査プローブを用いる。“画像形成した後測り制御する”というオンラインの応用には、欠陥や微粒子の検出・レビュー・自動分類に加えて、パターン寸法 (CD) や重ね合わせ精度の測定がある。ウェーハが高価かつ多量に要することから、高速、非破壊、インラインでの画像形成・測定の要求が増えつつある。IC パターンのアスペクト比が大きくなりつつあることから、これまでの横方向のパターン寸法(例えば 線幅)の測定に加えて、3 次元形状を詳細測定することの重要性が増しており、インラインで使えるようにすべきである。“先進的なデジタル画像処理・解析技術、遠隔存在 (Telepresence; 訳者注:ここに居るのに、其処に居るよう感じさせること) およびネットワークで結んだ測定装置”を活用する新しい計測方法は、近い将来の IC 技術ニーズに合わせて開発することが必要であろう。これらの技術を用いた顕微鏡観察の技術や測定は、技術者がプロセスをより自動的にやり方で管理できるように、詳細

かつ十分なプロセス情報を逸早く提供するように機能しなければならない。

あらゆる種類の顕微鏡観察法およびそれらに基づく計測では、装置の性能を監視するために、信頼できて操作が容易な方法を開発・提供することが益々重要になってきている。集積回路の構造が小さいためこれらの装置は、最高性能で動作しなければならない、それを達成・維持することは容易でない。現在、十分な性能を保証するためには原始的な方法に頼らざるを得ない。像や測定の実分解能以上に、装置に依存するパラメータも定期的に監視・最適化されることが必要である。これらの重要パラメータは結果に重大な影響を与え、測定不確かさの要因に含めなければならない。

電子顕微鏡観察 — “電子ビームを試料に照射し画像を形成する原理の顕微鏡観察”には、様々な方式がある。走査電子顕微鏡観察、透過電子顕微鏡観察、走査型透過電子顕微鏡観察、電子線ホログラフィ、および低エネルギー電子顕微鏡観察などである。走査電子顕微鏡観察および電子線ホログラフィについては以下に述べる。透過電子顕微鏡観察、走査型透過電子顕微鏡観察、および低エネルギー電子顕微鏡観察については、“材料および汚染の評価・解析”の節で議論する。

走査電子顕微鏡観察 (SEM; Scanning Electron Microscopy) — 断面加工試料の評価・解析、微粒子および欠陥の解析、欠陥像のインライン観察(欠陥レビュー)および CD 測定のために、オフライン(at-line; 訳者注:米国では工場内でのオフライン計測を at-line と云い、ウェーハを工場外に持ち出して行うオフライン計測を offline と云うが、この場合は前者の意味で使用されている)およびインラインの像形成法として使用され続ける。45nm 世代以降も CD 測定および欠陥レビュー(および試作ラインでの欠陥検出)を効果的に行って行くためには、改良が必要である。十分な分解能を保ちながら“試料表面の帯電、コンタミネーション、および照射損傷に起因した像質の劣化”を防ぐためには、超低エネルギー電子ビーム(<250 eV)や高エネルギーSEM(10keV~200keV)を用いるなどの新しいインライン SEM 技術が、必要となるかも知れない。球面収差を低減して分解能を上げようとすると、実用にならないほど焦点深度が浅くなってしまうので、“幾つかの焦点位置で取られた信号を重畳して像形成すること”およびあるいは“ビーム形状を考慮したアルゴリズムを使用すること”が必要になるかも知れない。SEM の分解能を大幅に上げるために、透過電子顕微鏡で用いられていた収差補正レンズ技術が、SEM に転用されるようになった。ナノチップの使用や電子線ホログラフィのような非従来型の像形成技術を開発することが価値のあることとして証明された場合には、その開発を進めなければならない。圧力下すなわち雰囲気制御下での顕微鏡観察は、“高加速電圧での高分解能な像形成および計測”への可能性を開いてくれるもので、新しい代替手法の一つとなり得る。バイナリマスクおよび位相シフトマスクが、この方式の高分解能走査電子顕微鏡で上手く観測された。試料をガス雰囲気中に置くことは、表面帯電やコンタミネーションを低減することが分った。この方法は、ウェーハの検査、像形成、および計測にも高い可能性を持っている。

測定の物理に従い、かつ収集された全ての情報を用いるようなデータ解析法は、独自の方法に比べて優れていることが実証された⁵。“測定された像とモデル化された像”および“速くて正確な比較技術”は、SEMの寸法計測において、重要性を増しつつあるように見える。

CD 測定精度を向上するために、“試料物質と得られたラインプロファイルとの関係について理解を深めること”が望まれる。試料物質の直接電離とゲート構造の帯電に起因した試料損傷が、荷電粒子ビームを用いる全ての顕微鏡の根本的使用限界を決めることになるかも知れない。

90nm 以下のコンタクト/ビアホール、トランジスタのゲート、配線ラインあるいはダマシンの溝と言った構造の実際の 3 次元形状を測るためには、現行の顕微鏡観察および試料作成法を引継いで進歩させることが必要であろう。完全に自動化された FIB(Focused Ion Beam: 収束イオンビーム)による断面加工 および TEM(Transmission Electron Microscope: 透過電子顕微鏡)あるいは STEM(Scanning Transmission Electron Microscope: 走査型透過電子顕微鏡)で像観察するための半自動化されたリフトアウト(訳者注: FIB を用いてウェーハから切り出した試料を顕微鏡の試料台に装填すること)は、効果的であることが実証された。

He イオン顕微鏡観察(HIM) — “細く絞られた電子ビームと試料の相互作用に関連して実効的なプローブサイズが広がること”に係る問題を克服するための手段として提案された。この技術は CD 測定、欠陥レビュー、およびナノテクノロジーに応用できる可能性を持っている。HIM で 1nm 以下の分解能が達成された、しかし試料との相互作用については未だ疑問のままである。

走査プローブ顕微鏡観察(SPM; Scanning Probe Microscopy) — CD-SEM (Critical Dimension Measurement Scanning Electron Microscope) の測定結果の校正に使用されるかも知れない。原子間力顕微鏡 (AFM) のように尖鋭なプローブを用いた SPM は、“被測定試料の材質に影響され難い 3 次元測定”を可能にする。プローブが細過ぎると、プローブ先端のチップ先端部が曲げられて測定精度が悪くなる。したがって、プローブ材質と走査時に受ける力を考慮して、チップ先端部の形状とアスペクト比を妥当な値に設定しなければならない。短いカーボンナノチューブ (訳者注: 炭素原子で構成された径が nm 程度の筒) のような非常に硬いプローブ材料が、この問題を多少とも解消してくれるかも知れない。

遠視野顕微鏡観察(Far-field Optical Microscopy) — 訳者注: 回折光を利用した通常の顕微鏡での観察) — 分解能は光の波長に依って決められる。波長による限界を打破するため、遠紫外光源を用いた顕微鏡および近接場光学顕微鏡 (Near-field Microscopy; 訳者注: 光が波としての性質を発揮できない極微小な領域の光、すなわち近接場光あるいはエバネッセント光を利用する顕微鏡での観察) の開発が進んでいる。自動欠陥分類ソフトの改良が必要である。光学顕微鏡は、今後も引続き、マルチチップモジュールのハンダバンプのような大きなパターンの検査に使われて行くであろう。

欠陥検出技術 — 各技術が極限的問題を抱えている。欠陥は“歩留りを低下させる恐れがある全ての物理的、電気的あるいはパラメータ的な異常”として定義される。現行の SEM や SPM の欠陥検出速度は、光学顕微鏡に取って代わるには余りにも遅すぎる。アレー型 SPM (訳者注: 複数の SPM を配列した SPM) を用いることで高速走査の可能なことが実証されてきた (SEM より速いかも知れない)、しかしプローブチップ先端部の寿命、均一性、特性、および摩滅に係わる問題が処理されねばならない。アレー型 SPM の技術は、並べる SPM の数を増やすことで多様な操作モードを開発することに力を注ぐべきである。アレー型マイクロカラム SEM (訳者注: 複数の超小型鏡筒を配列した SEM) が SEM のスループットを上げるための手法として提案され、単鏡筒のマイクロカラム SEM ではその動作が実証された。静電レンズおよび磁界レンズの設計限界に挑む研究が必要である。

リソグラフィにおける計測 (LITHOGRAPHY METROLOGY)

パターン加工技術の急速な進歩は、リソグラフィ用計測に対して、相変わらず困難な課題を課し続けている。トランジスタのゲート長における変動を正確に制御する取り組みは、マスク計測から始まることになる。マスク上の全ての図形は、露光装置の投影倍率の関係上、ウェーハ上に投影されたレジスト図形の 4 倍の大きさであるが、位相シフトや光近接効果補正のための補助パターンの大きさは、投影されたレジストパターンサイズの半分程度の大きさである。マスクエラーファクター (MEF) が大きければ、マスクプロセスでもタイトなプロセス制御をしなければならないだろう。したがってより正確な計測技術が開発されなければならない。マスク計測には、光の位相が正確に転写したかどうか観察できる計測が含まれる。ウェーハ上に形成されたパターンの CD と重ね合わせ精度の測定もまた、次第に困難な領域に入ってきている。トランジスタのゲート長の CD 制御は、クロックスピードが早くなっている IC 製造においては、依然として重要な要素になっている。プロセス制御と製品の処置判定のための計測技術の必要性が、“計測の不確かさ” (measurement uncertainty) の改善の原動力になり続けてゆく。将来の技術世代のために使用可能な計測技術を提供しようとするならば、CD と重ね合わせズレ計測に対する研究・開発活動を加速することが不可欠である。これら全ての課題に対して、“測定能力の評価方法”を発展させる必要がある。(リソグラフィの章を参照)

従来の顕微鏡ベースのCD計測システムをプロセス制御に応用し、製品上のモニターから、実効的な露光量、フォーカスを計測するに至っている。同様のシステムによって、リソグラフィプロセスのモニター同様にCDや重ね合わせ計測情報を出力することができる。そういった計測のプロセス制御能力と効率性は進歩している。そういった新しい応用を支援する社会基盤も概ね出来上がっている(装置や機能が市販化されている、あるいは機能の改良が可能な状況にある)。例えば、重ね合わせ計測で使用されている従来の光計測システムでも計測できるように、リソグラフィプロセス制御のための実効露光量、フォーカスモニターもまた開発されてきている。同様の能力を有する計測手法としてCD計測に加えて、サイドウォール、高さ計測がスキャトロメトリーで行われようとしている。全てのケースにおいて、プロセス制御のためにCD計測を行うというより、あらゆるパターン(図形)のCDは露光とフォーカスの複雑な関数であり、これらのシステムは、露光量誤差が1%(3 σ)、フォーカス誤差が10nm(3 σ)程度の計測誤差を持つプロセスパラメータそのものを出力することができる。今日のプロセスモニターの能力は、15%の露光量、200nmのフォーカスのプロセス裕度に対して、P/T (precision to tolerance) = 0.1 といった高いレベルにあり、これが大量生産における k_1 ファクタの更なる縮小を可能にし、光リソグラフィを延命している。計測システムの安定化とマッチング精度に対する要求が増大する傾向がある⁷。一方、この領域における活動として、より厳密な制御とマッチング精度を高める開発を目的とした取り組みが始まっている。これらの活動は正確なCD計測の前提であり³、単なるプロセス制御の応用や、専用のプロセスモニターに特化したものではない。

計測能力が高く、効率的な直接プロセスモニター方式のリソグラフィプロセス制御においては、従来のCD計測の技術限界を克服する能力を持っている。現在リソグラフィプロセス制御の手法は変化しているが、この変化を加速するためには、企業間の協力によって、直接プロセス制御の要求項目を明確にし、その制御効果を実証し、新しい計測技術の応用と応用環境の標準化をすることが重要である。こういった変化の結果、優れたCD計測メーカーによって高性能で効率的なプロセス制御の手法が提供され、差別化が行われ、リソグラフィの計測に恩恵をもたらすだろう。しかしながら、特に、校正や先端マスクデザインルール(例: OPC(光近接効果補正)、RET(超解像技)や様々な露光条件においての1、2、3次元のスルーピッチ計測あるいは各種レイアウト計測を通して検証される)が遵守されているかどうかを検証するためのCD計測の領域において、次世代技術の計測要求を満たすには、“絶対的な正確さ”(absolute accuracy)の新たな基準が必要である。

現状必要とされる全ての情報を提供できる単一の計測技術は存在しない。それゆえに様々な次元の計測装置や計測方法に対して、意味のある比較が出来るようにするためには、“繰り返し精度”(repeatability)や“精密さ”(precision)を超えた変数が求められる。それぞれの計測を適用するにあたって、相対精度(CD変動に対する感度と2次的な特徴の変化に対する非感受度)、絶対精度(絶対基準長を辿ることができること)、LERやサンプリング、計測における破壊の性質を考慮することが必要である。

全ての計測装置に対して、計測の不確かさを、その主要な要因の発生を含めて、正確に特徴付けることができれば理想的であろう。計測の不確かさを記述するにあたっては、国際的に認可されている手法の使用が推奨される。こういった知識は、全ての計測機を最大限に活用するのに役立つ。また、計測した結果が必要とされる情報を含んでいないといった状況を回避できる。最後に、一旦計測誤差の主要因が判明すれば、より良い計測装置がすばやく開発される状況が生まれる。そこで、様々な次元の計測機について、計測の不確かさを国際的に認可された方法に従って記述し、その主要因を特定あるいは定量化することを強く推奨したい⁸。

しばしば、製造工程において、特殊なテスト構造を用いたCD計測が行われている。このような場合においては、実素子の寸法は計測されない。CD-SEMは、今後もウェーハあるいはマスク上のラインパターンやビア/コンタクトパターンを計測するのに用いられる。193nmの露光⁹に用いられるフォトレジストの電子ビーム照射ダメージを克服するために、かなりの努力が注がれてきた³。そして、EUVLといった代替リソグラフィ技術が導入される際も同様のことが行われるだろう。積層構造材、表面状態、ラインパターン形状、あるいはラインパターン近傍のレイアウトでさえCD-SEMの2次電子信号波形や、ひいてはその信号波形から抽出されるラインパターンのCDに影響を及ぼす。これらの効果が、正確にモデル化され補正されなければ、CD-SEMの“計測変動”(measurement variation)やトータルの不確かさが増加してしまう。分解能と

“精密さ”(precision)を向上させる電子ビーム光源の開発試験が続けられている。CD-SEMは、SEMを基本原理としたCD計測において、新たな手法が見出せない限り、浅い焦点深度の問題に直面することになるだろう。高加速電圧のCD-SEMや低損失検出器がCD-SEMの延命として提案されている¹⁰。

統計的に確かなSEM計測を実現するためには、適切な種類と量の情報を集めることが不可欠である。必要以上の情報を集めることはスループットの低下につながる。一方、情報が不十分であったり、間違った情報を収集した場合にはプロセス制御を損なってしまう。計測の妥当性を示すと共に、必要な情報を明らかにし、それを表現する計測手法を開発することが大切である。SEM分解能レベルのピクセルを用い、かつ、より広い視野(FOV:Field Of View)を用いることにより、多点計測(MFM:multiple feature measurement)の活用領域を大幅に広げることが出来、単位時間当たりの情報量を増やすことが出来る。これにより、スループット低下を招くことなくサンプリング量が増え、計測結果の有効性が高まる⁴。

CD-SEMとDBM(Design Based Metrology)アプリケーションでは、設計情報を利用した自動レシピ作成を行うことができる。このアプリケーションでは、2次元輪郭線情報の取得とGDSファイルとの比較を通して大規模な設計インテントの検証にSEMを用いることを可能とした。技術世代の進展と共に、リソグラフィでのOPC開発に必要な計測点数は指数関数的に増大すると考えられ、OPCの開発並びに検証のためにはDBMアプリケーションが非常に重要となってきた。また、ダブルパターニングのためのDBMアプリケーションも検討されている。これはDFM(Design For Manufacturing)の領域¹¹とのインターフェースとして中心的な役割を担っている。⁴ また、レティクル上のCD情報を集めウェハ上のCD情報と比較することはいくつかの場合において重要なアプリケーションであり、輪郭線情報と共に用いることにより大きな効果を出すものと予測される。

しかしながら、まだ多くの解決すべき課題が残っている。それらは輪郭線の誤差要因のテスト方法、輪郭線のレファレンス計測、SEM輪郭線のモデリングなどである。^{12 13 14} 輪郭線の信用度は共通の技術課題であり、最新の改善によりこの産業に価値がもたらされる領域である。輪郭線の欠落部あるいは消失部は、試料あるいは計測装置のいずれにも関係する理由により発生し得る。これらは、エッジに平行な方向へ電子線(高速)走査を行った際の微弱な信号(訳者注:二次電子信号)、あるいはその切れ目、また、輪郭線に沿った信号コントラスト変動を主要要因として発生する。それらは下層構造の変動(例えば、側壁角度の変化、再進入(reentrance))や走査型電子顕微鏡(SEM)におけるエッジ近接効果のような装置特有の事由により発生する。

例えば、アクティブエリア上のポリシリコンゲート配線の場合のようないくつかのケースでは、輪郭線の切れ目が自然に発生してしまう。完全な輪郭線を得るといふこの課題は、輪郭線の抽出精度と強い関係がある。輪郭線抽出アルゴリズムは2次元画像処理技術を用いるため、従来のラインスキャン方式による1次元のCD値抽出アルゴリズムとはその機能が異なる。特に、エッジ検出と信号平均化の程度に大きな違いがあることが知られている。また、サンプリングも大きな影響を及ぼす。わずから本輪郭線を平均化した場合であっても、パターンの局所ラフネスの影響は平均化効果により除去されるため輪郭線抽出精度が向上する。これによりSEM画像より抽出された輪郭線とシミュレーション((訳者注:リソグラフィシミュレーション)による輪郭線との一致度も改善される。

効果的なOPCのためには、SEM輪郭線と設計データの位置合わせに関する要求事項にも注意を払っていく必要がある。SEM輪郭線と設計データ間の回転ずれ、位置ずれオフセットを補正する機能、視野歪みを補正する機能がモデルに必要である。これは製造誤差に及ぼす計測精度といった問題に多少なりとも影響する。SEM輪郭線と設計データをマッチングさせる際の計測誤差の許容範囲についてはまだ合意に至っていない。例えば、輪郭線を引き伸ばすことにより除去される一定の倍率誤差はSEM視野内の非線形性ほど問題とはなっていない。

輪郭線計測精度の改善に有効な他の手段として、輪郭線抽出法とモデリングソフトウェアの高度化がある。例えば、輪郭線抽出精度を明らかにするため95%信頼区間を設定する方法がある。最終的な輪郭線計測の指標は、このロードマップ中にもある従来の線幅計測の指標と矛盾しないものとすべきであることを明記しておきたい。

スキヤトロメリーは製造現場に導入され、ラインパターン形状計測に用いられるようになった。スキヤトロメリーには、単一波長―多入射角光散乱測定と、多波長―単一入射角光散乱測定の2方式がある。最近の進歩としては、シミュレーションにより生成したライブラリーを使用しなくとも、CDやラインパターン形状を特定できる精度に到達している。スキヤトロメリーはAPCにおける計測機として用いられることで、トランジスタの主要な電気的特性の分布を、非常にタイトに制御できることが示されている。次の段階は、コンタクトやビア構造に適用できるスキヤトロメリーの開発である。スキヤトロメリーの計測モデルは、ラインパターンや下地の材質の光学的な性質が均一であることを仮定している。表面異常や不均一なドーパント分布はスキヤトロメリーの計測結果に影響を及ぼす可能性がある。それゆえに、スキヤトロメリーのモデルでは、校正や定期的な検証が不可欠である。リソグラフィとエッチングのマイクロローディング効果はラインパターンのCDに顕著な影響を及ぼすだろう。スキヤトロメリーは特殊なテスト構造を用いて計測を行うため、SEM、AFM、あるいはTEMなどの他のCD計測技術を用いて、スキヤトロメリー計測用テスト構造のCDと回路中のパターンのCDとの相関を取る必要がある。スキヤトロメリーは、計測の“精密さ”(precision)を高めると同時に、小さなテスト構造でも計測できるようにする必要がある。ダブルパターニングの使用量が増えると、加工されたパターンの計測において様々な技術課題が発生する。2回に分けて露光されたパターンについて、CD、側壁角、ラフネス、ピッチ(合わせずれ)など、それぞれの分布を別個に計測し制御するが必要となる。いくつかの手法では、反射防止膜(ARC)を用いることによりUV光が下層に侵入するのを防ぐことが出来るかもしれない。

CD計測に関して新たな計測方法の提案がなされており、その計測手法が製造ラインへ最初に導入される機会は22 nm DRAM ハーフピッチの世代となる模様である。32 nm ハーフピッチについては既にデバイス開発段階に入っており、β版の計測装置は、あらゆるプロセス領域で使用できる状況にある。新たに有効な計測の解決策としては、He イオン顕微鏡(顕微鏡の章で議論されている)や小角X線散乱(CD-SAXS; Small Angle X-ray Scattering)が含まれている。CD-SAXSはグレーティング構造の試料にX線を照射し、その透過X線情報を計測することで、測定試料の平均CD、サイドウォールの角度およびラフネス、さらには、グレーティング構造における各ラインのCD線幅のバラツキも計測する能力を有することが示されている。

製品の性能を向上させるために、リソグラフィ計測におけるフィードフォワード制御の概念を広げ、少なくともレジストパターンやマスクパターンの測定データを用い、エッチング等の次工程のプロセス制御を行う仕組みが必要である。フィードバック制御の仕組みも、過去に取得した大量のデータから適切なプロセス制御パラメータを設定するために同様に必要である。CD制御に重ね合わせ精度測定装置を用いることも既に報告されている。この方法は、ラインパターンの幅の変化がフォトリソラインパターンのラインパターンの長さにも影響を及ぼすといった事実に基づいており、このラインパターン長は、光学式の重ね合わせ精度測定装置を用いて測定することができる。この場合、ラインパターン配列とスペースパターン配列を含む特殊なテスト構造が必要である。

CD-AFM計測はラインパターン形状やCD計測、あるいは輪郭線計測の校正に用いることができる。もし、CD-AFMを50 nm以下の密ラインパターン計測に適用するのであれば、新規なプローブチップ技術と3次元傾斜可能なカンチレバーが必要である。フォーカス露光量との相関の調査(特にコンタクトビアホールに対して)に関しては、ラインパターン形状との相関が直接観察できるデュアルカラムのFIB(SEM+FIB)は勿論のこと、前述した全ての方法で行うことが出来る。電子線ホログラフィーも長期的なCD計測技術として提案されている。

ラインラフネス(LINE ROUGHNESS)

ラインエッジラフネス(LER)はリソグラフィプロセスで制御すべき重要な項目であり、ライン幅ラフネス(LWR)はエッチングプロセスにおける重要な制御課題である。リソグラフィの技術ロードマップでは、LERとLWRの測定基準を示している。2001年のLWRに対する要求は、LERとして記載された。LWRはトランジスタの駆動電流との相関は無かったが、リーク電流の増加と相関があったため¹⁵、2001年ITRSに記載された。⁵ LER、LWR計測方法については、SEMIスタンダードとして定義されている¹⁶。以下に示すように、LERの計測精度“精密さ”の要求値は、CDのその数年先に行く値である

ことに留意しなければならない。CD-SEMやリソグラフィプロセスシミュレーションシステムは、LERを計算するソフトウェアを搭載しているが、まだ、すべてのシステムが、LER計測を規定した新しいSEMI標準を遵守しているわけではない。

LER/LWRは2つの方法によって評価される。スペクトル分析とLER/LWRの振幅程度(一般的に、平均位置あるいは平均CDに対する残存成分の 3σ として定義)である。LER/LWRのフーリエスペクトルはR&Dでは一般的になりつつある。しかしながら、実際のインラインパターン計測において、 3σ は依然非常に使い勝手の良い指標である。LER/LWRを評価する際に、検査エッジの長さ(L)とエッジ検出のサンプリング間隔(Δy)は最も重要な計測パラメータである。というのは、 3σ はLと Δy に強く依存するからである。

推奨されているLER/LWRの測定基準は、現在 $2-\mu\text{m}$ のラインパターンに沿って、残存成分の 3σ として定義されている。しかしながらトランジスタの性能は、将来的にゲート内のラフネスに非常に敏感になることも有り得る。そのような場合、ゲート内のラフネスに対して新しい指標(例えば、高周波成分のLWR)が追加定義されるべきであろう。LWR起因のゲートCD変動を分離して評価するためには、低周波数成分のLWRの指標も同様に定義する必要がある。

画像処理を基にしたLWR/LERの計測におけるもう一つの重要な誤差要因は、エッジの検出におけるノイズである。このノイズは、ラフネス計測において+のバイアス(偏差)を発生させる影響をもたらす。これは、 $LWR_{\text{meas}}^2 = LWR_{\text{actual}}^2 + \sigma_e^2$ の式で表現される。 LWR_{meas} は計測値であり、 LWR_{actual} は、被測定パターンの実際のラフネスである。 σ_e はノイズ項であり、所定の計測サンプル点に沿ってエッジ位置を特定するための計測再現性(reproducibility)として定義される。 σ_e の大きさ25nm程度と計測されており、この値は、将来のテクノロジーノ世代において、実際のラフネスの計測値を覆い隠してしまう懸念がある。このノイズ項を除去するための方法論が示されており、これによってラフネスの普遍推定量が求められる。これを用いることは将来のラフネスの計測の“正確さ”(accuracy)を保証するために非常に重要であり、同時にリソグラフィ計測のコミュニティ内でデータの比較を許容するための重要な要素になるべきだと考えている。²⁰ 留意しなければならないこととして、計測装置の分解能がLWR計測要求値に近づくにつれLWR計測自体の課題が大きくなることがある。22nmノードでのLWR計測には1.3nmの分解能を必要とする。この値は、現在のCD-SEMの分解能と同程度である。

計測の不確かさ(MEASUREMENT UNCERTAINTY)

CD計測の性能は、個々の計測装置の計測再現精度(reproducibility)、計測装置間のマッチング精度、計測サンプル間の計測バイアスの変動から生じる計測変動をすべて含んだ“精密さ”(precision)要求を満たしていない。SEMIでは“精密さ”(precision)を計測再現精度(reproducibility)の倍数として定義している。序論で紹介したように、計測再現精度(reproducibility)は、繰り返し精度(repeatability)、ウェーハの再ロードによる変動、長期のドリフトを含んでいる。実際問題、計測再現精度(reproducibility)は、同一サンプル、測定箇所を長期にわたって繰り返し計測することによって決定される。ITRSにおけるCD計測の精度“精密さ”要求には、いつもラインパターン形状と材質の違いの影響が含まれていたが、同一サンプルの繰り返し計測では、サンプル間のバイアスの違いに関連した計測の不確かさは判らない。それゆえに、現状の方法論では、ラインパターン形状や材質、レイアウト、あるいは他の要因の違いに関連した計測の不確かさは“精密さ”(precision)には含まれないことになる。通常CDプロセス制御に用いる標準試料は、それぞれのプロセスレベルで特別に選別された最適なウェーハ、あるいは“golden”ウェーハである。そのようにして、企業での慣例においては、計測の“精密さ”がそれぞれのプロセスレベルの計測再現精度(reproducibility)と決められる。計測のバイアスを検知することはできない。このやり方では、計測の不確かさの成分である計測のバイアスの変動成分を欠くことになる。これに照らして、総合計測不確かさ(TMU)といった新しい計測基準を用いることが出来よう。^{21, 22} 総合計測不確かさは、テクノロジーを代表する一組の試料を用いて決定される。そして、それらの試料はそれぞれの工程に関連した計測バイアスのバラツキを説明できる必要がある。この考え方は、FMP(Fleet Matching Precision)²⁴というもう一つの計測基準を用いて、製造ラインで複数の計測装置を使用する場合にも拡張できる。これらの計測基準は、全ての計測装置の“正確さ”(accuracy)を網羅して

いる。つまり、計測装置群が単一の計測装置に要求されると同様に振舞うことを想定している。また“正確さ”(accuracy)やマッチングに関して他の計測手法も有効であることも留意しておく必要がある。

インラインCD計測機の校正は、注意深く校正用計測機を取り扱うことが必要である。例えば、研究レベルで用いているTEMやCD-AFMは、インラインのCD計測機に相当するか、それ以上の“精密さ”(precision)が無くてはならず、頻繁に校正しなければならない。製造中に用いられる標準試料は、実際のプロセス工程と構造を代表するものでなくてはならない。また、テスト時に計測装置で評価される値は、プロセス変動を適切に反映したものでなくてはならない。この手法に関する報告は既に行われている²⁵。

CD 計測は、ラインパターンの形状制御まで応用されるに至った。傾斜ビーム機構の CD-SEM、ゴールデンウェーハのラインスキャン 2 次電子波形との比較、スキャトロメリー、CD-AFM やデュアルビームの FIB/SEM(電子ビームとガリウムイオンビームの併用システム)、そしてトリプルビームの FIB/SEM(電子ビーム、ガリウムイオンビーム、及びアルゴンイオンビームの併用システム)が、ラインパターン形状計測に応用されてきた。サイドウォールの角度は、重要なプロセス変動要因として提起された。既にフォトレジストのラインパターンは、一枚の平面図形ではサイドウォールを上手く表現できない形状を有している。ラインパターンに沿った LER と LWR、垂直方向の LER、そして丸みを帯びたトップ形状は、プロセス制御において考慮すべき重要なポイントである。前述したように、“精密さ”(precision)の値は各々のプロセス工程毎に変化する。これによってエッチングバイアス(エッチング前後の CD 差)を求めるのが困難になっている。電気的な CD 計測によって、ゲートや配線のラインパターン線幅を観測することが出来るが、これはウェーハの再生処理が不可能な時点に限られ、リアルタイムのプロセスパラメータ補正用途には適用できない。電氣的 CD 計測は、その適用性が導電性材料に限定される。

マスク計測は、現在の光技術では測れない領域に入っている。圧力/雰囲気制御走査電子顕微鏡観察法を用いてバイナリマスクおよび基板掘り込み型位相シフトマスクを調べることが行われ、良い結果が得られた。高分解能、高信号、大きな試料室および試料交換機能と組み合わせての電界放出技術を装備した雰囲気制御走査電子顕微鏡は、マスク CD 計測を行う半導体産業の分野で既に使われるに至っている。圧力制御 SEM の手法は、試料をガス雰囲気中に置くことで、電子ビーム照射に起因した帯電を軽減しようとするものである。この方法は、電荷を中和することに関しては非常に期待が持てるけれども、今までは ホトマスク計測あるいはウェーハ計測に本格的に用いられることがなかった。これは、この分野へのこの技術の 新規な応用であり、“ホトマスクの検査、像形成、および計測を帯電無く行うこと”への大きな期待を抱かせる。この手法は、“ウェーハ計測にも同じ様に適用できる可能性”を持っている。圧力制御 SEM の手法は、正確な計測を行うために帯電をモデル化することの必要性を、全く無くすることはできないにしても、最小にする道を示してくれる。

リソグラフィ計測は、位置ズレや CD 計測のみならず、プロセス制御や、リソグラフィプロセスに必要な材料、例えば、フォトレジスト、位相シフター、反射防止膜等の性質の評価・解析も含まれる。こういったリソグラフィ材料は複雑になって来ており、こういった材料の性質の評価・解析は困難を増している。更に、ウェーハ製造プロセスで使用されるリソグラフィ以外の材料(ゲート酸化膜、金属、Low-k 絶縁膜、SOI 基盤)は間接的にリソグラフィ工程に影響を及ぼしている。というのは、これらの光学的特性は露光波長の光の反射率に影響を及ぼすからである。SOI ウェーハの埋め込み酸化膜のように、通常リソグラフィプロセスに重大な影響を及ぼすとは考えられない層であっても、そのプロセス条件の僅かな変動が、その層の光学的性質に影響を与える場合は、レジスト像の寸法や形状が変化することがありえる。

最低限のこととして、全ての層の露光波長における複素屈折率(屈折率 n と消衰係数 k)を知ることが必要である。このような特性の文献データは、通常、利用できない。すなわち、時代遅れで信頼できないもの(Kramers-Kronig 変換を用いて、材質が確かでない材料を時代遅れな反射率測定法で測定した結果から求められたもの)である。理想の場合には、露光波長での分光エリプソメトリを用い、インラインで n と k を測定することができる。特に、193nm 以下の場合には測定が非常に難しく、通常は技術要員が工場外で測定する。EUV の光学的性質は、特別な光源(シンクロトロンのような

な光源や EUV 露光装置のための EUV 光源)を用いてのみ求められることができる。したがって、実際上は光学の性質を直接測ることができない場合に、材料組成を指標として用いることがある。しかし、同じ組成の物質でも、異なる光学特性を示すことが有り得る(例として、非晶質 Si と結晶 Si の場合が挙げられる)。

表面粗さ、界面層、複屈折すなわち光学の異方性(フォトレジストあるいは他の有機層が応力を受けた時にしばしば観られる)、あるいは“組成が深さに依存して変わる”ことに起因して、光学の性質を求めることが複雑になる。ウェーハプロセスラインで使われる幾つかの材料では、楕円偏向角から光学定数を求めるといふ逆問題を完全には解けないので、材料の光学の性質を求められない。それゆえに、物理的な性質、材料の特性および光学定数が全て相互に関連していることから、光学の性質を求めるには材料の物理的評価・解析をしなければならない。

重ね合わせ精度の測定では、位相シフトマスク(PSM)および光学的近接効果補正マスクが課題であり、異なった層で、異なった露光装置あるいは、露光技術を用いることが困難さを増大させている。画像コントラストが低いことに起因した問題に加えて、今後 重ね合わせ精度測定の要求が厳しくなると、走査プローブ顕微鏡(SPM)と共に、新しい光学的な方法あるいは SEM を用いた方法の開発が必要になるであろう。“従来のターゲット構造では検出できない位相シフトマスクや光学的近接効果補正マスクのアライメント誤差に係わる問題”を解決するための手段として、新しいターゲット構造の必要性が示唆された。オンチップ配線の重ね合わせは、引続いての課題である。平坦化のために化学的機械研磨法(CMP; chemical mechanical polishing)を用いることが、ターゲット構造を劣化させている。したがって、重ね合わせをより厳しく制御しようとする要求に応えるため、配線のアライメントターゲットはラインエッジをでこぼこにしている。絶縁体として使用される Low-k 材料は、特に多孔質の Low-k 材が製造に使われるようになると、重ね合わせを更に難しくする。

DRAM や NVM の先端デバイス適用においては、デバイスのハーフピッチの 20% ないし 25% という劇的に厳しい重ね合わせ基準の制御が必要であり、高加速 SEM やスカットロメトリ技術のような代替計測技術による解決が早期に求められている。しかしながら、これらの技術は、現在成熟とは程遠い状況であり、計測技術の集約の中で解決が必要かもしれない。

EUV リソグラフィに導入には、EUV マスク計測と EUV 空間像計測システム(EUV AIMS: EUV Aerial Image Measurement System)の領域でのさらなる開発進展が必要である。

リソグラフィ計測の要求テーブルは、ウェーハ計測要求(MET3)とマスク計測要求(MET4a, 4b)とに分けられている。マスク計測技術に関する要求テーブル(MET4a, 4b)は、更に、光露光、EUV 露光、そして電子線投影露光といった露光技術毎に分けられている。

TABLE MET3、MET4 における不確かさの説明

に述べた不確かさの概念については、パターンニングの計測の“精密さ”(precision)を考慮して以下に要約されている。“精密さ”(precision)の定義は、その用途に強く依存する。用途と計測機器が与えられた場合、サンプリング方法を定義する必要がある。“精密さ”(precision)の規格は、その用途、計測機器、サンプリング方法に照らして解釈がなされる。用途によって、“正確さ”(accuracy)、単一計測装置の“精密さ”(precision)、マッチングの要求値が定義されることになる。幾つかの用途においては、相対的な“正確さ”(accuracy)や、単一計測装置の“精密さ”(precision)が最優先される。また、ある用途においては、計測装置間のマッチングや単一計測装置の“精密さ”(precision)が最優先される。また他の用途においては、単一の計測結果だけでは必要とされる計測情報を提供するには不十分である。むしろ、複数の計測結果の平均は、計測として重要な意味を持つ。この場合、“精密さ”(precision)は、平均値の不確かさの要求値として解釈されるべきである。表中の“精密さ”(precision)の値は、不確かさの値として変更した。“精密さ”(precision)と“不確かさ”(uncertainty(σ))の関係は式(1)に与えられている。

$$\frac{P}{T} = \frac{6 \cdot \sigma}{UL - LL} \quad 1)$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma_p^2 + \sigma_M^2 + \sigma_S^2 + \sigma_{\text{other}}^2} \quad 2)$$

不確かさ (σ) は次の成分を含んでいる : σ_p (Precision), σ_M (Matching), σ_S (Sampling) と σ_{other} (inaccuracy and other effects)。それぞれの成分は、独立な正規分布であると仮定する。

Table MET3a Lithography Metrology (Wafer) Technology Requirements—Near-term Years

Year of Production	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DRAM 1/2 Pitch (nm) (contacted)	65	57	50	45	40	36	32	28	25
MPU/ASIC Metal 1 (M1) 1/2 Pitch (nm) (contacted)	68	59	52	45	40	36	32	28	25
Flash 1/2 Pitch (nm) (Uncontacted Poly)	54	45	40	36	32	28	25	22	20
MPU Physical Gate Length (nm)	25	22	20	18	16	14	13	11	10
Wafer overlay control (nm)	13	11.4	10	9	8	7.2	6.4	5.6	5
Wafer overlay output metrology uncertainty (nm, 3 σ) * P/T=1	1.1	1	0.9	0.8	0.71	0.64	0.57	0.51	0.45
Wafer CD metrology tool uncertainty (nm) * (P/T=2) for LWR**	0.40	0.36	0.32	0.28	0.26	0.22	0.20	0.18	0.16
Gate									
Printed gate CD control (nm) Uniformity (variance) is 12% of CD Allowed lithography variance=3/4 total variance of physical gate length *	26	23	21	19	17	15	14	12	1
Wafer CD metrology tool uncertainty (nm) * 3 σ at P/T=0.2 for isolated printed and physical lines [A]	0.52	0.46	0.42	0.37	0.33	0.29	0.27	0.23	0.21
Etched Gate Line Width Roughness (nm, 3 σ) <8% of CD**	2	1.8	1.6	1.4	1.3	1.1	1	0.9	0.8
Dense Line									
Wafer dense line CD control (nm) * Uniformity is 13.5% of CD Allowed lithography variance=3/4 total variance	5.6	5.3	4.7	3.7	3.7	3.3	2.6	2.6	2.4
Wafer CD metrology tool uncertainty (nm) * (P/T=2 for dense lines)**	1.26	1.19	1.05	0.84	0.84	0.75	0.58	0.58	0.54
Contacts									
Wafer minimum contact hole (nm, post etch) from lithography tables	64	57	51	45	40	36	32	28	25
Wafer contact CD control (nm) * Uniformity is 15% of CD=minimum contact hole size Allowed lithography variance=2/3 total variance	7.8	7	6.2	5.5	4.9	4.4	3.9	3.4	3.1
Wafer CD metrology tool uncertainty (nm) * (P/T=2 for contacts)***	1.57	1.4	1.25	1.1	0.98	0.88	0.88	0.88	0.88
Aspect Ratio Capability for Trench Structure CD Metrology	15:01	15:01	15:01	15:01	15:01	15:01	20:01	20:01	20:01
Double Patterning Overlay Metrology ****									
Double Exposure and Etch - Process Range (nm)	9.19	8.06	7.07	6.36	5.66	5.09	4.53	3.96	3.54
Double Exposure and Etch - Uncertainty (nm)	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3

Manufacturable solutions exist, and are being optimized

Manufacturable solutions are known

Interim solutions are known

Manufacturable solutions are NOT known

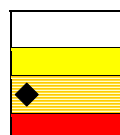


Table MET3b Patterning Metrology (Wafer) Technology Requirements—Long-term Years

Year of Production	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DRAM 1/2 Pitch (nm) (contacted)	22	20	18	16	14	13	11
MPU/ASIC Metal 1 (M1) 1/2 Pitch (nm) (contacted)	22	20	18	16	14	13	11
Flash 1/2 Pitch (nm) (Un-contacted Poly)	18	16	14	13	11	10	9
MPU Physical Gate Length (nm)	9	8	7	6	5.6	5	4.5
Wafer overlay control (nm)	4.4	4	3.6	3.2	2.8		
Wafer overlay output metrology uncertainty (nm, 3σ)* P/T=1	0.4	0.36	0.32	0.28	0.25		
Wafer CD metrology tool uncertainty (nm)* (P/T=2) for LWR**	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	0.00	
Gate							
Printed gate CD control (nm) Uniformity (variance) is 12% of CD Allowed lithography variance=34 total variance of physical gate length*	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6		
Wafer CD metrology tool uncertainty (nm)* 3σ at P/T=0.2 for isolated printed and physical lines [A]	0.19	0.17	0.15	0.12	0.12	0.00	
Etched Gate Line Width Roughness (nm, 3σ) < 8% of CD**	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5		
Dense Line							
Wafer dense line CD control (nm)* Uniformity is 13.5% of CD Allowed lithography variance=34 total variance	1.9	1.9	1.5	1.5	1.1		
Wafer CD metrology tool uncertainty (nm)* (P/T=2 for dense lines**)	0.42	0.42	0.33	0.33	0.26	0.00	
Contacts							
Wafer minimum contact hole (nm, post etch) from lithography tables	23	20	18	16	14		
Wafer contact CD control (nm)* Uniformity is 15% of CD=minimum contact hole size Allowed lithography variance=23 total variance	2.8	2.4	2.2	2	1.7		
Wafer CD metrology tool uncertainty (nm)* (P/T=2 for contacts)***	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	
Aspect Ratio Capability for Trench Structure CD Metrology	20:01	20:01	20:01	20:01	20:01		
Double Patterning Overlay Metrology****							
Double Exposure and Etch-Process Range (nm)	3.11	2.83	2.55	2.26	1.98	0.00	0.00
Double Exposure and Etch-Uncertainty (nm)	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0

Table MET3a と b の注:

*全ての“不確かさ”(uncertainty)の値は、単位nmの3σで表わされており、本文中に記載の通り、単一装置の“精密さ”(precision)、計測装置間のマッチング、他の成分を含んでいる。“精密さ”(precision)の要求値はCDのトップ、中間、ボトムが含まれる。詳細な情報は不確かさの章を参照されたい。

**リソグラフィのロードマップはラインエッジラフネスからライン幅ラフネスに変更となった。SEMI 標準を参照されたい。

LER—“技術世代の寸法の2倍に等しい空間波長”以上の距離にわたって測られた局所的なラインエッジのばらつき(3σ合計、全周波数成分含む、両エッジ)。LWRは、相関関係の無いラインエッジラフネス毎に、 $LWR=\sqrt{2} \times (LER)$ のように定義される。

***コンタクトパターンのボトムCDは、現状FIBの計測を必要とする。

****キャリア構造やスパーサー方式の2重露光は、キャリアおよびスパーサーは標準的なゲートプロセスの範囲であり、同様のCD制御性を有している。最良のシナリオは、A、Bの2つのマスクをX1に対して位置合わせを行う場合である。最悪のシナリオは、AをX1に合わせてBをAに合わせる場合である。この件についてはここでは述べられていない。プロセスの範囲も単一装置の重ね合わせに準じるであろう。本件は未解決の問題である。

Manufacturable solutions exist, and are being optimized

Manufacturable solutions are known

Interim solutions are known

Manufacturable solutions are NOT known

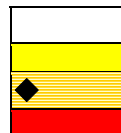


Table MET4a Lithography Metrology (Mask) Technology Requirements: Optical—Near-term Years

Year of Production	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DRAM 1/2 Pitch (nm) (contacted)	65	57	50	45	40	36	32	28	25
MPU/ASIC Metal 1 (M1) 1/2 Pitch (nm) (contacted)	68	59	52	45	40	36	32	28	25
MPU gate in resist (nm)	42	38	34	30	27	24	21	19	17
MPU Physical Gate Length (nm)	25	22	20	18	16	14	13	11	10
Flash 1/2 Pitch (nm) (Un-contacted Poly)	54	45	40	36	32	28	25	22	20
DRAM Flash CD control (3 sigma) (nm)	66	59	53	47	42	37	33	3	26
CD uniformity (nm, 3 sigma) isolated lines [H]	3	26	24	22	19	17	16	13	12
Wafer overlay control (nm)	11	10	9	8	7	6	6	5	5
Wafer contact CD control (nm)*; Uniformity is 13.5% of CD = minimum contact hole size; Allowed lithography variance = 3/4 total variance	7.5	6.6	5.9	5.3	4.7	4.2	3.7	3.3	3
Mask nominal image size (nm) [B]	170	151	135	120	107	95	85	76	67
Mask minimum primary feature size [D]	119	106	94	84	75	67	59	53	47
Optical Section									
Minimum OPC size (opaque at 4x, nm) [D]	70	64	56						
Image placement (nm, multi-point) [F]	7	6.1	5.4	4.8	4.3	3.8	3.4	3	2.7
Dual Patterning image Placement (nm) [F]	4.9	4.3	3.8	3.4	3.0	2.7	2.4	2.1	1.9
Difference in CD mean-to-target for two masks as a dual patterning set	2.6			1.8		1.3			
CD uniformity allocation to mask (assumption)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
MEEF isolated lines [G]	1.6	1.8	2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
MEEF dense lines [G]	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
MEEF contacts [G]	3.5	4	4	4	4	4	4	4	4
Mask CD uniformity (nm, 3 sigma) isolated lines [H]	2.6	2	1.7	1.4	1.2	1.1	1	0.8	0.8
Mask CD uniformity (nm, 3 sigma) dense lines [J]	4.8	4.3	3.8	3.4	3	2.7	2.4	2.1	1.9
Mask contact CD control (nm)*; Uniformity is 12% of CD = minimum contact hole size; Allowed lithography variance = 3/4 total variance	3	2.4	2.1	1.9	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1
Mask image placement metrology uncertainty, P/T=0.1	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3		
Mask CD uncertainty (nm, 3 sigma) isolated lines, [H] (P/T=0.2 for isolated lines, binary)**	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Mask CD uncertainty (nm, 3 sigma) dense lines [J]	0.96	0.86	0.77	0.68	0.61	0.54	0.48	0.43	0.38
Mask contact CD uncertainty (nm)*; Uniformity is 12% of CD = minimum contact hole size; Allowed lithography variance = 3/4 total variance	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
Specific Requirements (all PSM, all PSM)									
Alternated PSM phase mean deviation	1	1	1	1	1	1	1		
Phase metrology uncertainty, P/T=0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
Attenuated PSM phase mean deviation from 180° (±degree) [S]	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Phase uniformity metrology uncertainty, P/T=0.2*	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

*全ての「不確かさ」(uncertainty)の値は、単位nmの3σで表わされており、本文中に記載の通り、単一装置の「精密さ」(precision)、計測装置間のマッチング、他の成分を含んでいる。「精密さ」(precision)の要求値はCDのトップ、中間、ボトムが含まれる。

Table MET4b Patterning Metrology (Mask) Technology Requirements: Optical—Long-term Years

Optical Masks not part of potential solutions beyond 22nm, grey-colored cells indicate the transition.

Year of Production	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DRAM 1/2 Pitch (nm) (contacted)	22	20	18	16	14	13	11
MPU/ASIC Metal 1 (M1) 1/2 Pitch (nm) (contacted)	22	20	18	16	14	13	11
MPU gate in resist (nm)	15	13	12	11	9	8.4	7.5
MPU Physical Gate Length (nm)	9	8	7	6	5.6	5	4.5
Flash 1/2 Pitch (nm) (Un-contacted Poly)	18	16	14	13	11	10	9
DRAM/Flash CD control (3sigma) (nm)	23	21	19	17	15		
CD uniformity (nm, 3 sigma) isolated lines [H]	1.1	1	0.8	0.7	0.7		
Wafer overlay control (nm)	4	4	3	3	3		
Wafer contact CD control (nm)*, Uniformity is 13.5% of CD=minimum contact hole size. Allowed lithography variance=3/4 total variance	26	23	21	19	17		
Mask nominal image size (nm) [B]	60	54	48	42	38		
Mask minimum primary feature size [D]	42	37	33	30	26		
Optical Section							
Minimum OPC size (opaque at 4x, nm) [D]							
Image placement (nm, multi-point) [F]	24	21	19	1.7	1.5		
Dual Patterning image Placement (nm) [F]	1.7						
Difference in CD mean to target for two masks as a dual patterning set							
CD uniformity allocation to mask (assumption)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		
MEEF isolated lines [G]	22	22	22	22	22		
MEEF dense lines [G]	22	22	22	22	22		
MEEF contacts [G]	4	4	4	4	4		
Mask CD uniformity (nm, 3 sigma) isolated lines [H]	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5		
Mask CD uniformity (nm, 3 sigma) dense lines [J]	1.7	1.5	1.4	1.2	1.1		
Mask contact CD control (nm)*, Uniformity is 12% of CD=minimum contact hole size. Allowed lithography variance=3/4 total variance	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6		
Mask image placement metrology uncertainty, P/T=0.1							
Mask CD uncertainty (nm, 3 sigma) isolated lines, [H] (P/T=0.2 for isolated lines, binary*)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
Mask CD uncertainty (nm, 3 sigma) dense lines [J]	0.34	0.3	0.27	0.24	0.21		
Mask contact CD uncertainty (nm)*, Uniformity is 12% of CD=minimum contact hole size. Allowed lithography variance=3/4 total variance	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1		
Specific Requirements (altPSM, attPSM)							
Attenuated PSM phase mean deviation							
Phase metrology uncertainty, P/T=0.2							
Attenuated PSM phase mean deviation from 180° (±degree) [S]	3						
Phase uniformity metrology uncertainty, P/T=0.2*	0.6						

*全ての「不確かさ」(uncertainty)の値は、単位 nm の 3σ で表わされており、本文中に記載の通り、単一装置の「精密さ」(precision)、計測装置間のマッチング、他の成分を含んでいる。「精密さ」(precision)の要求値はCDのトップ、中間、ボトムが含まれる。

Manufacturable solutions exist, and are being optimized
 Manufacturable solutions are known
 Interim solutions are known
 Manufacturable solutions are NOT known

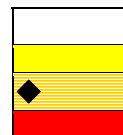


Table MET4aとbの注:

[A] 短期の表で、孤立ラインの CD 測定に付されているオレンジ色の指定は、ロードマップ活動の成果である。パターン加工精度(process range)および“精密さ(precision)に装置マッチングを含めること”が要求値の達成を非常に困難なものとしている。孤立ラインの CD 測定では、1 台の装置だけを使うことによって装置マッチングを考えなくても良いようにし、上の問題を回避している。長期的には、既知の方法の延長では 25nm 線幅の CD 測定を行えないかも知れないので、技術的なブレークスルーを必要とする。

[B] 公称マスクパターン寸法—ウェーハ上に形成された最小レジストパターンの寸法の 4 倍(マスク縮小比)になる。

[C] 最小主マスクパターン寸法—CD 設定/欠陥制御のために OPC を適用した後の転写可能な最小マスクパターンの寸法。

[D] OPC マスクパターン寸法—転写されない最小マスクパターンの最小幅

[E] 孤立ゲートに対する“リソグラフィでの CD 加工ばらつき(process range)”は、全 CD 加工ばらつき(3 σ で CD の 1/10)の 4/5 である。密なライン群に対しては CD の 15%の 4/5 であり、コンタクト/ビアホールに対しては CD の 15%の 2/3 になる。加工精度は変化するものである。リソグラフィ加工ばらつきに占めるマスクの割合が全リソグラフィ加工ばらつきの 40%を占めるということは、注目すべきことである。マスク誤差係数(MEF)は CD の加工裕度を小さくし、マスクの占める加工ばらつき分を MEF で割った値がマスクでのばらつきとなる。

[F] バイナリマスクの孤立ラインに対するマスク誤差係数は、65nm 技術ノードでは、1.4 から 1.6 の間にある。

[G] 値は、バイナリとハーフトーンマスクの場合である。レベニン型位相シフトマスクのマスク誤差係数は 1 である。

[H] 密なライン群に対するマスク誤差係数は、70nm から 100nm 技術ノードで 2 であり、65nm 技術ノードで 2.5、57nm および 50nm 技術ノードでは 3 になる。表中の値は、バイナリとハーフトーンマスクを用いた場合である。

[I] コンタクト/ビアホールに対するマスク誤差係数は、70nm から 100nm 技術ノードで 3 であり、65nm 技術ノードで 3.5、57nm および 50nm 技術ノードでは 4 になる。

[J] 値は、バイナリとハーフトーンマスクの場合である。

Table MET4c Lithography Metrology (Mask) Technology Requirements: EUV—Near-term Years

Before 22 nm; grey-colored cells indicate the transition to EUV technology:

Year of Production	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DRAM 1/2 Pitch (nm) (contacted)	65	57	50	45	40	36	32	28	25
MPU/ASIC Metal 1 (M1) 1/2 Pitch (nm) (contacted)	68	59	52	45	40	36	32	28	25
MPU Physical Gate Length (nm)	25	22	20	18	16	14	13	11	10
Flash 1/2 Pitch (nm) (Un-contacted Poly)		45	40	36	32	28	25	22	20
Image placement error (nm, multipoint)		6.1	5.4	4.8	4.3	3.8	3.4	3	2.7
CD Uniformity (3 sigma at 4x nm)									
Isolated lines, Uniformity is 10% of CD, MEEF varies with year		3.4	3	2.7	2.4	2.1	1.9	1.7	1.5
Dense lines, Uniformity is 15% of CD, MEEF varies with year		8.2	7.3	6.5	5.8	5.2	4.6	4.1	3.7
Contact/Vias, Uniformity is 10% of CD, MEEF varies with year		7.6	6.8	4.8	4.3	3.8	3.4	3	2.7
Mask CD metrology tool uncertainty isolated lines*, **		0.68	0.61	0.54	0.48	0.43	0.38	0.34	0.3
Mask CD metrology tool uncertainty dense lines*, **		1.6	1.5	1.3	1.2	1	0.92	0.82	0.73
Mask CD metrology tool uncertainty contacts*, **		1.5	1.4	1	0.86	0.76	0.68	0.61	0.54
Specific EUV Requirements									
Mean peak reflectivity		65%	66%	66%	66%	67%	67%	67%	67%
Peak reflectivity uniformity (3 σ %)		0.69%	0.58%	0.47%	0.42%	0.37%	0.33%	0.29%	0.26%
Absorber sidewall angle tolerance (degrees)		1	1	0.75	0.69	0.62	0.5	0.5	0.5
Absorber LER (3 sigma, nm)		32	28	25	22	2	1.8	1.6	1.4
Mask substrate flatness (peak-to-valley, nm)		75	60	50	41	36	32	29	26
Metrology mean peak reflectivity uncertainty (P/T=0.2, %)		1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%
Peak reflectivity uniformity metrology uncertainty (3 σ , P/T=0.2)		0.14%	0.12%	0.09%	0.08%	0.07%	0.07%	0.06%	0.05%
Absorber sidewall angle metrology uncertainty (degrees 3 σ , P/T=0.2)		0.2	0.2	0.15	0.14	0.12	0.1	0.1	0.1
Absorber LER metrology uncertainty (3 σ , P/T=0.2)		0.64	0.57	0.5	0.45	0.4	0.36	0.32	0.28
Mask substrate flatness metrology uncertainty (nm 3 σ , P/T=0.2)		15	12	10	8.2	7.3	6.5	5.8	5.1

*全ての不確かさ(uncertainty)の値は、単位 nm の 3 σ で表わされており、計測装置間のマッチング、他の成分を含んでいる。

**計測装置の性能は、測定試料の形状、材料や密度とは独立である必要がある。詳細な情報は不確かさの章を参照されたい。

Table MET4d Patterning Metrology (Mask) Technology Requirements: EUV—Long-term Years

Grey cells indicate transition years of technologies.

Year of Production	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DRAM 1/2 Pitch (nm) (contacted)	22	20	18	16	14	13	11
MPU/ASIC Metal 1 (M1) 1/2 Pitch (nm) (contacted)	22	20	18	16	14	13	11
MPU Physical Gate Length (nm)	9	8	7	6	5.6	5	4.5
Flash 1/2 Pitch (nm) (Un-contacted Poly)	18	16	14	13	11	10	9
Image placement error (nm, multipoint)	24	21	19	17	15		
CD Uniformity (3 sigma at 4x nm)							
Isolated lines, Uniformity is 10% of CD, MEEF varies with year	1.3	1.2	1.1	1	0.9		
Dense lines, Uniformity is 15% of CD, MEEF varies with year	3.3	2.9	2.6	2.3	2.1		
Contact Vias, Uniformity is 10% of CD, MEEF varies with year	1.8	1.6	1.4	1.3	1.1		
Mask CD metrology tool uncertainty isolated lines*, **	0.27	0.24	0.21	0.19	0.17		
Mask CD metrology tool uncertainty dense lines*, **	0.65	0.58	0.52	0.46	0.41		
Mask CD metrology tool uncertainty contacts*, **	0.36	0.32	0.29	0.26	0.23		
Specific EUV Requirements							
Mean peak reflectivity	67%	67%	67%	67%	67%		
Peak reflectivity uniformity (3σ%)	0.23%	0.21%	0.19%	0.17%	0.15%		
Absorber sidewall angle tolerance (degrees)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
Absorber LER (3 sigma, nm)	1.3	1.1	1	0.9	0.8		
Mask substrate flatness (peak-to-valley, nm)	23	20	18	16	14		
Metrology mean peak reflectivity uncertainty (P/T=0.2, %)	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%		
Peak reflectivity uniformity metrology uncertainty (3σ, P/T=0.2)	0.05%	0.04%	0.04%	0.03%	0.03%		
Absorber sidewall angle metrology uncertainty (degrees 3σ, P/T=0.2)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
Absorber LER metrology uncertainty (3σ, P/T=0.2)	0.25	0.22	0.2	0.18	0.16		
Mask substrate flatness metrology uncertainty (nm 3σ, P/T=0.2)	4.6	4.1	3.6	3.2	2.9		

*全ての不確かさ(uncertainty)の値は、単位 nm の 3σ で表わされており、計測装置間のマッチング、他の成分を含んでいる。

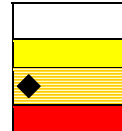
**計測装置の性能は、測定試料の形状、材料や密度とは独立である必要がある。詳細な情報は不確かさの章を参照されたい。

Manufacturable solutions exist, and are being optimized

Manufacturable solutions are known

Interim solutions are known

Manufacturable solutions are NOT known



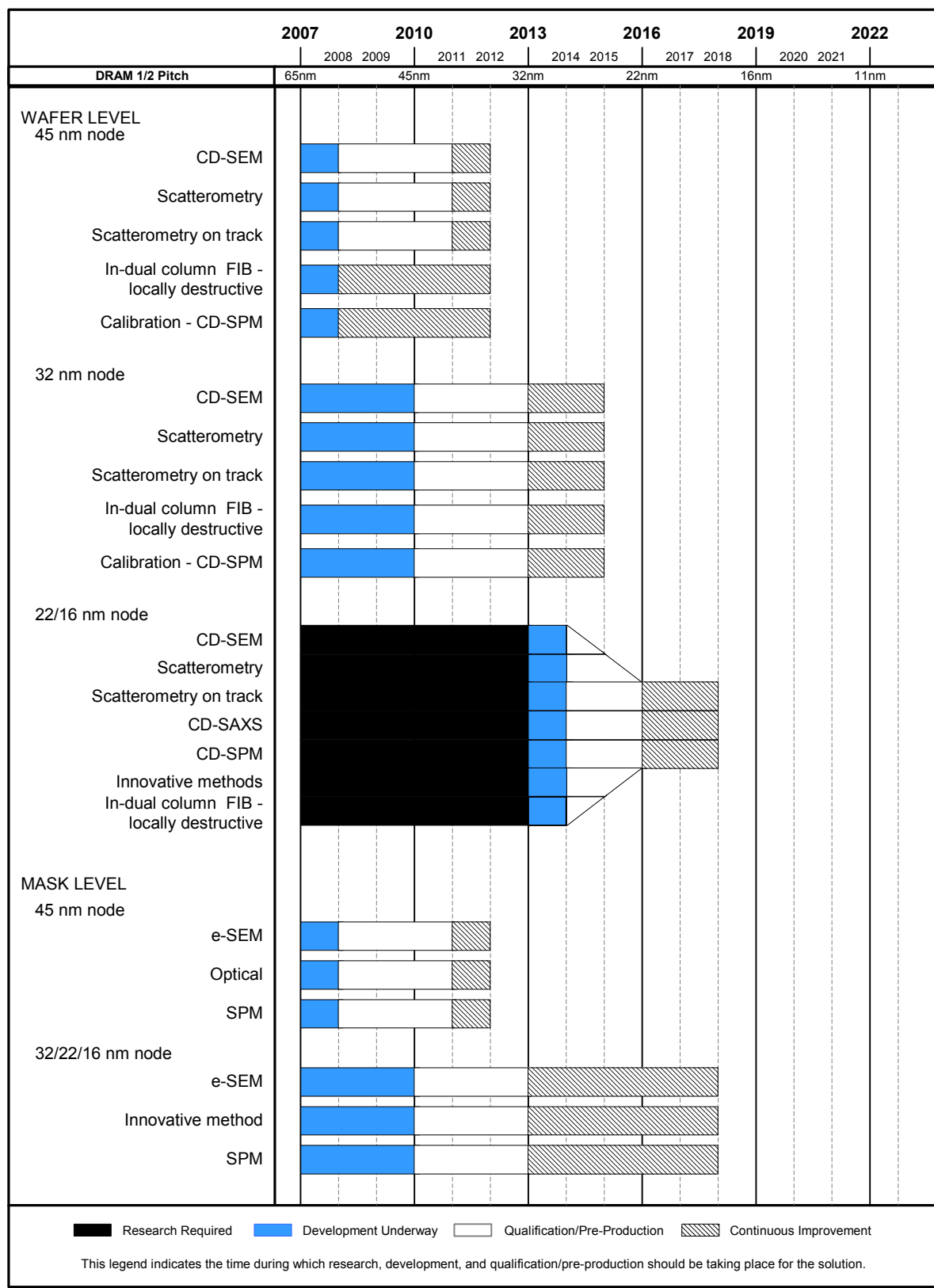


Figure MET2a Lithography Metrology Potential Solutions: CD

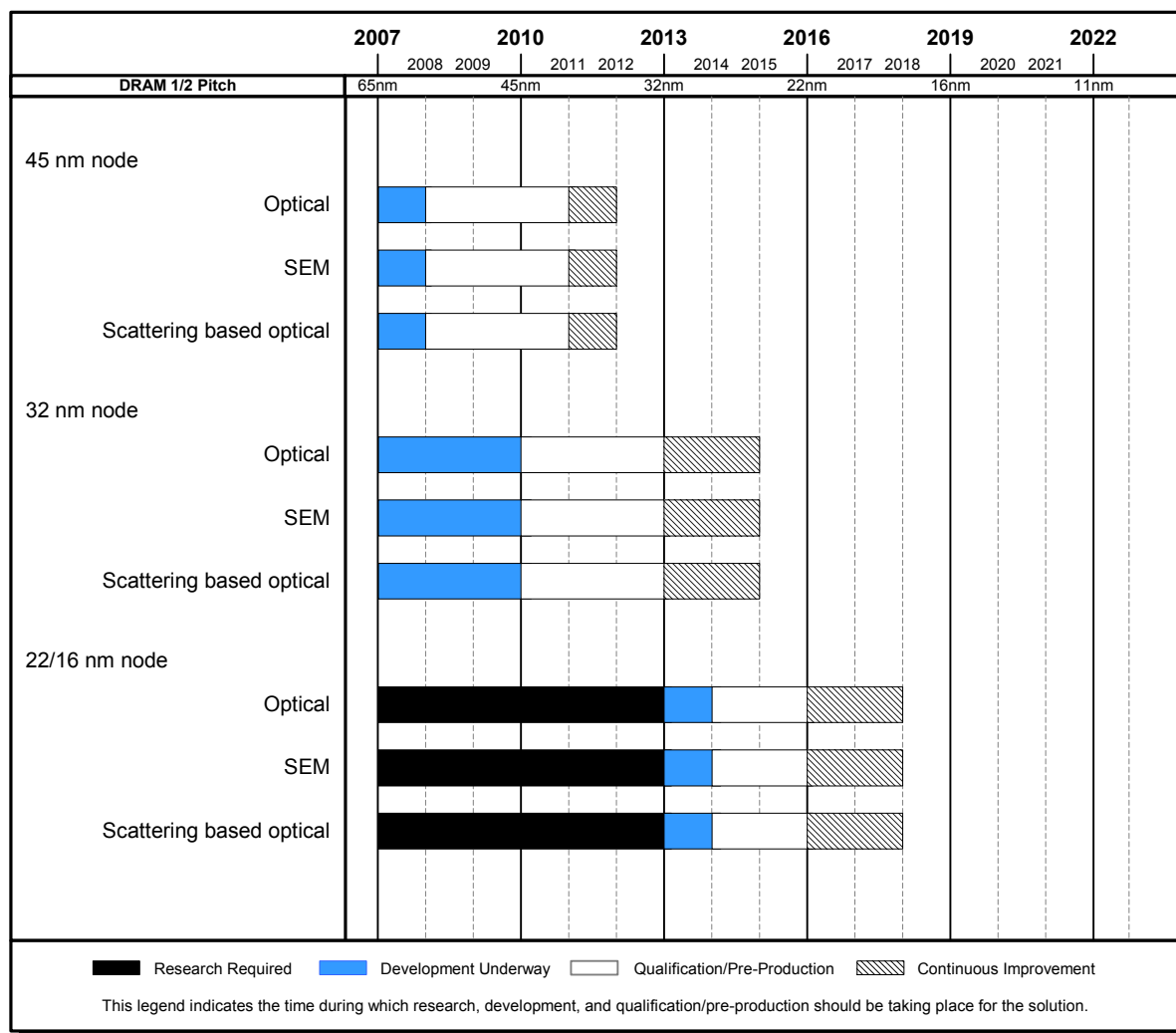


Figure MET2b Lithography Metrology Potential Solutions: Overlay

FEP における計測 (FRONT END PROCESSES METROLOGY)

半導体産業は CMOS 技術を拡張する手段を見出そうと続けている。FEP のロードマップには、プレーナー型の CMOS 技術が、近い将来も継続して主要なトランジスタであることが示されている。極薄構造の SOI によって、プレーナー型の CMOS 技術が拡張することが期待されている。FINFET の様な3次元のトランジスタ構造は研究開発の段階にあり、試験が繰り返されている。高誘電率ゲート酸化膜やメタルゲートは少なくとも1社によって量産されていることが知られているが、他社においては研究開発が継続されている状況である。ハーフピッチのトレンドが微細化するにつれ、高誘電率材料の進歩が要求されている。局所的にチャンネルにストレスを掛けることで電子や、正孔の移動度を高める技術は、トランジスタを継続してスケーリングする主要な手段である。将来的には新しいチャンネル材料の登場によって移動度が高められるようになるだろう。計測のコミュニティー(計測に関わる学会、研究機関、組織等々)は、これらの計測要求に応えるために継続した研究開発を行う必要がある。Characterization(物性を把握すること)や計測は、トランジスタを製造するために用いる特殊なプロセスに対しても対応すべく、その裾野を広げてゆかなければならないことを認識することが重要である。IC 製造業者は、様々に異なった設計を使用し続ける。そして、トランジスタの設計は、IC 製造業者の差別化をする重要なファクターとなっている。これらの差別化の良い例が、PMOS のプロセスと設計である。2重ストレス膜の手法は、非常に優れており多用されているが、ソース、ドレイン中に SiGe を用いる手法も IC 製品に使用されている。トラン

ジスタの断面を調べることによって、各 IC 製造業者で様々のスペーサ酸化膜厚(および構造)やプロセスが使用されていることが明らかになっている。

本節では、シリコンウェーハ、洗浄、熱酸化および薄膜形成技術、ドーピング(ドーパントの導入あるいは注入)技術、FEP 用プラズマエッチングに特有な計測ニーズを検討する。リーク電流の制御、しきい値の低電圧化とゲート遅延の短縮、それらの許容度といったプロセスインテグレーションの課題が、ゲート絶縁膜の厚さ、ドーパントの分布、接合深さ、ドーズ量といったプロセスパラメータの許容範囲と密接に関連している。プロセス許容度のモデルを作ることは、トランジスタの計測を考える上で、依然として重要な要件である。FEP における計測の目標到達レベルを表 MET5、解決策の候補技術を図 MET5 に示す。

Table MET5a Front End Processes Metrology Technology Requirements—Near-term Years

Grey cells indicate transition years of technologies.

Cell colors indicate this is an overarching metrology for metal gate thickness and composition that are critical challenges during the long-term years.

Year of Production	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DRAM 1/2 Pitch (nm) (contacted)	65	57	50	45	40	36	32	28	25
MPU/ASIC Metal 1 (M1) 1/2 Pitch (nm) (contacted)	68	59	52	45	40	36	32	28	25
MPU Physical Gate Length (nm)	25	22	20	18	16	14	13	11	10
Surface control limits for trace metals for bulk silicon and SOI top silicon layer. FEP Table 68 Critical GOI metals (concentration in atoms/cm ²)	0.5x10 ⁰	0.5x10 ⁰	0.5x10 ⁰	0.5x10 ⁰	0.5x10 ⁰	0.5x10 ⁰	0.5x10 ⁰	0.5x10 ⁰	0.5x10 ⁰
EOT (Extended planar bulk) for High Performance MPU/ASIC for 1.5E20 doped Poly-Si [FEP Table 69]	1.1	0.5		-	-	-		-	-
EOT (FD-SOI) High Performance MPU/ASIC for metal gate [FEP Table 69]				0.7	0.6	0.55	0.5	0.5	0.5
EOT (multi-gate) High Performance MPU/ASIC for metal gate FEP Table 69					0.8	0.7	0.6	0.6	0.6
Low operating power EOT (bulk) for 1.5E20 doped poly-Si FEP Table 69	1.2	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5			
Low operating power EOT (multi gate using metal-gate) FEP Table 69					0.9	0.9	0.9	0.8	0.8
Low operating power EOT (FD-SOI) (metal gate) FEP Table 69					0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
±3σ dielectric process range (EOT) (nm)	±4%	±4%	±4%	±4%	±4%	±4%	±4%	±4%	±4%
EOT measurement precision 3σ (nm) [B]	0.0044	0.002	0.0028	0.0024	0.0024	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022
Gate Dielectric Elemental Composition including Nitrogen Concentration Metrology for Patterned Wafers Precision (at%)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Capacitor structure	Cylinder / Pedestal MIM	Cylinder / Pedestal MIM	Cylinder / Pedestal MIM	Cylinder / Pedestal MIM	Cylinder / Pedestal MIM	Cylinder / Pedestal MIM	Pedestal MIM	Pedestal MIM	Pedestal MIM
Dielectric constant	40	43	49	65	78	98	130	130	98
t _{eq} at 25fF (nm) t _{eq} = 3.9*E _t *(total capacitor area)/25fF [G]	1.15	0.9	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3
DRAM stacked capacitor dielectric physical thickness (nm) calculated using t _{eq} and dielectric constant	11.79	10	10	10	10	10	10	10	7.5
±3σ process range	±4%	±4%	±4%	±4%	±4%	±4%	±4%		
DRAM capacitor dielectric physical thickness measurement precision (nm/3σ) [C]	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
Uniform channel concentration (cm ⁻³), for Vt=0.4 [W]	25-50 E18	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Dopant atom	P, As, B	P, As, B	P, As, B	P, As, B	P, As, B	P, As, B	P, As, B		
Metrology for junction depth [based on drain extension] of (nm) Note change to different structure for 2008	125	11	10	9	8	7			
Extension lateral abruptness (nm/decade) [M]	25	23	2	1.8	1.8	1.4			
Lateral depth spatial resolution for 2D/3D dopant profile (nm)	25	23	2	1.8	1.8	1.4			
At-line dopant concentration precision (across concentration range) [D]	4%	4%	4%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Metrology for metal gate thickness and composition*									
Metal gate work function for bulk MPU/ASIC [E _{cv} -f _m (eV)] [***] FEP Table 69		<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2			
Metal gate work function for FDSOI MPU/ASIC [f _m -E _i (eV)] NMOS/PMOS FEP Table 69 [***]				±0.15	±0.15	±0.15	±0.15	±0.15	±0.15
Metal gate work function for multi-gate MPU/ASIC FEP Table 69 [***]					midgap	midgap	midgap	midgap	midgap
Metal gate work function for bulk low operating power [E _{cv} -f _m (eV)] FEP Table 69 [***]		<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2			
Metal gate work function for FDSOI and multi-gate LOP FEP Table 69 [***]					midgap	midgap	midgap	midgap	midgap
Metal gate work function for bulk LSTP [E _{cv} -f _m (eV)] [***]		<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		

Table MET5a Front End Processes Metrology Technology Requirements—Near-term Years

Grey cells indicate transition years of technologies.

Cell colors indicate this is an overarching metrology for metal gate thickness and composition that are critical challenges during the long-term years.

Year of Production	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DRAM 1/2 Pitch (nm) (contacted)	65	57	50	45	40	36	32	28	25
MPU/ASIC Metal 1 (M1) 1/2 Pitch (nm) (contacted)	68	59	52	45	40	36	32	28	25
MPU Physical Gate Length (nm)	25	22	20	18	16	14	13	11	10
Metal gate work function for FDSOI and multi-gate LSTP [$\phi_m - E_f$] (eV) NMOS/PMOS FEP Table 69 [***]						+/-0.1	+/-0.1	+/-0.1	+/-0.1
Elemental Composition Metrology for Metal Gate on Test Wafers Precision (at%)		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
Elemental Composition Metrology for Metal Gate on Test Wafers Precision (at%)		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Elemental Composition Metrology for Metal Gate on Patterned Wafers Precision (at%)		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
Elemental Composition Metrology for Metal Gate on Patterned Wafers Precision (at%)		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Starting silicon layer thickness (SOI) (fully depleted) (tolerance $\pm 5\%$, 3s) (nm) PIDS requirement in FEP Table 69 [M]				5.5	5.2	4.5	4	3.5	3.2
SOI Si thickness precision (3s in nm)				0.028	0.026	0.023	0.020	0.018	0.016
Metrology for stress/strain in channel and active area									
Spatial resolution (nm) of off-line stress measurement at 50 MPa resolution	5	4.4	4	3.6	3.2	2.8	2.6	2.2	2
Spatial resolution (nm) of in-line stress measurement at 50 MPa resolution	65	57	50	45	40	36	32	28	25
Throughput of in-line stress measurement (Wafers/hour at 25 sites/wafer)	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Table MET5b Front End Processes Metrology Technology Requirements—Long-term Years

Grey cells indicate transition years of technologies.

*Cell colors indicate this is an overarching metrology for metal gate thickness and composition that are critical challenges during the long-term years.

Year of Production	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DRAM 1/2 Pitch (nm) (contacted)	28	25	22	20	18	16	14	13	11
MPU/ASIC Metal 1 (M1) 1/2 Pitch (nm) (contacted)	28	25	22	20	18	16	14	13	11
MPU Physical Gate Length (nm)	11	10	9	8	7	6	6	5	4.5
Surface control limits for trace metals for bulk silicon and SOI top silicon layer. FEP Table 68 Critical GOI metals (concentration in atoms/cm ²)	0.5x10 ¹⁰	0.5x10 ¹⁰	0.5x10 ¹⁰	0.5x10 ¹⁰	0.5x10 ¹⁰	0.5x10 ¹⁰	0.5x10 ¹⁰	0.5x10 ¹⁰	0.5x10 ¹⁰
High-performance EOT (Extended planar bulk)									
High-performance EOT (FDSOI) MPU/ASIC for Metal Gate									
High-performance EOT (multi-gate) MPU/ASIC for metal Gate FEP Table 69	0.6	0.6	0.55	0.55	0.55	0.5	0.5	0.5	0.5
Low power EOT (bulk)									
Low operating power EOT (multi Gate using metal-Gate) FEP Table 69	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
Low operating power EOT (FD-SOI) (metal Gate) FEP Table 69	0.8	0.8	0.7						
$\pm 3\sigma$ dielectric process range (EOT) (nm)	$\pm 4\%$	$\pm 4\%$	$\pm 4\%$	$\pm 4\%$	$\pm 4\%$	$\pm 4\%$	$\pm 4\%$	$\pm 4\%$	$\pm 4\%$
EOT measurement precision 3σ (nm) [B]	0.0024	0.0024	0.0022	0.0022	0.0022	0.002	0.002	0.002	0.002
DRAM stacked capacitor structure including electrodes	Pedestal MIM	Pedestal MIM	Pedestal MIM	Pedestal MIM	Pedestal MIM	Pedestal MIM	Pedestal MIM		
DRAM stacked capacitor electrodes (near term)									
Capacitor dielectric constant	130	98	91	78	78	70	80		
t_{eq} at 25 fF (nm) $t_{eq} = 3.9 \times E_0 \times (\text{total capacitor area}) / 25 \text{ fF} [G]$	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.25	0.2		
DRAM stacked capacitor dielectric physical thickness (nm) calculated using t_{eq} and dielectric constant	10.00	7.50	7.00	6.00	6.00	4.49	4.10		
$\pm 3\sigma$ process range	$\pm 4\%$	$\pm 4\%$	$\pm 4\%$	$\pm 4\%$	$\pm 4\%$	$\pm 4\%$	$\pm 4\%$	$\pm 4\%$	$\pm 4\%$
DRAM capacitor dielectric physical thickness measurement precision (nm, 3s) [C]	0.04	0.03	0.028	0.024	0.024	0.02	0.02		

Table MET5b

Front End Processes Metrology Technology Requirements—Long-term Years

Grey cells indicate transition years of technologies.

*Cell colors indicate this is an overarching metrology for metal gate thickness and composition that are critical challenges during the long-term years.

Year of Production	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DRAM 1/2 Pitch (nm) (contacted)	28	25	22	20	18	16	14	13	11
MPU/ASIC Metal 1 (M1) 1/2 Pitch (nm) (contacted)	28	25	22	20	18	16	14	13	11
MPU Physical Gate Length (nm)	11	10	9	8	7	6	6	5	4.5
Uniform channel concentration (cm^{-3}), for $V_T=0.4[\text{V}]$	NA	NA	NA	NA	NA				
Dopant atom	P, As, B	P, As, B	P, As, B	P, As, B	P, As, B				
Metrology for junction depth [based on drain extension] of (nm) Note: change to different structure for 2008	-	-	-	-	-				
Extension lateral abruptness (nm/decade) [M]	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD				
Lateral depth spatial resolution for 2D/3D dopant profile (nm)	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD				
At-line dopant concentration precision (across concentration range) [D]	2%	2%	2%	2%	2%				
Metrology for metal gate thickness and composition*									
Metal gate work function for bulk MPU/ASIC $ E_{\text{cv}} - \text{fm} $ (eV) [***]									
Metal gate work function for FDSOI MPU/ASIC $ E_{\text{fm}} - E_{\text{f}} $ (eV) NMOS/PMOS FEP Table 69 [***]									
Metal gate work function for multi-gate MPU/ASIC FEP Table 69 [***]	midgap	midgap	midgap	midgap	midgap	midgap	midgap	midgap	midgap
Metal gate work function for bulk low operating power $ E_{\text{cv}} - \text{fm} $ (eV) [***]									
Metal gate work function for FDSOI and multi-gate LOP [***]	midgap	midgap	midgap	midgap	midgap	midgap	midgap	midgap	midgap
Metal gate work function for bulk LSTP $ E_{\text{cv}} - \text{fm} $ (eV) [***]									
Metal gate work function for FDSOI and multi-gate LSTP $ E_{\text{fm}} - E_{\text{f}} $ (eV) NMOS/PMOS [***]	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1
Elemental Composition Metrology for Metal Gate on Test Wafers Precision (at%)									
Elemental Composition Metrology for Metal Gate on Patterned Wafers Precision (at%)									
Si thickness for multi-gate (nm) FEP Table 69	6.5	6.0	5.4	4.5	4.2	3.8	3.5	3.2	3.0
SOI Si thickness precision (3s in nm)	0.0325	0.03	0.027	0.0225	0.021	0.019	0.0175	0.016	0.015
Metrology for stress/strain in channel and active area									
Spatial resolution (nm) of off-line stress measurement at 50 MPa resolution	22	2	18	16	14	12	12	1	0.9
Spatial resolution (nm) of in-line stress measurement at 50 MPa resolution	28	25	22	20	18	16	14	13	11
Throughput of in-line stress measurement (Wafers/hour at 25 sites/wafer)	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Table MET5a と MET5b の注:

[A] SOI ウェーハを使うには計測技術の開発が必要。

[B] 計測精度は $P/T=0.1=6\sigma$ 計測精度/プロセスレンジから求められる。計測要求値は SiO_2 膜と電氣的に等価な膜厚を示している。HF 系酸化膜等の高誘電体膜は、65nm ハーフピッチのロジックデバイス以降で導入される予想されている。高誘電率膜の物理膜厚は、比誘電率 ($\epsilon_{\text{High-}\kappa}/\epsilon_{\text{ox}}$) と EOT を掛けることで求められる。例えば 6.4nm の Ta_2O_5 ($\kappa=2.5$) は EOT=1nm (SiO_2 の $\kappa=3.9$) である。表にある精度は EOT 換算であり、対象の高誘電率膜の精度を知るには比誘電率を掛けなければならない。スタックの総容量には誘電率膜に界面層が含まれ、チャンネル部の量子効果とポリシリコンゲートの空乏層の成分も含まれる。従って、ゲート誘電体の膜厚測定の課題には、界面層の計測技術も含まれている。

[C] MIS 構造の場合、物理膜厚 t_{diel} は $t_{\text{diel}} = (\text{eq.ox} - 1\text{nm}) \times \epsilon_{\text{High-}\kappa}/3.9$ 式で求めることができ、熱処理時にポリシリコンと高誘電率膜の界面に形成される酸化膜を考慮に入れる必要がある。MIM 構造の場合、物理膜厚 t_{diel} は $t_{\text{diel}} = \text{eq.ox} \times \epsilon_{\text{High-}\kappa}/3.9$ で求めることができる。ここで、eq.ox は SiO_2 換算膜厚であり、 $\epsilon_{\text{High-}\kappa}$ は高誘電率膜の比誘電率である。

[D] 統計的エラーの少ない状態で高精度に測定する必要がある。

FEP 計測におけるデバイスの微細化の衝撃は、デバイスおよび材料の研究がナノサイエンスと関係する材料特性に依存する点に現われている。例えば、FINFET の FIN ような形状のナノワイヤーの特性は二次元系の中に量子化されて現れている。

シリコンウェーハ (Starting Materials) — シリコンウェーハに関連した計測技術の課題は、SOI、歪 Si およびこれらの組合せのように新規な層状物質に関連している。何層もの界面を伴いつつ、進行する薄膜化によって、多くの材料計測技術には課題が提起されることになる。

関連する領域は次のようなものである：

- p+ウェーハ、SOI ウェーハ、歪 Si それに極薄 SOI ウェーハの Si 中にある Ni や Cu の測定
- 薄い SOI ウェーハのトップ Si 中の 10^9 - 10^{10} cm⁻³ の Fe (やその他の金属) の測定
- 非常に薄い SOI 層 (<20nm) の膜厚と均一性
- 薄膜中の欠陥密度 (例. 貫通転位や HF 欠陥)
- 層状物質の表面にあるパーティクルの検出 (<100nm)

微小パーティクルの検出は、今後に渡っての課題である。シリコンウェーハに対して、65nm 以下のパーティクル測定仕様にはサブ 65nm の計測技術を用いるのではなく、65nm パーティクルの検出値を基にして 65 nm 以下のパーティクル測定値を求めることになるということを指摘しておく。詳細については、FEP 章のシリコンウェーハ (Starting Materials) の節を参照されたい。

SOI (Silicon-On-Insulator) — SOI は IC デバイス要求の本流となりつつある。そしてロードマップに沿って発展していくと予想される。今までの鏡面シリコン基板のための材料仕様が SOI 仕様に移ることが期待される。しかし、SOI の下層絶縁膜構造では、鏡面シリコン基板に利用されている多くの計測の性能が低下する可能性が高い、従って必要なレベルでの SOI の材料特性の測定や制御をする事が出来ない。これは、SOI 計測にとって主要な課題であり、計測関係者はすぐに対応しなくてはならない。計測課題の詳細については、FEP の章のシリコンウェーハ (Starting Materials) の部分を参照されたい。

洗浄 (Surface Preparation) — 微粒子、化学組成、そして可能ならば微量金属の挙動を検出する為、in-situ センサがウェット洗浄装置に組み込まれつつある。微粒子検出は "歩留り改善の章" で取り扱われている。微粒子、欠陥と金属、そして有機汚染の解析は、本章の "材料と汚染の評価/解析" の節で述べられる。High- κ ゲート絶縁膜中の不純物の影響と、そのために生ずる計測に対する要求は今後の研究項目である。

熱酸化/薄膜形成技術 (Thermal/Thin Films) — Hf 系酸化膜は 2008 年のロジックデバイスから導入された。一方、ロードマップは、将来においてさらに高い誘電率材料の必要性を指摘している。その結果、代替ゲート酸化膜材料の開発が必要とされ、これら新しい開発に向けた計測に対するチャレンジも期待されている。高誘電率膜を用いたゲート積層構造を実現するには、さらに研究開発を必要とする複数の重要な課題が存在する。現状高誘電率膜中の窒素濃度の計測は難しい。ゲートの work function を調整するために用いる膜は非常に薄く、ナノスケールの表面粗さは、従来の計測手法を用いて計測できない程度の薄い実効的な膜として振舞うことが実証されるかもしれない。熱処理したゲート積層構造の材料物性は超高分解能の TEM を含め、あらゆる計測にとっての課題である。さらに加えて、混合された高誘電体膜や積層された高誘電体膜の極薄膜を使用する新しい DRAM 構造では、計測開発をチャレンジされるであろう。

計測の研究開発は、Ge や III-V 族を含め新たなチャネル材料の進歩にとって必要である。Si 基板との格子定数の不整合によって発生する欠陥を抑制して無欠陥の結晶構造を製造する際に、派生する課題を解決するための計測要求が強まってくる。バンドギャップ中の欠陥状態や転移の密度を観察、定量化することも計測に求められている。多くの計

測では、ブランケット膜を必要とする。この時期においては、ブランケット膜とトランジスタのチャネル層との計測の相関を取るには、トランジスタ構造全体を代表することは出来ないが、トランジスタの断面を用いることが必要になるだろう。

歪Siプロセス (Strained Si processes)—応力誘導プロセスに依るキャリア移動度向上はトランジスタ技術の重要な構成要素であり続ける。一般的にNMOSトランジスタは、 Si_3N_4 キャップ層のプロセス条件や厚みで引張応力を与えられる。PMOSトランジスタではさまざまな方法で圧縮応力を与えられる。ソース・ドレインの置換プロセスにおいては、ソース・ドレイン領域のシリコンを選択的に成長させたSiGeへの置換により、PMOSトランジスタチャネルに圧縮応力を得ることができる。二番目の方法は、圧縮 Si_3N_4 ストレスライナーである。STIはトランジスタチャネル内に圧縮応力を発生させるほかの方法である。Active Area, ゲート電極, コンタクトホールレイアウトは慎重に設計され、そのプロセスも厳しく管理されている。チャネル内のSiの結晶方位の選択は組み合わせ技術は既に提案されている。開発フェーズにおける新しいプロセスは、応力のキャラクタリゼーションと計測を必要としている。NMOSで検討されているSiC(Cを高密度に注入したSi)のソース・ドレインへの置換技術も含んでいる。SiCはNMOSのトランジスタチャネル領域において引張応力を誘起する。

パターンレイアウトの設計やプロセス条件決めを加速するために、ナノサイズでの応力の非破壊計測が強く望まれている。有限要素法による応力とそれに由来する電気的特性のシミュレーションは、既にプロセス開発と計測において重要な役割を示している。正確な応力計測はこれらのシミュレーションのキャリブレーションに役立つ。新しいプロセスが新しい世代に導入された時には、その技術課題もまた一新する。さらに複雑な技術課題は、歪みシリコンへの移行時期やFINFETS もしくはラップアラウンド(wrap around)ゲートの導入時期の見極めである。オフライン、インラインでの局所的な応力/歪計測に対する要求は、計測技術要求の表 MET5a, b に盛り込まれている。インライン応力/歪測定はテストパッドを用いて行われ、そのサイズは $100\mu\text{m}$ 角と推定される。

応力計測手法のレビューは図 MET3 に示す。これはオフライン破壊検査とインライン非破壊計測の立場から、空間的に局所計測の能力における Convergent Beam Electron Diffraction (CBED) のようなオフライン計測とインライン計測と差異を明確に表現している。この表は計測 TWG のこの項目における最初の結論で、他の技術分野からのインプットやコメントを期待したい。

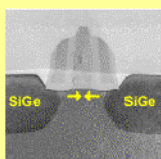
Area of Interest	Measurement Method	Sensitivity Stress	Strain	Measurement Area	Sample Thickness	
Transistor Level 	- CBED	20 MPa	0.02%	10-20nm	<100nm	Destructive
	- NBD	100 MPa	0.1%	~10nm	<300nm	Destructive
	- TERS	50 MPa	0.05%	<50nm		Destructive
						Non-Destructive
Micro-Area Level 	- Confocal Raman	20 MPa	0.02%	~150nm		Non-Destructive
	- XRD	10 MPa	0.01%	100um		
	- Photo reflectance Spectroscopy					
						<i>Handling Area of ITRS</i>
Die 	- Die level flatness - Laser Interferometry - Coherent Gradient Sensing					Non-Destructive
Wafer 	- Laser Interferometry - Coherent Gradient Sensing	10 MPa	0.001%	wafer		Non-Destructive
* Stress – Strain relation : need to be clarified TERS (Tip Enhanced Raman Scattering) CBED (Convergent Beam Electron Diffraction) NBD (Nano Beam Electron Diffraction) XRD (X-ray Diffraction)						

Figure MET3

Review of Stress/Strain Measurement Methods

FERAM —誘電体膜の厚さが 100 から 200nm であっても、新しい材料の組合せが使用されるときには、金属酸化物のインライン膜厚測定のための光学モデルを開発しなければならない。10¹⁶ 回以上の読み・書き込みサイクルでの容量部分の疲労劣化試験のための計測技術が第一に必要である。

メモリデバイスの断面構造は、最低二層のパターン構造(pattern on pattern)からなる複雑な三次元のメモリ構造のプロセス管理や製造に関しての技術課題を提供する。数々の計測に対するニーズは単純化したテスト構造ではまかなうことができない。合わせずれの深刻さを図 MET4 に示す。断面計測の 3 次元的計測精度は、メモリやその他 3D 構造をもつデバイスの主要な要求である。

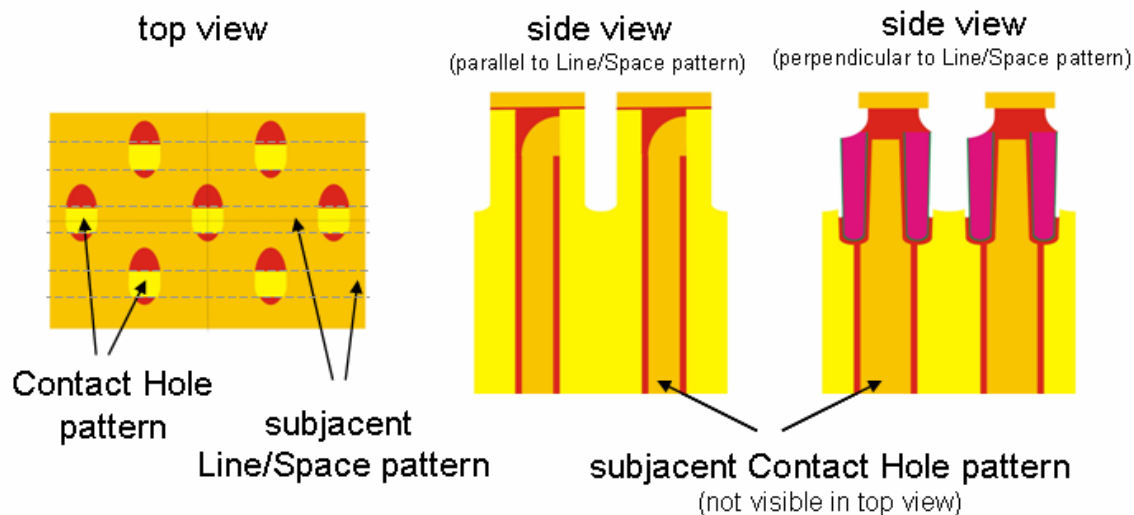


Figure MET4 3D Metrology Requirements

ドーピング技術 — 活性ドーパント注入を制御するために、65nm技術ノード以降に向けて、インライン測定技術を改良しなければならない。現在、高ドーズ注入のプロセス制御には4探針法が用いられ、低ドーズ注入にはサーマルウェーブ法 (Thermally Modulated Optical Reflectance) が用いられている。両手法ともに改善されねばならない。リアルタイム制御を可能とするドーズ量、ドーパントプロファイル、ドーズの均一性の直接その場測定ができる新しい測定方法の開発が必要である。B、P、As注入を制御するための新計測技術が必要で、X線/電子との相互作用に基づいたいくつかのB、P、As測定用インラインシステムが最近導入されている。オフラインであるが、SIMS (Secondary Ion Mass Spectroscopy) を用いれば、極浅接合などで現在必要とされる測定精度を達成できる。キャリアイルミネーション法 (光学技術) などの新しい非破壊測定法について、どの程度の可能性と能力を有するものであるかが、現在評価されている所である。2次元、可能ならば3次元のドーパントプロファイルを観測することが、次世代技術の開発には不可欠である。新しいドーピング技術を開発するためには、活性ドーパントのプロファイルとそのTCAD (technology computer-aided design) モデルの作成と欠陥の分布を知ることが必要となる。高真空中で行われるSSRM (Nanoscale Scanning Spreading Resistance) 計測は、不純物勾配 (分布) を観測するために必要な空間分解能を達成する能力があることが証明された。最近の結果によると、HV-SSRMは3~5%の精密さで、1~1.5 nm/decadeのキャリア濃度の計測能力があることが示されている。

FINFETのような2D/3D構造のドーパントの分布の測定は技術課題である。テスト構造を用いた *fin resistivity* のような間接的な方法はプロセス条件の変動を検出することができるが、ドーパント分布とその均一性の直接的な決定は困難である。

(訳注: キャリアイルミネーション (Carrier Illumination) 法とは、光照射によってキャリアを発生させ、より長波長のプローブ光で接合位置などを検出する方法。)

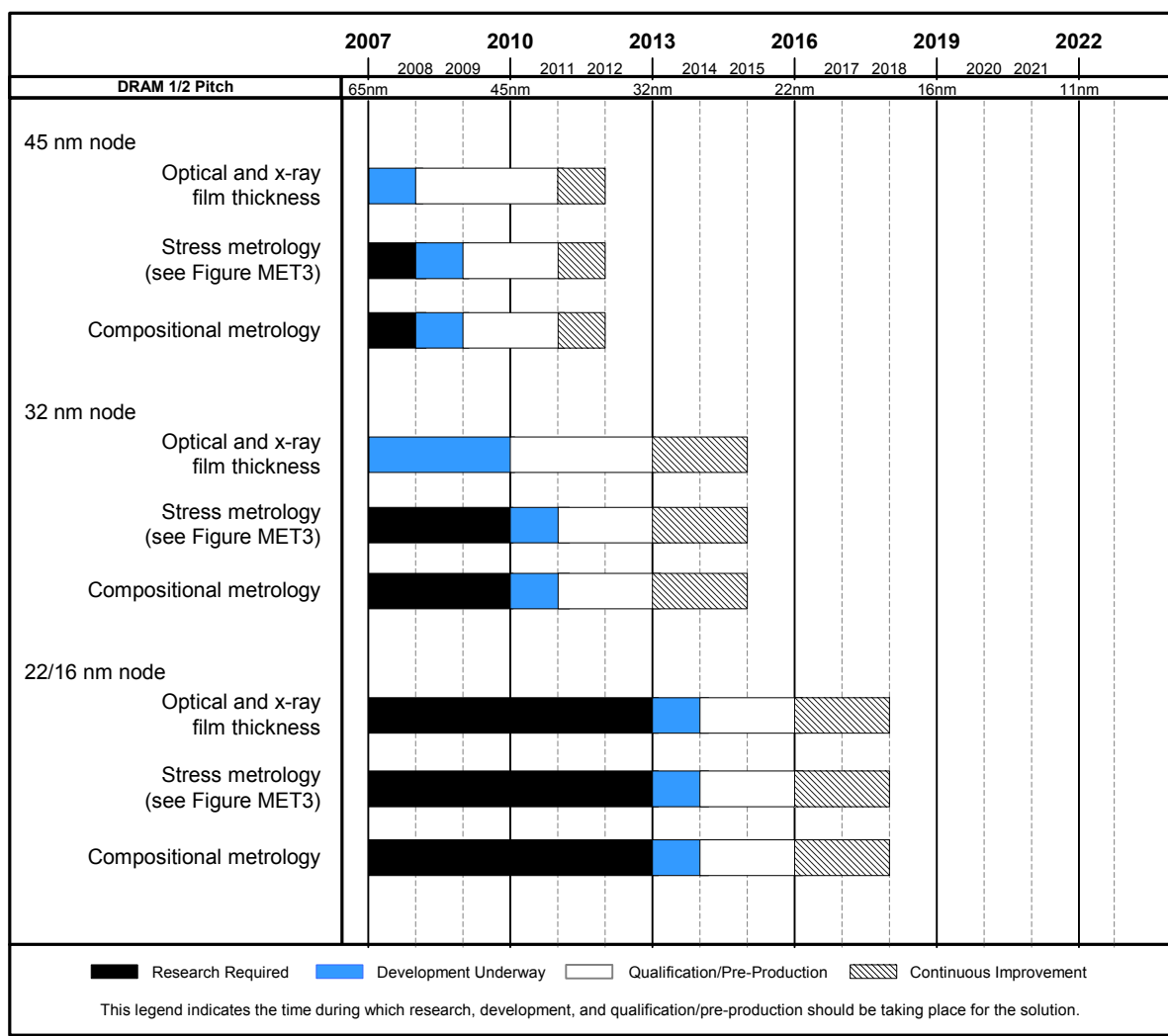


Figure MET5 FEP Metrology Potential Solutions

配線における計測（INTERCONNECT METROLOGY）

新規プロセス及び構造に対するメトロロジーの調査、開発は引き続き続けられている。既にポーラスな low-k 材は量産適応に移行しつつあり、3 次元配線は多様な用途に応用され始めている。Cu コンタクト技術は幾つかのシンポジウムにて既に報告されている。材料定性、インライン計測、先端設備とそれらのプロセス制御を含む全てのメトロロジーが、配線の研究開発及び量産に使われている。Cu コンタクトのような新たなプロセス信頼性についてはほとんど知見がない。今までと同じく、新規プロセス評価において信頼性テストは非常に重要である。

全ての IC 構造において、シリコンから基盤までおよび外界である箱と接続するのに配線が必須であり、中でもムーアの法則を半導体産業が維持するには、内部配線が技術的に性能上においては重大な障壁である。この障壁は技術とコストの両方の要素を持っている。技術的要素としては、アルミ/SiO₂ 構成から Cu/Low- κ への移行という範疇にとどまらず、単なる金属/誘電膜構成を凌駕するような、より次世代の配線構造へ向けたアプローチが必要である。コスト要素には、流行の技術を駆使したグローバル配線構造か、現役である金属/誘電膜接続構造を採用するか、二者択一という問題がある。いずれにしても、生産における高コスト化が予想される。コスト問題と技術障壁のせめぎ合いの中で、アルミ/SiO₂ 構成から Cu/Low- κ 構成への切り替えにおいて発生する独自の問題は、プロセス開発、製造確認、工程管理のための新しい計測技術の開発にとっても、重要な挑戦である。例えば、Cu/Low- κ においては、Cu と誘電膜の間のバリア

層の厚みを最小にして作りたい。これは結果として、測定試料の準備において、極薄膜層と「厚さゼロ」の領域の接合面に望ましくない影響が出て接合破壊が起こる事がないような、膜厚や詳細な特性値の測定をしたいといったニーズが生まれることになる。配線の計測(特性測定)が直面するもっとも挑戦的な課題のひとつは、トレンチとビアの側壁部分の測定能力不足である。次世代の配線(構造)への移行のオプションとして予想されることは、光配線における場合と同様の問題、たとえば非常に狭い導波路内部の光学特性を測定するとか、導波路内部の非常に微小な光学的欠陥を特定するといったような、新たな計測の課題を生む。新たに必要になった測定手法問題のうちいくつかは、既存のテクニックを応用進化させたかきこい方法や、新しい測定手法の発見によって解決された。しかしながら、いくつかの計測課題、特に難しいと指摘されている課題は、現状測定法やその発展形では手がつかない状態であり、解決策のめどがたっていない。

配線における計測の要求は、上述のとおり、既存の計測技術に対しては継続的发展を、また同様に、次世代の配線構造のために、革新的な計測技術開発への要求が高まっている。次の章では、最新の配線構造のための、現状の計測技術の状況とニーズについてと今後のあるべき方向性および将来動向について概要を記述する。オンチップ配線に加えて、3次元配線として知られるチップーチップ間配線に対する新たなアプローチも現れつつある。この段落では3次元配線におけるメトロロジーについて議論する。“配線”章を参照のこと。

・3次元配線における課題及びメトロロジー

Si 貫通ビア(TSV)はワイヤを使用すること無しに直接的にダイを接続する手法を提供する。相対的に大きなサイズであるにも関わらず、TSV 構造が高アスペクト比であるがゆえにエッチング及び埋め込みを困難にさせている。ウエハ同士をボンディングする際にまず最初のメトロロジーの課題がある。表面からウエハ裏面のマークを計測しアライメントすることが必要になり、このアライメントがボンディングの完成度を左右する。IR は Si を透過するので、赤外線顕微鏡は Si ウエハを透して裏面の目標構造を見て重ね合わせ量を計測することができる。走査型音波顕微鏡(SAM)もまた表面下に埋もれた構造を計測できる可能性がある。SAM はボンディングしたウエハ間のボイドあるいは欠陥を首尾よく観察することが出来る。X 線顕微鏡も Si 構造を透かして見ることもできるもう一つの方法である。これら全ての方法でより空間分解能の向上が要望されており、特に TSV の貫通穴サイズの(将来的な)シュリンクに対しては顕著である。この他にもさまざまな計測への要求が注目されつつあり、(例えば)応力測定や密着性強度(剥離)測定をあげることができる。TSV 計測要求リストには以下のものが含まれる。

- ・ 複数レイヤーから構成される TSV 深さ及び形状
- ・ 積層チップ間アライメント〜ウエハ単位の統合
- ・ ボンディング時の応力
- ・ ボンディング時の欠陥
- ・ メタル配線のダメージ
- ・ ウエハ間ビア内欠陥
- ・ 貫通ビアの高アスペクト比依存寸法課題
- ・ ウエハ薄化後のウエハ厚さ及び総合膜厚変動(TTV)
- ・ ウエハエッジを含めたウエハ薄化後の欠陥

Cu-Low-κ膜のメッキ配線問題と計測技術への要求

Cu メッキ配線の問題

Cu 配線は何世代にも渡って使われてきた。最近の Cu 配線は、トランジスタとタンゲステン接合していたものが Cu コンタクトにとって代わってきた。寸法シュリンクをする度に、トレンチとビアの埋め込みの課題に直面することになる。中でも一番重要なのは、電気メッキ炉の厳密な制御および中の電解銅の抵抗増加を招く非常に低レベルの不純物の同定が必要なことである。今では、我々は金属銅配線の信頼性がエレクトロマイグレーションとストレスマイグレーションによって劣化することを知っている。この劣化を引き起こす主たる要因は、配線 Cu と誘電膜とバリア層の間の接合面に沿って発生する表面拡散 Cu によるものである。メタルビアと配線の内部のボイドが甚大な歩留まり低下を引き起こす元凶であることが突き止められている。問題を起こすボイドは、成膜(CMP)アニール後に、微小ボイドが凝集して発生し、エレクトロマイグレーションもしくはストレスマイグレーションの発生で顕在化した。もうひとつの、ボイドに関係する重要な問題として、広いパターン領域を形成する Cu 配線のなかに単独で存在するボイドがあり、これが低信頼性の原因であることを確認できるようにする必要がある。これら単独で発生するボイドが、直接歩留まり低下を引き起こしているのを突き止めるのは大変だが、これが後々の信頼性不良の引き金になっている。これらのボイドは配線の表面に存在する場合もあるが、大抵は配線内部もしくはビア(孔)の中に隠れて居る。Cu メッキ配線におけるさらなる問題が、Cu 層と誘電膜の分離にある薄いバリア層で発生している。この極薄いバリア層によって超薄膜層の接合特性、欠陥および非常に細長いチャンネルの側壁の材料構造などの測定が絶対必要になった。

上記の問題は全て 90nm かそれ以降の Cu メッキ配線において重要になってくることが判った。半導体製造プロセスが 90nm 以降へ移行するときに上記の問題が再浮上すると共に、新たな課題も発生すると予想される。将来直面するであろう新たな課題を、今から全部予想する能力を我々は持ち合わせていないが、それでも、いくつかの問題は、現状の技術で微細化を進めると何がおきるかを、すこしは推定することができる。現状ではなんとか許容範囲にある計測限界を、将来技術とその技術的進化によって広げてやる必要があることは明白である。Cu メッキ配線における計測技術の将来への要求は、超薄膜の厚み測定がますます重要になっている、とくに側壁のバリア層の厚み測定が重要である。これら 2nm 以下の薄膜層の物理特性と構造の確立を可能にするだけでなく、膜中の典型的な欠陥を確認して見極めることも必須である。付随する問題領域に関する研究は広まっては居ないが、Cu とバリアもしくはインターフェースである誘電層の間の接合面のより微小な接合構造がますます重要になってきている。Cu 抵抗値が小さくなればなるほど、接合部に拡散が起きて細線抵抗が激増することが予想される。

Cu メッキ配線の計測

Cu の電気メッキシステムは、電気メッキされた Cu 膜で必要な特性を維持するために、メッキ槽での添加物、副産物および無機の内容物の中身の定量評価を必要とする。プロセス監視は、メッキ槽の経時劣化から生じる添加物、副産物、および無機物をメッキ最中(in-situ)で計測する必要がある。そのため、メッキ液槽のリアルタイム標本抽出による質量分析法が、新たな問題解決候補(Potential Solution)となった。交流電圧ストリップ法(CVS)が、メッキ品質上に必要な添加物と副産物の合体効果を測定するのに広く採用されている。液浸クロマトグラフィーによる定量分析法は、無機物をモニターすることで、分離不能な内容物や電気的には非導通で量のある内容物を、個々独立して測定できるので、Cu 計測に使うような大量の分析には役立つ。

バリア層の計測には膜厚、空間的均一性、欠陥および吸着の測定が必要である。3D 構造のインライン測定は、大きなギャップとして存在し続ける。Low κ のトレンチの側壁の材料の測定は、側壁に沿った方向のラフネスによってさらに困難にさせている。非常に薄いバリア層へ統計的な工程管理を適用するのには、すこし不安が残る。配線の技術的な将来要求は、バリア層 5nm 以下を示唆している。ITRS2001 が規定したプロセスウィンドウは総合で膜厚変動 20%以下のプロセス変動である。6nm 厚の膜の厳密な膜厚保測定精度(6σ)は 0.12nm 以下でなければならないが、これは現状の技術では出来ない。従来の統計的基準値(SPC)を使わなければ、この極薄膜があるかないかを知るだけなら、既存の技術でもなんとかなる。目下、シード Cu 下のバリア層で膜が水平に形成された部分だけは、いくつかの計測手法を適用して測定できる。この計測法には超音波計測法、X 線反射法、蛍光 X 線法などで、パターンウェーハに使える方法もある。配線における結晶粒界の大きさ(グレインの方向性)を決めるのに X 線回折法をつかう方法が提唱された。Cu

内部のボイドを検出するには、CMP とアニール処理直後がもっとも適する。Cu ボイド測定は項目の一部として、インラインでの Cu ボイド計測には多くの開発課題があることを、配線ロードマップで指摘している。しかしながら、多くがボイドの検出にのみに注力されており、プロセス制御のために必要な統計的なサンプリングにのっとったものではない。ボイド計測手法の多くは、Cu 配線総質量の変化を検出することにもとづいている。Cu 配線のチップにまたがる横方向の膜厚ばらつきの方が大きくて、前述の方法で確認できるほとんどのボイドはマスクされてしまう。配線を構成する多種の成膜材料が、広範囲な膜厚変化の発生に影響を与えているため、立体的な分解能を持ち、しかも高速の(製品ウェーハのための)多層膜の膜厚測定に断固として挑戦しなくてはならない。

Cu/バリア層の結晶構成(粒界方向)のインライン測定には、X 線回折法をベースにした計測手法を用いることができる。この技術をプロセスモニターとして使えるかどうかを現在評価中であり、電気特性と歩留まりとの関係を調査している。

配線工程における CMP プロセス後では、Cu 配線のディッシングとエロージョンの測定が必要とされる。現在は、光学式と超音波式の技術適用が模索されているが、量産の現場でディッシングとエロージョンをきちんと検出するためには、統計的なサンプリングの要求にも応えねばならない。

膜中に水成分を含んだ新材料および新構造の採用に伴って、その他の分野での計測的な課題としては、膜の化学的定量評価、機械的強度および剛性、局所的ストレス(対ウェーハストレス)、そして細線抵抗(対バルク抵抗)。付け加えるに、計測技術そのものの開発と並行して、校正方法と計測標準の開発が必要である。

測定技術は将来、化学機械研磨(CMP)において膜の水平方向の面の埋め込み/バリア膜の厚さの決定を *in-situ* で制御が可能になる。ポーラス Low- κ のポア(空孔)サイズの分布測定には、低角 X 線散乱法もしくはエリプソメーター法(エリプソ細孔測定法)を用いる。Cu 配線のボイドは現場でも検出できるようになったが、ほとんどの手法は Cu 配線の質量の変化をもとに測定している。しかしながら、CMP などのように、ウェーハ間で違いが起きるようなプロセス要因で、ボイドをマスクしてしまう場合がある。インラインでメッキ槽の化学的性質を制御する計測は実用化されている。

いくつかの計測項目についてはまだ良い方法が見つかっていない。例えば、サイドウォール上のバリア膜、Cu シード膜の膜厚は未だに計測することが出来ない。最近、サイドウォールの組織構造を結晶学的に計測する方法についての報告が出されている。接着強度については、未だに破壊検査により計測されている。多孔質 Low- κ 膜用の新しいエッチングストップ材に対応したエッチング終点検出技術が開発されなければならない。キラーとなるポア、ボイドの検出はまだ出来るようになっていない。

パターンサイズ縮小が加速されるのに伴い、オンチップ配線の開発と量産において高アスペクト比構造の計測技術開発がより重要な技術課題となってきた。配線プロセス開発においても CD 計測技術が重要な鍵となっている。多孔質誘電体で出来た非常に高いアスペクト比構造にも適用出来る CD 計測技術が必要であり、トレンチやビア/コンタクトの側壁に関する 3 次元情報が CD 計測に必要となっている。これらの計測は、下層の多層膜の影響によりさらに複雑となっている。

配線用の装置、プロセス開発及びパイロットライン生産のどの段階に於いても、パターン付き膜、パターン無し膜の両方の詳細な評価が求められている。現在、配線構造に係わるインライン計測の多くは、簡略化された構造を計測するか、もしくはモニタウェーハを計測するものであり、その多くは破壊検査である。超薄バリア層を含む構造の微細化により、現在の技術は進展を続けるであろう。電気的性能、歩留まりや信頼性と相関が取れるような CD 寸法や物理測定データを提供することが求められ、そのためには、計測技術の継続な開発が必要である。製造段階でより効率的かつ経済的な計測を行うためには、パターン付きウェーハを計測できるようにしなければならない。配線における計測の目標到達レベルを表 MET6 に、解決策の候補技術を図 MET6 に示す。Cu 配線中のボイド計測と Low- κ 膜中のキラーポア計測に関する新しい要求は実現困難もしくは不可能であるように見える。要求されているのは、素早く、インラインで非常に少

ない数のボイドと比較的大きいサイズのボアを観察できる技術である。主たる技術課題は表 MET6 で示したような割合のボイド、ボアについて統計的に意味のある情報をもつ計測方法を得ることである。

Table MET6 Interconnect Metrology Technology Requirements

Year of Production	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DRAM $\frac{1}{2}$ Pitch (nm) (contacted)	22	20	18	16	14	13	11
MPU/ASIC Metal 1 (M1) $\frac{1}{2}$ Pitch (nm) (contacted)	22	20	18	16	14	13	11
MPU Physical Gate Length (nm)	9	8	7	6	5.6	5	4.5
Metrology for maintaining planarity requirements: lithography field (nm $\times$ nm) for minimum interconnect CD (nm) [A]	500	500	500	500	500		
Measurement of deposited barrier layer at thickness (nm)	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1		
Process range ($\pm 3\sigma$)	10%	10%	10%	10%	10%		
Precision σ (nm) for P/T=0.1 [B]	0.017	0.015	0.013	0.012	0.011		
Metrology capability to measure Cu thinning at minimum pitch due to erosion (nm), 10% $\times$ height, 50% areal density, 500 μ m square array	8	7	7	6	6		
Detection of post deposition and anneal process voids at or exceeding listed size (nm) when these voids constitute 1% or more of total metal level conductor volume of copper lines and vias	22	2	1.8	1.6	1.4		
Detection of filler pore in ILD at (nm) size	22	2	1.8	1.6	1.4		
Measure interlevel metal insulator bulk effective dielectric constant (ϵ) and anisotropy on patterned structures [C]	≤ 1.8	≤ 1.8	≤ 1.6	≤ 1.6	≤ 1.6		
	21–24	21–24	19–22	19–22	19–22		

低誘電率 (Low- κ) 膜の課題と計測要求

低誘電率 (Low- κ) 膜の課題

配線構造において、 SiO_2 から他のより低い誘電率が得られる誘電膜へ移行することは、それが同程度であって、たとえ同程度以上でないとしても、半導体産業にとってはアルミから Cu への移行と同じくらいに難題である。Low- κ 材料の採用が前途多難とされる理由は、前任者の SiO_2 に比べて物理特性も機械特性もまったく異なっていることにある。材料内部にボアが存在するために機械特性が一番に大きく異なっている。機械的加工強度が低いために、新しい材料やプロセスを後工程 (バックエンド) で使った結果、実装・組み立てやパッケージングにおいてまで、新しい系統の問題を誘発してしまった。実現可能な実装とパッケージングのための、後工程の最終処理での材料を最適化するための、便利で有能な計測ツールと計測方法が無いことである。第 2 の問題はポーラス材料特性の同定である。現状では、飛びぬけて大きいボアや繋がってしまっているボア (致命ボアと呼ぶ) もしくは逆に材料内部でボアが小さすぎてしまったりするのを特定する、計測技術も計測方法論も無い。勿論、Low- κ パターンのサイドウォールでの材料特性を評価するための、物理特性、化学構造、電特性能を計測する有効な技術も無い。エッチングのプラズマとボアの密閉などのプロセスによって発生するダメージを、側壁の極薄膜の物理的な層の特性で定量化できるようにする必要がある。これら特性は、サイドウォール表面とそこに繋がっているポーラス材料との両方において、プロセス途中で定量評価できる必要がある。上記 2 つの課題については、誘電膜の標準的測定法の確立を促進し、それは今現在の誘電膜のためだけではなく、さほど遠い未来ではない数ナノメートル世代にも使われであろうことを記述しておく。

低誘電率(Low- κ)膜の計測

非多孔質 Low- κ 材を使ったプロセスでは、膜厚と CMP 後の平坦度が計測される。また、CMP の制御に in-situ センサが広く用いられている。多孔質 Low- κ 材の研究開発においては、計測はクリティカルな部分であり続ける。研究開発段階で使われた計測項目の中からいくつかのものを量産段階へ移行する必要があるが、どのようなものを移行するかは議論を要する。例えば、ポアサイズ分布の計測がこの中に含まれる。ポアサイズ分布はこれまで低角中性子散乱法や陽電子消滅法、エリプソメトリとガス吸着法を組み合わせた方法(エリプソメトリック・ポロシメトリ)、そして X 線低角散乱法(SAXS)によりオフラインで評価されてきた。SAXS とエリプソメトリック・ポロシメトリについては、量産でもライン内で使われ得るものである。これらの計測技術を量産ラインにも展開するという要求に対しては、現在可能性を評価中である。配線ロードマップにおいて、パターン加工された Low- κ 膜中の大きなキラーポアを検出することが、量産段階での計測で欠かすことの出来ない項目として強調されている。

Low- κ 材料とテスト構造の高周波計測については、40GHz までの計測技術が開発されている。そして、現状では 20GHz クロックが立ち上がってきたせいで、40GHz より上でもエッジが落ちてしまうため~100GHz にまで拡大する必要がある。広範囲にわたる評価の結果、配線技術関係者の間では高周波計測はもはや今後数年間においては危うい計測技術ではなくなった。Low- κ 材料は、関心の対象となる周波数範囲(1 GHz から 10 GHz)では一定の誘電率を持っているようである。

化学的機械研磨(CMP)時の多孔質 Low- κ 膜薄膜化を制御することが必要であり、パターン加工された多孔質 Low- κ ウェーハの平坦度を測定する技術が必要である。触針式プロファイラと走査型プローブ(原子間力)顕微鏡を用いることにより、局所的な平坦度とグローバルな平坦度を計測することが出来るが、スループットが低く改善を要する。リソグラフィプロセスの統計的プロセス制御に必要な情報を得るため、平坦度試験方法が標準機関により開発されている(開発継続中)。

エッチングプロセス制御のため配線特有の CD 計測手法をさらに開発する必要がある。エッチング後の清浄度、側壁のダメージ層とその特性を評価できる能力が大きなギャップとなっている。トレンチとコンタクトビア構造のサイドウォール角度やボトム寸法を知るため、高速な三次元形状観察技術が必要とされている。これは現状のインライン CD-SEM の能力を超えるものである。レジストパターンの CD 計測精度が十分でないため、エッチバイアス量の決定は困難なものとなっている。一つの解決策として、スキヤトロメトリがある。この方法では M1(第一メタル配線)層などのレベルでは配線 CD 寸法平均値を高い精度で計測できる。しかし、上層のメタル配線層では精度が低下する可能性がある。加えて、スキヤトロメトリではコンタクトやビアへも適用範囲を拡大できる技術が必要となっている。電気的テスト構造については、パターン加工された Low- κ 膜の R-C 特性を評価する重要な手段であることに変わりはない。

Low- κ 膜の機械的特性の計測が、材料の候補を絞り込むことができる。新しい Low- κ 材料においては常にこの計測は必要とされる。その他のギャップとしては、微細な開口をもつトレンチの中での応力測定技術が挙げられる。

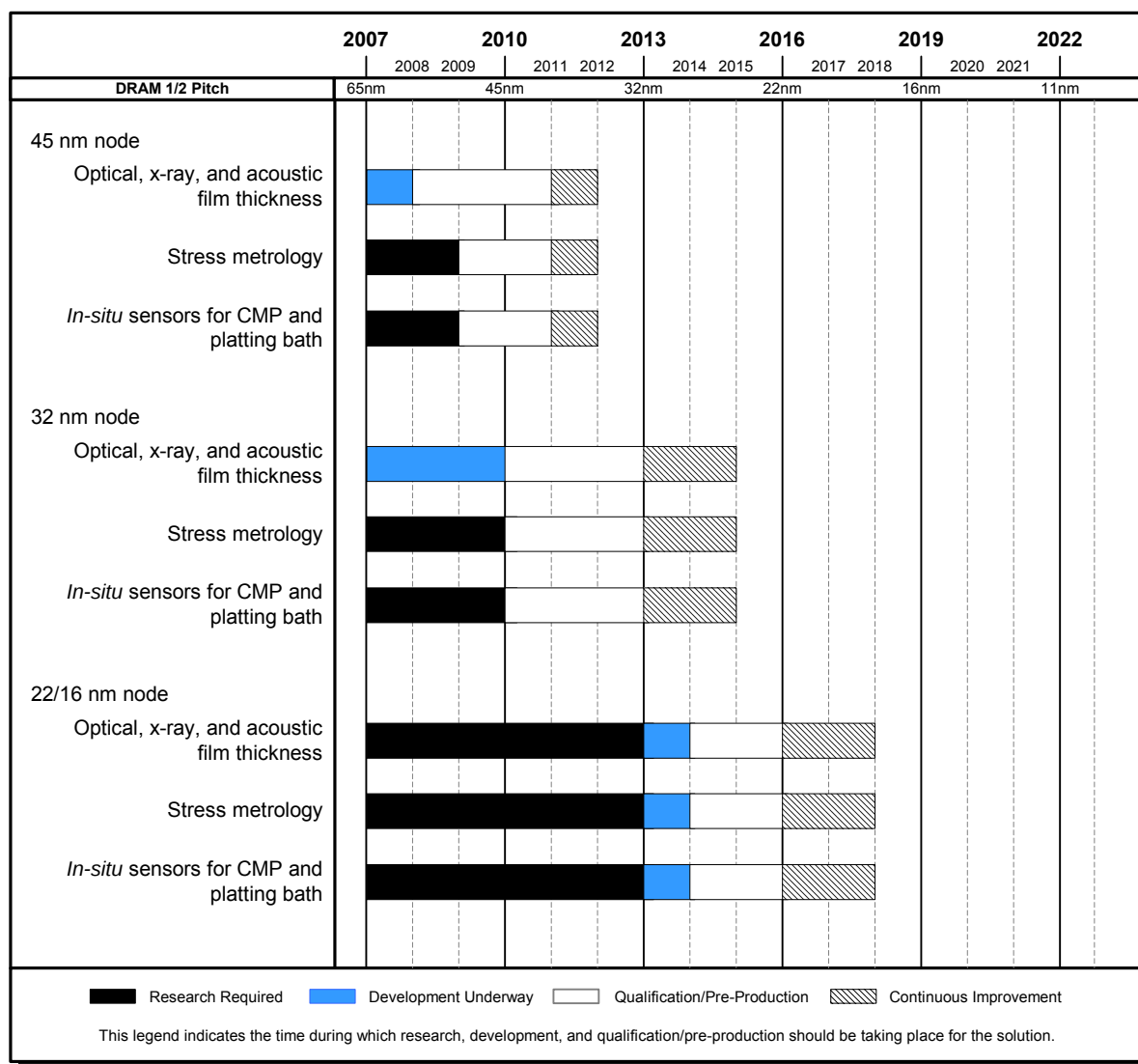


Figure MET6 Interconnect Metrology Potential Solutions

材料と汚染の評価・解析

急速な新材料の導入、微細化、新デバイス構造や低温プロセスの導入などにより、プロセス開発や品質管理に必要な材料解析や汚染の評価・解析が引き続き挑戦課題となっている。オフラインの評価・解析手法間での相関評価と、オフラインとインラインとの物理的・電氣的評価・解析手法の相関評価は、最終製品であるデバイスの特性と信頼性にとって極めて重要となる高精度な測定指標を実現する上で、しばしば重要となる。評価・解析の精度は、薄膜の厚さや元素濃度などの測定において、今後益々高精度な物が要求されてくる。評価・解析手法は、ウェーハ全面にわたって計測でき、かつクリーンルーム内で使用できるような技術を求めて開発が続けられるべきである。

現在用いられている膜はサブナノメートルレンジまで薄膜化が進みつつあり、現在入手可能な光学技術や光音響技術に更なる困難を与えている。インラインでの膜厚計測や組成元素検出についての技術課題を克服するべく、光の短波長化は、現在 X 線レンジまでに進んでいる。プロセス制御を完全に理解するため、多くの場合、相補的技術が必要となる。例えば、UV エリプソメータが膜厚、光学定数及びピンドギャップを測定できる一方で、X 線反射計測は薄膜の厚さと密度を計測することができる。

オフラインの評価・解析によって、しばしば、インライン計測では取れない情報が得られる。たとえば、透過電子顕微鏡法(TEM; Transmission Electron Microscopy)や走査型透過電子顕微鏡法(STEM; Scanning Transmission Electron Microscopy)は、極薄膜や界面層の断面を超高分解能で観察・分析することができる。STEMにX線分析や電子エネルギー損失分光法(EELS; Electron Energy Loss Spectroscopy)の検出機能を備えれば、界面の化学結合状態を知ることができる。高性能の二次イオン質量分析(SIMS)やその派生の飛行時間(TOF; Time Of Flight)SIMSを用いて、表面汚染や積層薄膜の分析ができる。微小角入射X線反射率測定法(XRR; X-Ray Reflectivity)を用いて薄膜の厚さや密度を測定することができ、微小角入射X線回折法を用いることにより薄膜の結晶構造に関する情報を得ることができる。XRRの測定においては、他の方法(TEM/STEM、SIMSやイオン後方散乱法)と比較することも含め、拡散散乱や特異散乱を利用することが界面モデルを組み立てる上で非常に重要であると考えられる。電界放射型電子銃を備えたオージェ電子分光(FE-AES; Field Emission Auger Electron Spectroscopy)によって20nm以下の大きさの粒子の元素分析が可能となっている。また、新しい材料を評価するためには、多孔質のLow-k絶縁体のボイド含有量、ポア(孔)サイズ、膜の接着性、機械的性質などの物理特性をオフラインで評価・解析できることが必要である。現在では300mmウェーハの全面までを解析できるこれらのオフライン装置が入手可能となっている。

TEMとSTEMについては画像取得法のさらなる改善・開発が望まれる。TEMやSTEMは、観察試料の加工が必要であるが、注意を払わなければ、これは画像ノイズの原因にもなりうる。STEMは環状検出器の検出角度によって、質量分布に感度の高いインコヒーレント像と、結晶方位や歪に感度の高いコヒーレント像とを選択することができる。いくつかの技術がHigh-kやLow-k材料とそのプロセス開発で利用されつつある。EELSは配向結晶の原子配列を観察する空間分解能を有するが、入射ビームの収束角度と検出系の集束角度(とりわけ、収差補正機能により可能となった高集束角を持つ装置において)の選択が必要である。この改良された空間分解能により、EELSをHigh-k膜とシリコン基板との界面領域等の評価・解析に使うことができる。ADF(Annular Dark Field)とEELSを装備したSTEMは半導体デバイス量産の評価装置としてより日常的に使われるようになってきている。しかし、日常の実デバイスの分析においては、結晶配列に沿ったチャネリングの発生する完全結晶とは異なり、アモルファス層や不規則な界面による走査相互作用の増大により、多くの場合空間分解能が制限される。より日常的な、FIB(Focused Ion Beam)による局所的サンプル加工は、一般的に100nm程度の厚みを持つが、フォトレジストの断面観察やゲートサイドウォール角度の計測などの特定用途に対して、これらの手法は十分である²⁶。より高度な使用法において、画像と分析に最適な空間分解能を得る為に、50nmより薄いサンプルが必要となるが、Arビームによるin situでのサンプル薄膜化技術は大きな進歩である。その結果、sub-100nm膜厚の自動サンプル作成が実用化されつつある²⁷。画像の再構成ソフトウェアの発達により画像分解能が向上し、界面画像の分解能も高くなった。レンズ収差補正や電子ビーム単色化といったTEMとSTEMにおける技術改善のうちのいくつかは、現在市販され入手可能となった。近年の収差補正STEMの飛躍的進歩はとても有望と思われ、接合領域で正しく配置されていない原子についての詳細を明らかにした。収差補正、単色ビーム及び高輝度電子源の組み合わせによって、カーボンナノチューブやグラファイトなど、壊れやすいサンプルの高解像分析の障害となるノックオンダメージ限界エネルギー以下に入射ビーム加速電圧を下げることによって、解像力を改善できる可能性がある。TEM/STEMにおける、これら全ての改善された解像力は、より薄いサンプルや表面のダメージ低減など、サンプル作製の改善が前提となる。現時点では一般的に時間が掛かりすぎるとされているが、電子断層撮影によるデバイス構造の3Dモデルは、計測技術の分野で重要な手法になりつつある。断層撮影法は再構築によってサンプル表面のダメージ層を取り除けることや、再構築規模を増大させるために、一般的に厚いサンプルが望ましいことなどから、サンプル作製は比較的容易である。

マイクロカロリメータ型と超電導トンネル接合型のエネルギー分散型X線分光器(EDS; Energy-Dispersive Spectrometer)を試作した結果では、非常に高いエネルギー分解能が得られ、従来のリチウムドリフト型シリコン EDS 検出器では不可能であったオーバーラップピークの分離が出来ている。このような新しいX線検出器はX線ピークのわずかな化学シフトを分解することができるため、局所的な化学結合状態などの情報を得ることを可能にするであろう。これらの技術は従来型 EDS やいくつかの波長分散型分光器に勝っており、クリーンルームに設置した SEM に装着して使用すれば、より微小な粒子や欠陥の元素分析が可能になる。これらの技術は、ベータサイトシステムがテスト中ではあるが、残念ながら、広く使われる状況には至っていない。これらの検出器はさらに、励起源として電子ビームや微小焦点X線のいずれか

を使用してマイクロ XRF システム内に実装することもできる。また現在、XPS(X 線光電子分光法)が 50nm までの薄膜の厚さと組成を見る方法として広く使用されている。

他の解析機器も含めこれらのオフライン装置を利用することによって、ロードマップを進める上で重要な情報を得ることができるが、まだ挑戦課題は多く残っている。High-k 材料を用いたゲートスタックの解析は、電気的特性を決めるための長さスケールが影響し、困難である。例えば、金属間化合物や合金を生成する反応による化学的な相互混合は、物理的な界面ラフネスと容易に混同されてしまう恐れがあり、またこのよう状況下ではマトリックス誘発効果や重なり合う信号などの影響によって評価が困難である。EELS や X 線吸収端近傍微細構造(XANES: X-ray Absorption Near Edge Structure)のスペクトル解析などの、局所的原子間相互作用を観察する様な解析技術が多くの場合必要となる。さらにデバイスの微細化が今後進行し続け、新しい非プレーナ型の MOS デバイスが開発されると、プレーナ構造デバイスを想定した解析方法が適用可能か疑わしくなってくる。さらに、スケーリングの進行により高アスペクト比化が進んだ構造中の汚染分析などはもともと難しいものとなる。

新材料の導入は汚染分析にも新しい技術課題をもたらす。たとえば、Cuメタライゼーションで起こる可能性が高いと考えられる相互汚染の分析には、 10^{10} 個/cm³のCuのバルク汚染の検出感度が必要となる。さらに表面汚染についても、ウェーハのエッジエクスクルージョン部やベベルといった領域まで分析する必要がでてくる。これらはすべてCuの拡散係数が高いためである。微細化の進行はまた、プロセスにおいて許されたサーマルバジェット(熱的許容度)を低下させる傾向にある。そうすると、金属汚染の挙動やその悪影響を低減するための方策を得るために汚染の評価・解析技術への要求も変化してくる。たとえば低温プロセスにおいては、どの汚染元素に注目しどの程度に制御や分析をしなければいけないのかということが現状とは違ったものとなる。重要な具体例として、カルシウムが非常に薄いゲート酸化膜の完全性に対して与える影響が上げられる。そしてこの元素を 10^8 個/cm³レベルで分析することは困難な技術課題となる。気相分解ICP-MS法などの従来技術ではこのレベル分析を行うにはブランク試料の日間変動による限界がある。さらに付け加えれば、低温プロセスは金属汚染のゲッタリングについても変化をもたらす。この変化によって、適切なゲッタリングを得るためには、金属汚染の評価・解析技術の確立が必要になる。

2007 の外ロロジロードマップでは、インラインモニター可能な汚染管理の新手法が開発されつつあると報告されている。汚染測定のため、リアルタイムサンプリング用のウェットケミカル槽を、質量分析ベースの検出器に取り付ける手法が提案された。しかしながら、この種のシステムはまだ広く活用されていない様である。

SOI(Silicon On Insulator)なしの歪みSiの使用が予想以上に加速したことは、新しい計測技術と分析方法への要求を、2003 年のロードマップよりも早める結果となった。これらの技術は、現在評価中、もしくは開発中である。もし、歪みSiをチャンネル構造に持つ基板がシリルSiやSOIウェーハの代わりに使われるようになれば、ゲート酸化膜の計測は一段と複雑になるであろう。歪みSiは、バルクSi上の厚く緩和されたSiGeバッファ層の上でも、またはSOI上の多層の薄いSiGe層からなる非緩和基板の上でも成長させられる。いずれにしても、基板の計測技術は以下のような多くのパラメータを管理する上で不可欠である。1) SiGeバッファの厚さとGeの濃度プロファイル、2) 歪みSiチャンネルの厚さ、3) Si/SiGeの界面とSiの表面の粗さ、4) Siチャンネル内のストレスの大きさや局所的なばらつき、5) Siチャンネル内の貫通転位の密度(望ましい転位密度は、 10^3 から 10^4 cm⁻²以下と極めて低いいため、高感度な測定が必要とされる)、6) 双晶や、転位のパイルアップ、または特にSiGe/Siチャンネル界面におけるミスフィット転位等その他の欠陥密度、7) チャンネルやバッファ内でのドーパントの分布(特に熱処理後)。

TEM は、マイクロスケールでの歪み Si の厚さや界面/表面の粗さを決定するのにまもなく使用されるであろう。歪みチャンネルデバイスの、歪み分布の測定やマッピングに、TEM/STEM を活用したいくつかの手法が開発されている。TEM サンプルの薄膜化は、歪みを多少開放してしまう可能性があり、薄膜サンプル加工中に歪みが開放される過程の理解には、有限要素サンプリングが有用であるとも言われているが、TEM/STEM による歪み測定は多くの成果を上げている。貫通転位とミスフィット転位の両方が TEMにより観測することができる。しかし、視野が限られているため、転位密度の統

計的分析が困難な場合が多々ある。原子間力顕微鏡(AFM)を用いれば、Si チャンネルの表面粗さを決定出来る。光学顕微鏡法は、エッチピット密度(EPD; Etch Pit Density)測定や、表面付近にある貫通転位の密度を決定するのに有効である。エッチの深さを選択するためには、EPD 画像の明確な解釈が必要である。EPD の光学画像における線や点の意味が説明される必要がある。X 線トポグラフィは、欠陥検出を行える、将来性のある新手の技術である。Ge やドーパント濃度のプロファイルは SIMS によって簡単に測定することができる。厚い SiGe バッファには高いスパッタレートが必要である一方、高い深さ方向分解能(できる限り低エネルギーのフローティングイオン銃を使って)は薄い Si チャンネルや、チャンネル/バッファ界面の分析を可能にする。スパッタリングで出来たクレータに照射する赤色ホトダイオードを使用した光学的キャリア励起法は SIMS でのチャージアップの問題を回避出来る。これは、SOI 上の歪み Si やドーパされていらない層の分析にとって特に重要である。

歪み Si に付随する特異的性質は、様々な計測方法をもって分析されてきた。ストレスは格子を歪め、これによって電子帯構造を変化させ、電子や正孔の移動度を高める。ラマン分光分析はストレスを、TEM と XRD は歪みを測ることができる。ラマン分光分析は Si チャンネル内での Si-Si 結合振動エネルギーを測定可能だが、これはこの結合振動エネルギーがストレスに依存するからである。しかしながら、フォノンの歪み電位法(Si-Si 結合のフォノンエネルギーの変動がストレスによるものであるとする)は薄い Si チャンネルには適用出来ない。薄い Si チャンネルに適用する場合、ラマン分光では、Si 基板までレーザー光が侵入するのを防ぐため、紫外レーザーを使った測定を行わなければならない。325nm の波長では光の侵入長が小さく、全てのラマン信号は薄い Si チャンネルから発生し、データ解析が行いやすくなる。波長が長いと、SiGe バッファ内の Si-Si 結合の振動まで現れ信号を複雑にする。SiGe 内の Si-Si 結合の振動のエネルギーは SiGe の組成比とストレスによるものであり、それが問題を複雑にしている。ラマン分光によるマッピングは、約 0.5 μm の最高分解能でウェーハ全域のストレス分布を与える。このようにして、移動度向上度についてトランジスタ間でのばらつきを予測することができる。マッピングの空間分解能は、固体または液体浸漬技術を用いて更に改善されることが望ましい。マイクロ XRD は小さな構造内のストレスの測定にも適用される。しかし現在測定スポットは 5 から 10 μm レンジのため、デバイス測定としてはまだ実現可能ではない。

Si の誘電率はストレスの関数となっているため、歪み Si チャンネルのエリプソメトリデータの解析は複雑である。この関係(圧光学または弾性光学テンソルを使って記述される)は、定性的には理解されているが、歪み Si チャンネルのエリプソメータにフィッティングを施すのに必要な、充分正確な定量データが欠けている。エリプソスペクトルの紫外部分だけを考慮に入れると、少なくとも十分に滑らかな表面なら、ゲート酸化膜の厚さを決定できる可能性が多少ある。粗い表面だと、表面の粗さのファクタが通常其自然酸化膜や、ゲート酸化膜解析時と同様の形で導入されてしまうので、新たな誤差要因となってしまう。正確なゲート酸化膜計測のためには、Si 表面の粗さはゲート酸化膜の厚さより 1 桁程度小さい値が必要である。これが通常のパルクシリコンウェハの場合だと条件を満たすが、歪み Si の場合、この条件を満たしていないので測定自身に問題がある。エリプソスペクトル中の可視部や紫外部を使う場合には、薄い Si チャンネル中での制限効果はまだ問題とはなっていない。原理的に見れば、エリプソメータは Si チャンネルの厚さだけでなく、その下にある SiGe バッファ層の Ge 含有量も決定できるべきである。しかしながら実際には、エリプソメータのデータから決定された Ge 含有量は少なすぎるが、それはおそらく Si 誘電率計算に歪みの影響を無視していることが原因であろう。エリプソメータでは、擬似多層の Si/SiGe のヘテロ構造の解析の方がずっとうまくいっている。

X 線反射率法は、歪み Si の厚さを決定できる、分光エリプソメトリとは代替可能な魅力的方法である。それというのも、X 線の屈折率は殆んど 1 で、ストレスの影響を受けないからである。10-20nm 程度の厚さの Si チャンネルだと、明確な干渉縞(時として、高角度側に、原因不明のピークが現れることがある)を得ることができる。しかしながら、市販のフィッティングルーチンを有したソフトウェアパッケージを使った Si チャンネルの厚さの解析では、常に正しい値が得られるわけではない(TEM との比較において)。おそらく、これは表面の粗さが関係しており、分光エリプソメトリより波長の短い光(X 線)を扱う X 線反射装置の方が表面粗さの影響を受けやすいことによる。X 線装置の信頼性やアライメント調整など実験に関することは、既に述べた High-k ゲート絶縁膜での測定時の注意と同様である。研究施設やシンクロtron X 線源を使

い、高分解能の3軸X線回折法がSiチャンネル中の縦方向(成長方向)のSi格子定数の決定及びストレス測定に成功している。

数々の顕微鏡観察法が研究、そして開発中である。これらには、ポイント投影顕微鏡(電子線ホログラフィー)や低エネルギー電子顕微鏡があげられる。低エネルギー電子顕微鏡は表面科学の研究に数年間使われてきた。この方法での材料分析や、インライン計測への適用可能性について検討することが必要である。これらの方法の議論は、本章の「顕微鏡観察(Microscopy)」の節で取り上げている。

計測において長期課題とされている5つの項目のうちの1つは、デバイススケールでの構造や組成の解析である。このニーズに応えるには、原子レベルでの組成や化学的分布の3Dマップを提供する材料分析法を発展させる必要がある。3Dアトムプローブやそれに類似した方法は、小さい針状サンプル(直径50-150nm)の原子間マップを提供できる可能性があり、このサンプルはFIBリフトアウト技術により作製できると思われる。LEAP(Local Electrode Atom Probe)技術はさらなる手法とデータ解析技術の開発が必要であり、非伝導性構造や伝導性と非伝導性を合わせ持つ不均一な伝導性構造の測定については、現状困難である。1つの課題は、データ取得の際に個々の元素について100%に近い検出を得なければならないということであろう。電子線トモグラフィはひとつの興味深い成長領域であり、STEMとTEM両方でチルトシリーズと焦点シリーズ法により推し進められている。収差補正されたTEMは、より細く強度の高いプローブを得ることによって、トモグラフィ解析に必要な高い分解能とSN比を実現でき、今後に期待されている。

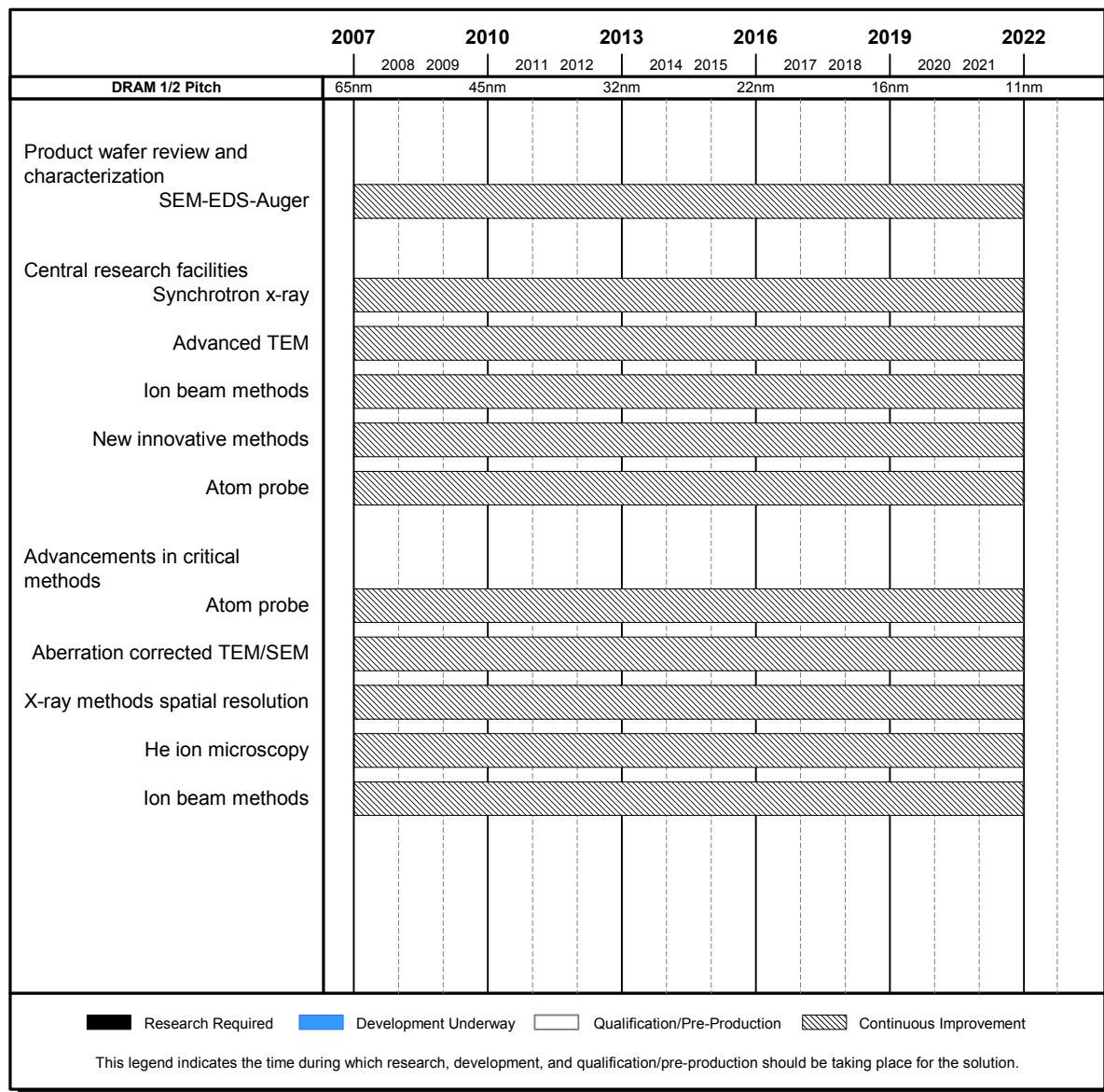


Figure MET7 Materials and Contamination Potential Solutions

標準計測システム

基準計測システム(RMS; Reference Measurement System) は一つの機器であるか、いろいろなアスペクトの寸法測定においていくつかの機器がそれぞれの性能によって互いに補完し合う一組の機器である。RMSは、応用物理、厳密な統計、測定誤差の適切な取り扱いなどのような寸法計測のための最良の科学技術に基づいて十分に評価されたものである。十分に評価されているために、RMSは生産のFABに置かれている他の装置よりも、多分桁違いに正確で、精度が高いであろう。²³ RMSはその他の測定システムがうまく折り合えるように十分に安定していなければならない。RMSはFABの計測装置間での測定の違いを追跡し、生産用計測器のパフォーマンスやマッチングを昼夜に渡り制御するために利用できる。²⁸

この機器に要求されたパフォーマンスや信頼性のために、RMS は FAB の他の装置よりも著しく高度の注意、精査、テストを必要とする。その測定によって、このすばらしい(“golden”) 機器は、生産に役立ち、コストを減少させ得る。しかしながら、これは、半導体プロセスの性質によって、この装置の中で測定されたウェーハをプロセスストリームに戻すことができるように、FAB のクリーンな環境の中になければならない 機器である。測定するウェーハは、他の FAB から届けられ、一企業内、あるいは複数企業を横断して in-house 標準として戻すことがある。

標準試料/標準物質

標準試料/標準物質は、一つあるいは複数のよく確定された特性値を有する形を持った物であり、計測機器を校正するために用いられる。標準試料/標準物質は、計測において非常に重要な役割を担う。その理由は、異なった計測方法で得られたデータ同士、(内部のあるいは外部の)設置場所の違う同種の装置によって得られたデータ同士を相互比較したり、モデルと実験結果との照合を行う際、その「物差し」となるからである。また、標準試料/標準物質は、装置の試験運転やベンチマーキングに非常に有用である。

標準試料/標準物質の概念には2つの要素がある。一つ目として、標準試料/標準物質は良く校正された物質であり、テスト計測において基準点を与える。また同等に重要なもう一つの標準試料/標準物質の機能は、テスト計測において機器計測の正確さを判定することである。最適な標準試料/標準物質は生産プロセスから出てくる製品である。テスト用計測ツール(TuT)は、標準試料/標準物質の特性(例えばライン幅)を正確に計測するために設計されている。標準試料/標準物質には、計測の正確さに影響を与えかねない、微妙だが重要なプロセス変化が含まれている。計測学者の責任において、TuTでの計測が困難である重要なプロセスばらつきが存在することを理解し、適切なサンプリングを行う必要がある。これらの標準試料/標準物質は、適切に検定され文書化された基準計測システムを用いて正確に計測されなければならない。²⁾

一次標準試料/標準物質は、複数の作製元から種々な形態や等級の物が供給される。このような標準は重要かつ便利であるが、適用範囲が限られていることが多い。というのは、使用者側の生産プロセスと異なる部分が多く、適切なプロセスばらつきが含まれていないからである。呼称は作製元によって色々である: 認証標準試料/標準物質(certified reference material, CRM)、コンセンサス標準試料/標準物質(consensus reference material)、NISTトレーサブル標準試料/標準物質(NTRM®)、或いはスタンダード標準試料/標準物質(standard reference material, SRM®)等がある²⁾。

(訳者注: ISOのVIM(国際計量計測用語集)には、標準物質(RM)と認証標準物質(CRM)が定義されている。RMの定義は、"機器の校正、測定法の評価、または物質の値付けに用いるために、単一または複数の特性値が十分に均一で良く確定された物質または材料"、CRMの定義は、"特性値の表現に用いられている単位の正確な現示へのトレーサビリティが確立され、かつ表記された信頼の水準での不確かさが各認証値に付されるという手続きによって、その一つまたは複数の特性値が認証された認証書付きの標準物質"とされている。; 本ロードマップでは、NIST(訳者注: 米国標準技術研究所、米国の国家計量機関)の用法が記載されている。NISTのRMに適合しており、CRMに適合している場合も有る。NISTのSRMは、ISOのCRMに適合している。) 米国標準技術研究所(NIST)は、半導体産業における計測科学の国家的な権威のある機関の一つとして、これまで国際的に認められてきた。民間の標準試料/標準物質の供給業者は、校正用に役に立つと思われる物質をNISTにおけるNTRMを開発するための認証システムに提出することができる。標準試料/標準物質の生産者は、NISTの認証システムの下で生産することによって、NISTによって確認された一連の物質に対してNTRMのトレードマークを付けることができる³⁾。

もう一つの取組みは、ASTM国際的なような権威ある標準推進組織の管理下で、複数の分析機関の試験結果を用いて、標準試料/標準物質の計測認証を行うことである。他国の国家計量機関(NMI)においても、相応しいと思われる、相談に値する標準を開発し、供給している。また、NISTを含む多くの先進的NMIでは、それぞれの国の計量標準を互いに相互承認できるように、あるいは、将来において重複して開発することを避けるために綿密な比較を通して同等性を保つための努力をしている⁴⁾。(訳者注: グローバル化した社会において、多国間に存在する通商における技

²⁾ NTRM® and SRM® acronyms are registered trademarks of NIST.

³⁾ Use of the NTRM mark on a subsequent series of artifacts, even of the same type, requires additional verification testing by NIST.

⁴⁾ Refer to The International Bureau of Weights and Measures' website <http://www.bipm.org/en/convention/nmi/>.

術的課題を包括的に解決する仕組みとして、国際度量衡委員会の下に「計量標準の国際相互承認 (Mutual Recognition)」という制度が提案された。これは基幹比較 (Key Comparison) に基づいて各国の国家計量機関 (NMI) の計量の技術能力を審査し、これに基づいて他国の計量のトレーサビリティを承認するというものである。一部であるが、半導体関連の計測技術においても基幹比較がすでに実施され、内容はウェブで公開されている。この制度は2004年より運用されている。)

² NTRMおよびSRMの頭字語はNISTの登録されたトレードマークである。

³ 新しい標準試料/標準物質にNTRMマークを使用する場合は、たとえ同類のものにても、NISTによる追加の確認試験を受ける必要がある。

⁴ 国際度量衡局 (BIPM) のウェブサイトを参考 <http://www.bipm.org/en/convention/mra/>

一次標準試料/標準物質やその計測認証に際し、以下のような技術的要件がある：

- ・標準試料/標準物質は、使用しても変化・変質せず、安定した特性値を保持できること；場所的・時間的な特性値の変動は、所望の校正の不確かさより十分に小さくなければならない。

- ・標準試料/標準物質を検定し認証するためには、規格化されたか、あるいは、詳細に文書化された手順に基づいて実施されなければならない。現在、満足な測定方法・手順が決められていない計測分野もある。基本的な測定方法・手順が確立されていなければ、標準試料/標準物質を作ることはいかならない。

- ・標準試料/標準物質を用いた現場での最終的な測定の不確かさは、標準試料/標準物質自身の認証値の不確かさと標準試料/標準物質を未知試料と比較した際の不確かさを含めたものである。このために、標準試料/標準物質の不確かさは最終的に必要な不確かさよりも小さくなくてはならない。目安として、半導体製造プロセスの評価・制御に用いられる装置を校正する場合、校正用標準試料/標準物質の認証値の不確かさは、生産プロセスばらつきの1/4より小さくなければならない。

- ・モデリングの入力データとして用いられるドーパントプロファイルのように、正確な測定が要求される場合には、標準試料/標準物質の認証値の正確さ（バイアスとばらつきの双方を含めた）は、要求されている最終的な正確さの1/4より良くななければならない。

- ・測定に携わるプロセスエンジニアには、標準試料/標準物質の取扱や取得結果の判断に間違いが生じないように、十分な教育・訓練を積ませなければならない。

- ・新世代技術を立ち上げるための測定を開始する際、特に材料開発やプロセス装置開発の初期には、“適切な標準試料/標準物質が利用できる状態になっていること”が非常に重要である。どのような標準試料/標準物質も、上に述べた様々な要件を満足するために、多くの課題を抱えている。

統合計測と先端プロセス制御 (APC)

先端プロセス制御 (APC: advanced process control) を通した生産性向上を可能にするために、計測は重要な役割を担っている。オフラインからインラインへ、さらにin-situ (その場) 技術に統合計測が向かうにつれ、より豊かで力強いプロセス制御の仕組みが実現可能となる。この点において、APCの進歩は主にR2R (run-to-run) 制御とFDC (fault detection and classification) 技術の成功により進んできたと言える。統合計測とAPCにおけるこれらの進歩はいくつかの点で偶然ではあるものの、本質的な進歩である。以下のことが明らかである。1) APCによりもたらす主な価値は半導体産業界で証明されており、たいいていの半導体製造メーカーである程度適用されている。2) APCの持つ能力、関連するセンサ、APCをサポートする計測技術が今日ではCMPやリンなどのキープロセスで利用可能となっている。3) しかし、真に内容の充実したAPC

生産戦略はまだ実現しておらず、工場規模での完全な展開を進める上でのセンサと計測装置の組み合わせ方法も出来上がっていない。とりわけ将来の技術世代で予測される材料、プロセス、デバイス構造の変化に対して。既にAPCによりもたらされた利益によって、新しいセンサと関連ソフトウェアの開発が進んでいる。これらにより近い将来、内容豊かな工場規模の解決策が出来上がるであろう。

APCは以下の2つの異なる推進力からなる。

1) プロセス推移の補正 — 装置の規則的なドリフト、製品のばらつき、プロセス挙動を補正するためにプロセスパラメータを調整することを狙いとしている。ここではR2R制御が支配的なドライバであり、プロセスばらつきに対し製品品質を維持する目的で、またノンプロダクトウェーハを減らす目的でインライン計測がフィードバック制御やフィードフォワード制御に使われる。これらはwafer-to-wafer や batch-to-batchでの制御を基本としている。プロセス中の推移補正用のin-situセンサとリアルタイムセンサを出発点としたリアルタイム制御は、十分な計測精度を持ち、よりプロセスに特化したセンサの更なる開発を一般的には必要としている。

2) 故障管理 — 装置問題の素早い見極めとその対応に目を向けたものである。主たる推進体はFDC (Fault Detection and Classification) であり、FDC では一般的な装置故障の検出、補修の指示や提案、製品不良の低減のため in-situ センサやリアルタイムセンサが使われる。加えて、次のような恩恵がある。センサと計測データが情報処理技術と組み合わせられることにより、より微妙な故障原因に対しても高度に洗練された故障分類が行えるようになり、装置の故障予測と保守スケジュールの見直しが可能になる。これにより装置効率、工場効率も向上する。R2R と FDC の成功による自信の高まりを頼りにして、これら 2 つの APC 要素の技術課題として、推移補正のための R2R 制御へのリアルタイム制御、並びにより幅広い故障管理への FDC 技術の拡張、が加わった。

フィードバック制御と多段階フィードフォワード単変数制御／多変数制御機能を含むR2R制御を広く実施する上で、今やインライン計測装置が支えとなっている。In-situリアルタイムセンサは原理的にはR2R制御を押し進めることが出来るが、リアルタイムでの故障検出に主に利用されており、リアルタイムでの推移補正への適用例は数が限られている(例：干渉法によるエッチングエンドポイント制御)。R2R推移補正とリアルタイムFDCの両方がもたらす経済的価値は、EEC (Equipment Engineering Capability) の進歩に通じている。すなわち、工場規模での情報共有、スケジューリングと運営を伴うAPCハードウェア、モデル、そしてアルゴリズムの幅広い統合をもたらす。これらの進歩はあるが、内容の充実したAPCシステムを利用可能にしていくには、APCに対する理解と受け入れ障壁を下げるためのセンサ、制御方式、新アプリケーション、ユーザーインターフェース改善に向けたさらなる研究開発が必要である。

R2Rがインライン計測に主に基礎を置いていることから、長期間のプロセスや装置のドリフト補正を行うことに有用性がある。その際、フィードバック情報を次ウェーハのプロセス設定条件の調整に使い、次工程の調整に同じウェーハのフィードフォワード情報を使うことにより製品の変動(ウェーハ間、ロット間など)を補正する。FDCの有用性は、in-situ情報(プロセス、装置、及びウェーハ)の評価を通して装置やプロセスの健全性を診断することによるものである。この評価はリアルタイムで起こるかもしれない。すなわち、プロセス中もしくはプロセス後にまとめとしての評価が完了する。後者の場合、インラインでのウェーハ計測はR2R制御と同様にFDCを推進するものとなる。R2R制御とFDCの活用と標準化、そして関連するインターフェース技術が増えることは、両技術の能力を相補的手法で合体した制御方式と、その解決策にも繋がるであろう。R2R制御とFDCは次のように統合されるであろう。1) データ保管のレベル: アプリケーション間でのデータ共有とデータマイニングの支援、2) ユーザーインターフェースのレベル: APC習熟期間の短縮とAPCによる工場の状態表示、3) 論理相互作用のレベル: R2R制御とFDCの持つ能力の相補的活用のための制御ルール(FDC結果によるR2R制御、並びにその逆)、4) 最後にアルゴリズムのレベルでは、FDCとR2Rのモデル、そしてモデリング手法の統合。上記項目の1)から3)は、工場規模の充実した生産戦略を実現する上で決定的なものとなるだろう。これら全ての項目をサポートする技術は未だ完成していない。工場規模の戦略を導く他の要素には次のもの、階層的制御の解決策、プロセス間の階段的(カスケード)制御、歩留まり管理アプリケーションとの連携、が含まれる。APC実現での別の鍵は、APCアプリケーション

ン間、そして外部との間での相互作用を決める標準を作り上げることである。これらのアプリケーション支援に必要なウェーハ、プロセス、装置に関するデータへのアクセスに関する標準作りも鍵となる。

APC による恩恵は統合計測への動きからもたらされる。R2R 制御では、オフライン計測によってかなり多くの恩恵もたらされる。例えばリソグラフィでの重ね合わせと CD 寸法制御による統合計測は次のようなものにより恩恵をもたらす。1) 制御ループ時間の短縮とそれによる制御精度の向上、2) 非統合計測の場合での人的要素、ウェーハ搬送にかかわる要素の排除、3) プロセスに対する計測の良い状態への調整、最適化、4) プロセス装置と計測装置へのレスピダウンドロードを通したマッチング過程の自動化。これらの項目の全てがスループットと歩留まりの向上へと導いてくれる。今のところ、統合計測は CMP(膜厚)だけで広く使われているが、エッチング(膜厚と CD)並びにリソグラフィ(CD)でも使われ始めている。リソグラフィでの重ね合わせ計測は、スループットを向上させかつ最小のスループット悪化での 100%サンプリングを達成するため、オフライン(スタンドアロン)計測からインライン計測へ進化しなければならない。オフライン計測からの置き換えとしてのインライン計測は、スループットを向上させサイクルタイムを短縮し、サンプリング量の増加(ウェーハ内の計測点数と同様にウェーハ枚数も)を可能とし、そしてフィードフォワード・フィードバック制御での時間遅れを減らすであろう。

大きなスケールでの統合計測が広まる前に困難な技術課題は解決されていなければならない。技術課題は以下の領域のものである。1) 統合計測の性能とコスト、これらはスタンドアロン計測に匹敵できるものでなければならない、2) 装置スループットへの影響(0を目指す)、3) 統合、4) データマネージメント、5) セットアップ(キャリブレーションとトレーニングを含む)と校正に要する時間と管理、6) メインテナンスのコストと難しさ、及びその装置稼働時間への影響、7) (スタンドアロン計測と異なり)統合計測の精度レベルが統合度と制御環境の関数であること、統合計測の重要な恩恵を生み出す上でスタンドアロン計測と同等の精度が必要ではないかもしれないことに対する理解。

リアルタイムのin-situセンサがどの程度定量的かつ精度高く出来るかによって、in-situセンサに追加することの出来るリアルタイム推移補正能力、短期間のランダムなプロセス変動を補正する能力が決まる。同様に、このことにより真にリアルタイムでのAPCが可能になる。リアルタイムでの応答性を持つin-situセンサは推移補正と故障検出の両方を押し進めることが出来る。リアルタイム推移補正が使えると新しいAPC階層構造が刺激され、そこでは調整式装置制御が長い間使われてきたようにリアルタイム推移補正と故障検出は装置(ユニットプロセス)レベルで動作する。インライン計測により見られた様に、リアルタイム推移補正はユニットプロセスの変動項目と結び付けられるが、R2R制御の恩恵は残るであろう。このシナリオでは、全体のAPC戦略の中でアルゴリズムと責任範囲が最適化され階層構造の中で計測情報が上位へあげられる(例えば、in-situセンサのデータがR2R制御の能力を高める)、という新しい制御階層が開発されるべきであることを示唆している。

In-situセンサ技術は完全なものからは程遠いままである。プロセスからの光学的、化学的、電気的信号を使った妥当なセンサ群を利用することが可能であるが、推移補正に必要な定量性を十分備えた計測技術を開発し実証することには限りがある。注目したいのは、この点において推移補正が故障検出に比べて量的に高い精度を要求している点である。特に、ウェーハを横切る方向の均一性と縦方向プロファイルを計測するin-situセンサが必要であり、もしこれらが入手可能なら、不均一性を直接補正するリアルタイム制御が行えるように装置設計に組み入れるべきである。

In-situリアルタイムセンサは装置の重要不良モードの検出と対応に広く利用されているが、より微妙な不良モードの原因特定とメインテナンス/補修スケジュールの最適化(故障の分類と予測のような)を行えるようにするためには、いつかはin-situセンサとインライン計測は幅広く調和し統合されなければならない。これは、予防的あるいは緊急の装置メンテナンスのための作業中止時間によって発生する経済的効果を算定する上で、重要な課題である。

In-situセンサは将来の技術世代で予想されている様々な複合材料、プロセス、そしてデバイス構造に対応するための技術課題増加に直面している。ALD(Atomic Layer Deposition)を適用したとしても超薄ゲート絶縁膜や金属バリア層の成

分、厚さ、均一性の計測は大きな技術課題である。ALDの材料と同様にその化学的性質は複雑で、その利点と生産スループットに対する要求との妥協点を見つけなければならない。ナノポーラスLow-k材と特にシリア層を含むその界面は、in-situセンサにとっては同等の技術課題である。製品品質に表面の化学的性質が大きな影響を及ぼすため、in-situ化学分析がますます重要になってきている(例えば、High-kゲート絶縁材、メッキ添加剤、CMP、Low-k絶縁材)。

APC と統合計測のすべての形態において性能だけでなく受容性を必要とするキーの要素は、データの品質である。不十分なデータ品質は APC システムによりプロセス性能を改善するどころか低下させてしまいかねない。従って APC の展開に当たっては、装置、計測器、センサから得られるデータ品質が許容レベルにあることがまず必要となる。データ品質の問題には、入手可能性、適時性(データ取得と引渡し)、精度、分解能、新鮮さ、そしてコンテキストの豊富さ(時刻記録含む)、が含まれている。有効な APC を展開するのに必要な最低限のデータ品質を見極めることは、データ品質の定量化という恩恵を APC システムにもたらすであろう。従って、有効に APC を支援するため、ロードマップはデータ品質に関する最低限の要求事項を、アプリケーション毎、技術世代毎に、確立する必要がある。キーとなるセンサ技術の要求項目に関しては、リンクが示されている。

オフライン計測法を用いた工場レベルでの APC が広く用いられ、品質を決定するには理論的に優れているかもしれないと考えられている一方で、狭まっていくプロセス許容値、新材料の導入、集積化スキームに対応するために制御の要求は目覚しく増加している。と同時に、工場生産性への要求は、応答時間の短縮や習得期間の迅速化に重きを置いている。よって制御スキームを最適化するには、APC、手法レベルの応用装置制御(AEC: advanced equipment control)、センサ、in-situ や統合やスタンドアロンの計測を組み合わせる必要がある。最適化されたスキームを工場へ供給するために必要なものは以下の3点である。1) ツールレベル AEC は、これまでの APC よりも安く早い代用物であり、かつ、確かさや精度の欠損が限定的であるべきである。2) 制御アルゴリズムは、マルチレベル、物理データ収集、解析、融合の理解できるように開発されるべきである。3) センサ技術は、コスト効率が良く、スタンドアロン、統合、in-situ 計測に利用できる広範囲のものを供給できるように開発されるべきである。

新探求材料とデバイスの為の計測

本節では、材料とデバイスの評価法と、新奇材料とデバイスの為のインライン測定の必要性に関して述べる(エマージング探索デバイスの章を参照のこと)。前回の ITRS の改定以後重要な発展があった。ITRS コミュニティがグラフェンに対して非常に興味を持った結果、その原子構造の観察や新規デバイスとして多様な電気的性質などに関して多大な進展があった。以下にこれについて要約する。本節は、3 次元原子イメージングと分光、走査プローブ顕微鏡法を含むその他の顕微鏡の必要性、ナノ材料の光学的性質および、新奇材料とデバイスの電気的評価、の小節から構成されている。

グラフェンの計測における進展に関する更新

グラフェンの材料、デバイスと計測法の開発の分野において多数の研究がなされつつあり、グラフェンの性質を知る上で、計測がキーとなっている。単層グラフェン(SLG)と複数層グラフェン(FLG)の特性は、グラフェンが置かれている基板の清浄度やFLGの積層配列に依存することは、現在広く認識されている。2層グラフェンの特性は、これらの2層間の積層形状や相互の回転方位に大きく依存する。グラフェンの特性を知る上で最も必要なものは層数を決定することである。このためには、低エネルギー電子顕微鏡³¹、ラマン分光法³²や、低空間分解能観察が必要な場合は、光学顕微鏡が利用できる。HR-TEMやSTMによりの原子レベルの表面構造を観察できる。^{31, 32} 2層グラフェン(BLG)間の回転方位のミスマッチは、HR-TEMやSTMにより決定できる。^{33a} SLG内の電子-正孔ポドル(鞍型バンドギャップ構造)は、1電子が観測可能な顕微鏡(単一電子のトランジスタをチップとして用いた顕微鏡)によって観察されており、基板のSiO₂膜の不均質性に起因することが明らかとなっている³⁵。この例から、デバイス全般の特性を決める上で基板の特性が重要であることが

分る。これらの電氣的な特性は、架橋されたSLG、単一ゲートと二重ゲート構造などの多様な構造に対して調べられている^{35, 38}。走査ケルビン顕微鏡を用いて、グラフェン直下のゲート電極によって誘起される静電ポテンシャル(静電ドーピング)を測定できる³⁹。グラフェンにおける量子ホール効果に関する新たな結果を用いて、SLGとBLGの違いが解明され、またp-nとp-n-p接合の効果が評価された。^{32, 33} STMを用いた量子ホール効果の新たな測定法によって、電気特性の高分解能マッピングが取得できる。この測定法により、トンネル磁気コンダクタンスの振動(TMCOs)の観察や、高エネルギー分解能(2.8 meV)で低エネルギー分散を決定することができる⁴⁰。最近の解説論文には、グラフェン計測に関するさらなる参考文献や考察が記載されている⁴¹。

3 次元原子イメージングと分光法

収差補正TEMとELS付きSTEM

収差補正レンズ技術はTEM及びSTEMに大きな変革をもたらした。市販のTEM、STEM装置は0.1nm以下の解像度が実証され、電子のエネルギー損失スペクトルでは原子列中の原子の位置が特定されている。収差補正STEM装置は結像の共焦点の性質を利用して、ビーム開き角が大きくなると焦点深度が浅くなることで、3次元での原子レベル解像度に近づきつつある。この技術は既にナノテクノロジーへ応用されている。最近、多層grapheneの積層構造内での欠陥に沿った単層grapheneの画像が得られた^{26, 28}。ナノテクノロジーにおける収差補正電子顕微鏡の成果には以下のものがある:

- ・単層graphene, 層のひだ(corugation)、そして欠陥の画像
- ・チタン酸カルシウム原子列中の単一ストロンチウム原子のELSスペクトル
- ・カーボンナノチューブ内にあるヨウ化カリウム結晶のカリウムとヨウ素原子両方の像
- ・ナドット内の原子移動の観察
- ・金のナドット触媒中の金原子とシリコン細線間の関係観察

収差補正の可能性をフルに引き出すことや、電子源のエネルギーフィルタ及びより高いエネルギー分解能といった、関連する進歩の達成により、ELSには画像化とスペクトルのモデリングが要求される。マルチスライスシミュレーションは、既にナノサイズの材料や他のデバイス用に改良されている。これらのシミュレーションが示唆することは、ナノワイヤ中の欠陥対の観察には複数角度での観察を要求していることである。電子線回折パターンに与えるナノ領域での影響も興味深い。

炭素を含む試料の顕微鏡観察には、カーボンナノチューブはもちろん単層grapheneにおいてもさらに困難なものである。上述した全ての進歩にも拘わらず、軟らかい物質の顕微鏡観察は極めて困難なままである。電流密度が増えるにつれ、分子状の試料では結合手がより簡単に切れてしまう。ELSの為の高いエネルギー分解能は分子状試料を理解するのに重要である。

3Dアトムプローブ

ナノワイヤー内のドーパント濃度の計測は困難である。3Dアトムプローブは、自由に建つワイヤーの原子構成を計測することを意味している。3Dアトムプローブは、小さな針状試料の原子毎の三次構造を再構築ができる質量分析器を搭載し改良型の電界イオン化型顕微鏡である(TEMの試料作成に通常的に用いられている集束ビームリフトオフ法や、化学/プラズマエッチング法によってデバイスのある一部を準備することができる)。3Dアトムプローブにおいては、針状の試料は、試料の先端からの原子をイオン化するための強い引き出し電界を発生させるための電極に近接して配置される。その電界によって、原子は試料から引き剥がされ、位置に敏感な質量分析器を通して加速される。試料の中の原子の元の位置は幾何学考慮から決定され、また原子の質量は飛行時間から決められる。非金属サンプルは困難であるが、最近ではレーザーパルスを印加すること手法による進歩を遂げている。3Dアトムプローブは我々に、三次元の原子マッピングの夢を現実近くに近づけてくれている。現在の検出効率はイオン化した原子の約60%であり、3Dモデルの元となる局所電界効果を解明することで、最近大きな進展を遂げてきた。

走査プローブ顕微鏡を含む他の顕微鏡の必要性

仮定 — 微細化が進む既存CMOSデバイスの構造及び局所的な特性を評価すると同様に、CMOSデバイス後の技術に対する計測上の要求を予想する必要がある。

高空間分解能な局所的特性のプローブ:可能性(Opportunities)

走査型プローブ顕微鏡(SPM; Scanning Probe Microscopy)は様々な局所的構造及び特性を計測するツールの基盤技術として開発されてきており、その分解能は 50-0.1nm に及ぶ。走査型容量顕微鏡、拡がり抵抗顕微鏡、導電性探針原子間力顕微鏡は、不純物濃度のプロファイル計測の為に最適化されてきており、不純物濃度に依存した空間分解能を有する。試料や探針に対する周波数依存信号、及び同時に2つ以上の周波数及び又はプローブによる同時摂動を含めた SPM における最近の進歩により、計測のレンジと分解能は拡張されている。

電荷と輸送に関連する局所的計測 — デバイス動作中、あるいは周波数に依存する測定の実行中のその場計測は、試料に対して複数の接触で可能になる。走査型インピーダンス顕微鏡、ナノインピーダンス分光法といった周波数依存性測定の一部は、電荷のトラップを含めた界面や欠陥の特性を数量化するための周波数レンジが8桁に及ぶ。局所的な規模での接触電位だけでなく、分子ナノワイヤ中の個々の欠陥もこれらの装置を用いて検出される。Tunneling magneto-conductance oscillationの計測原理に基づいたSTMは、現在grapheneの電気的特性をマッピングすることができる³⁵。走査型表面電位顕微鏡(SSPM; Scanning Surface Potential Microscopy、ケルビン力顕微鏡とも呼ばれる)は仕事関数に関連するもので、数10nmのスケールで材料の変動を容易にマッピングでき、電界効果型トランジスタ及び配線構造の評価に利用出来る。更に高いエネルギー分解能のところでは、メタル成膜前のHigh-k絶縁膜に起こる表面電位の変動を評価でき、メタル成膜後の界面の特性に見通しを与えてくれる。この手法の空間分解能が原子規模にまで拡張されうるといふ証拠が最近出てきている。

SPMと量子ドットを用いた最近の観察は、単一電子の検出が可能であることを示している。単一電子検出には低温が必要ではあるが、局所化された計測に対して更に高いエネルギー分解能化の可能性を示唆している。

スピンに関連する局所的計測 — 走査型プローブに関連するツール(磁気共鳴力顕微鏡)で、磁気プローブを使って単一スピンの検出が可能であることが示されている。更に開発が進めば、空間分解能に関する限界と、スピン分極研究の可能性が明らかになり、スピンに基づくデバイスの特性評価がなされるであろう。

低感度の磁気力顕微鏡はデバイス内の電流の流れをマッピングするのに利用出来る。磁気検出に制限があるのを一般的に使えるようにするには、標準的な商品として供給できる磁気探針の開発が必要である。

複雑な特性 — 恐らく有機物や生体分子成分を含む広範囲な材料群を巻き込む将来世代のデバイスには、付加的な特性の計測が要求される。様々な検出の構成において高い周波数を使うことで、局所的な誘電定数、電歪、圧電係数、スイッチング動作等が発生する。これらの計測は誘電体の特性評価だけでなく、キャパシタに基づくメモリの開発と複合デバイス構造に対しても重要である。

多重変調(Multiple Modulation)と複合化プローブ — 複数の計測を組み合わせることは、特性を分離する上で必要であったり、情報を最大にするのに役立つことがある。たとえば磁気力の測定時に発生し、測定を無効にし得る静電相互作用の例がある。表面電位を高い周波数で計測することにより相互作用を無くし、磁気力は低い周波数で計測することにより、相互作用は分離され定量化される。このアプローチは普遍化された計測ツールを作り出すのに応用できる。

高空間分解能の局所的特性用プローブ:技術課題(Challenges)

産業上の環境に於いて益々微細化されるデバイスと複雑な材料群にこれらの手段を実施する事への技術的課題は類似している。

全般的なアクセスのしやすさ(General Accessibility) — 研究室に於ける開発から商業化までに要する時間は、能力とアクセスのしやすさとの間の大きな隔たりに帰着する。このことは、デバイスの探求が High-k 絶縁膜の為の新しい材料を包含し、情報記憶オプションの探求及び CMOS 後の技術に目を向けることになるので、現時点で特に重要である。設計に費やす時間が 6 年台である企業もある。ロードマップの要求に合うように、アクセスしやすくする為の新しい仕組みが必要である。

高分解能化 — どのような場合に於いても、より高い空間分解能に向かう傾向は望ましい。SPMの中には、基本原理によって最終的な分解能が制限されるものもあるであろう。その他の最新的手段では、限界が未だ調べられていないものもある。SSPMや仕事関数分光に於ける最近の成果は、いくつかの複雑な特性のプロープに対して原子規模の分解能が可能であることを示唆している。そうであれば、新しい物理が出現し、出てきた結果への解釈を理論に要求されるであろう。

非弾性トンネリングや単一電子検出によって実証されているように、たいいていの計測のエネルギー分解能が向上する可能性がある。エネルギー分解能の最高値は低温下で達成されるが、利便性とは相反する。

探針技術 — 商業ベンダーは多くの特殊なSPM用カンチレバー及び探針を開発してきた。製造の再現性にはしばしば問題があり、良品チップの歩留が30%台の場合もある。もっと重大なのは、市販のカンチレバー/探針とツール開発に要求されるものとの間の隔たりである。ツール開発用の探針は、埋め込まれた電気回路や複雑な探針の形状を伴っているため、より難しくなっている。

校正標準 — ナノメーターサイズの構造物に対する校正標準の欠如は重要な問題である。特殊な環境下での高い空間分解能域では、原子構造を使うことが出来る。カーボンナノチューブは一般的な選択肢として提案され静電特性の校正に対して実証もされている。標準的な校正の手順は開発されるべきである。

ナノ物質の光学特性

ナノスケールの結晶材料、特に半導体の光学特性は、量子的閉じ込めと表面状態によって変調を受ける。物質の光学応答の基本的な表現は誘電関数である。誘電関数の虚数部は光の吸収に直接関係している。直接あるいは間接遷移型のバンドギャップを持つ物質において光学応答は、価電子帯の頂上から伝導帯へ電子が励起される臨界点(Critical Point)によって特徴づけられる。ある遷移は強い exciton のような性質をもつ。バルクから薄膜、ナノワイヤーとナノドットに移ることで、これらの遷移は変化する。

バルク試料の対称性はバンド構造と結合状態密度の両方に強く影響する。1次元、2次元または3次元における量子的閉じ込めは、臨界点のエネルギーと結合状態密度を変化させる。このようにナノサイズ物質に於ける誘電関数の虚数部の形は、結合状態密度の変化と閉じ込めによる新しい臨界点の出現によって変わる。直径22nm以下のシリコンナノワイヤーにおいて強い異方性、及び細線の軸に沿った偏光に対しての新しい吸収ピークの理論的予測は興味深い例がある²⁶。強い exciton (電子と電子孔の結合状態からなる準粒子(quasi-particle))の特徴をもつ光学的遷移の特性は、良く理解できていない、そしてナノスケールの物質におけるexcitonの役割の解明のためには、さらに理論的かつ実験的な取り組みが必要とされる。

新材料とデバイスの為の電気的特性評価

多くの新しいナノ電子デバイスは、負の微分抵抗⁵や履歴を持ったスイッチング^{6,7}といった従来には無い振る舞いを示す^{47, 48, 49}。新しい電気的測定方法と解析が、これらの新しい材料とデバイスの振る舞いを特性評価するのに要求されるであろう。移動度といった従来からある変数をナノスケールで抽出することは今よりもっと難しい課題である⁵⁰。新しいデバイス技術に対して最終的な性能を決定する変数が何であるかを決めることが重要である。更に、新しいデバイスのある種類の振る舞いは、既存のCMOSとは全く異なったメカニズムに基づいている。例えば、本質的に量子力学的な振る舞いをするデバイスもあれば、計算の状態を変えるのに電荷の輸送ではなく磁束の変化といった別のメカニズムによるデバイスもある。標準的なMOSFET構造とは異なる物理原理によって動く新しいデバイスの為に、主要なデバイス変数とその抽出方法を定義することが必要であろう。新しいデバイス構造及び回路の基本設計の安定性と信頼性を特徴付ける為の方法論を打ち立てることも必要であろう。

電気的なテストの方法論に於ける進歩に加えて、ナノメートルサイズの要素(個々の分子やナノメートルサイズの半導体量子ドットといったもの)と、探針やワイヤーボンドによって電気的に接続される大きな電極や導線とを、信頼性と再現性のある方法でつなぐ為の実行可能なテストストラクチャーが特に必要である。新しいナノ電子デバイスにおいて、リソグラフィの限界を超える大きさである構成部分への接触方法は、新しい材料とデバイスの電気的評価にとって恐らく最も大きな技術課題である。更に、特に有機材料で作られたナノスケールデバイスでは、金属配線と活性領域との間の界面を調べる為の評価用テストストラクチャーを開発することが必要である。従来には無い材料で作られたデバイスの金属配線系に対して、仕事関数、障壁の高さ、輸送過程といったパラメータを調査し明らかにする必要がある。*Emerging Research Materials* の章を参照。

参考文献

¹ SEMIP24-94, CD Metrology Procedures, 1994

Sampling

² B. Bunday, B. Rijpers, B. Banke, C. Archie, T. Hingst, I. Peterson, A. Vlado, M. Asano, "Impact of sampling on uncertainty: semiconductor dimensional metrology applications", Proc. SPIE 2008, paper 6922-31

³ SEMATECH/ISMI Advanced Metrology Advisory Group (AMAG)

⁴ B. Bunday, D. Michelson, J. Allgair, A. Tam, D. Chase-Colin, A. Dajcman, O. Adan, and M. Har-Zvi, "CD-SEM Metrology: Macro CD Technology—Beyond the Average," *Proceedings of the SPIE: Metrology, Inspection, and Process Control for Microlithography XIX* (2005), 111–126, 2005.

⁵ J.S. Villanubia, A.E. Vlado, and M.T. Postek, "A Simulation Study of Repeatability and Bias in the CD-SEM," *Proceedings of SPIE*, v5038, pp 138–149, 2003.

Lithography metrology

⁷ J. Allgair et al., Applications of image diagnostics to metrology quality assurance and process control, Proc. SPIE, Vol. 5042, 2003.

⁸ NIST Technical Note 1297

⁹ Bunday, Cordes, Oji, Piscani, Cochran, Byers, Allgair, Rice, Avitan, Pelinov, Bar-zvi, Adan, Characterization of CD-SEM metrology for iArF photoresist materials, Metrology, Proceedings of the SPIE, Volume 6922, pp. 69221A-69221A-17 (2008).

¹⁰ A.C. Diebold and D. Joy, "CD measurements for Future Technology Generations," Solid State Technology, June 2003.

¹¹ Bunday, B., Allgair, J., Lipscomb, P., Yang, K., Koshihara, S., Morokuma, H., Page, L., & Danilevsky, A. "Automated CD-SEM Recipe Creation: A New Paradigm in CD-SEM Utilization," Proceedings of SPIE Metrology, v6152, Chapter 1-B, 2006.

¹² Daniel Fischer, Geng Han, James Oberschmidt, Yong Wah Cheng, Jae Yeol Maeng, Charles Archie, Wei Lu, and Cyrus Tabery "Challenges of Implementing Contour Modeling in 32nm technology," Proc. SPIE Vol. 6922, 69220A (Mar. 22, 2008)

¹³ Uwe Kramer, David Jackisch, Robert Wildfeuer, Stefan Fuchs, Frank Jauzion-Graverolle, Gilad Ben-Nahum, Ovadya Menadeva, & Stefano Ventola. "CD-SEM Contour Based Process Monitoring In DRAM Production Environment". Metrology, Inspection, and Process Control for Microlithography XXII, Proc. of SPIE Vol. 6922, 69221C, (2008)

¹⁴ Advanced Litho Metrology Council (AMAG) & Films Metrology Council (FMAG) Presentations, Open Sessions, Day 1, February 20, 2008 (Technology Transfer #32344)

¹⁵ K. Patterson, J.L. Sturtevant, J. Alvis, N. Benavides, D. Bonser, N. Cave, C. Nelson-Thomas, B. Taylor, K. Tumquist, "Experimental Determination of the Impact of Polysilicon LER on sub-100 nm Transistor Performance," Metrology, Inspection, and Process Control for Microlithography XV, SPIE Vol 4344, 2001, 809–814.

¹⁶ SEMIP47-0307 Test Method for Evaluation of Line-Edge Roughness and Linewidth Roughness. March 2007

²⁰ J. S. Villanubia and B. D. Bunday, "Unbiased Estimation of Linewidth Roughness," Metrology, Inspection, and Process Control for Microlithography XIX, SPIE, Vol 5752, 2005, 480–488.

²¹ Characteristics of accuracy for CD metrology", G. W. Banke, Jr, Charles N. Archie, *Proc. SPIE Vol. 3677*, p. 291-308, Metrology, Inspection, and Process Control for Microlithography XIII; Bhanwar Singh, Ed., June 1999

²² M. Sandelbach and C. Archie, "Scatterometry measurement precision and accuracy below 70 nm", Proceedings of SPIE, Vol. 5038, Metrology, Inspection, and Process Control for Microlithography XV11, Daniel J. Herr, Editor, pp. 224-238, 2003

²⁴ New comprehensive metrics and methodology for metrology tool fleet matching", Eric Solecky, Chas Archie, Bill Banke, *Proc. SPIE Vol. 5752*, p. 248-258, Metrology, Inspection, and Process Control for Microlithography XIX; Richard M. Silver, Ed., May 2005

Reference Measurement System

²⁵ N.G. Oji, R. G. Dixon, A. Martinez, B.D. Bunday, J.A. Allgair, T. V. Vorburger. "Progress on implementation of a reference measurement system based on a critical-dimension atomic force microscope" J. Micro/Nanolith. MEMS MOEMS 6(2), 2007

²⁶ B. Rijpers, E. Langer, D. Verkleij, "Automated TEM sample preparation on wafer level for Metrology and Process Control, Proceedings of the 33rd International Symposium for Testing and Failure Analysis (ISTFA), 2007

²⁷ B. Rijpers, J. Finders, H. Suzuki, T. Fujii, Y. Yamazaki, H. Abe, F. Perez-Willard, Use of 3D Metrology for process control, Proceedings of SPIE Volume 7272, 7272-127, 2009

²⁸ Lauchlan, L., Nyyssonen, D. and Sullivan, N. 1997. Metrology Methods in Photolithography in Handbook of Microlithography, Micromachining, and Microfabrication Vol 1. P. Rai-Choudhury, ed. SPIE Engineering Press, Bellingham, WA.

Emerging Research Materials and devices

²⁹ H. Hibino, H. Kageshima, F. Maeda, M. Nagase, Y. Kobayashi, and H. Yamaguchi, Phys. Rev. B. 77, (2008), 075413

-
- ³⁰ I Calizo, D Teweldebrhan, W Bao, F Miao, N Lau, and A A Balandin, *Journal of Physics: Conference Series* 109 (2008) 012008 and P. Poncharal, A. Ayari, T. Michel, and J.-L. Sauvajol, *Phys. Rev. B* 78, (2008), 113407.
- ³¹ J.C. Meyer, C. Kisielowski, R. Emt, M.D. Rossell, M. F. Crommie, and A. Zettl, *Direct Imaging of Lattice Atoms and Topological Defects in Graphene Membranes*, *Nano Lett.* 8, (2008), 3582–3586
- ³² G. M. Rutter, J. N. Crain, T. Li, P. N. First, and J. A. Stroscio, *Scattering and Interference in Epitaxial Graphene*, *Science* 317, (2007), 219-222.
- ³³ J.H. Warner, M.H. Rummeli, Thomas Gemming, B. Buchner, and G.A. D. Briggs, *Direct Imaging of Rotational Stacking Faults in Few Layer Graphene*, *Nano Letters* 9 (2009), 102 – 106.
- ³⁴ F. Varchon, P. Mallet, L. Magaud, and J-Y Veullen, *Rotational disorder in few-layer graphene films on 6H-SiC(000-1): A scanning tunneling microscopy study*, *Phys. Rev. B* 77, (2008), 165415.
- ³⁵ J. Martin, N. Akerman, G. Ulbricht, T. Lohmann, J.H. Smet, K.von Klitzing, and A. Yacoby, *Nature Physics*, 4, (2008), 144-148.
- ³⁶ Y. Zhang, Y.-W Tan, H.L. Stormer, and P. Kim, *Experimental observation of the quantum Hall effect and Berry's phase in graphene*, *Nature* 438, (2005), 201.
- ³⁷ J. R. Williams, L. DiCarlo, C. M. Marcus, *Quantum Hall Effect in a Gate-Controlled p-n Junction of Graphene*, *Science* 317, (2007), 638.
- ³⁸ B. Özyilmaz, P. Jarillo-Herrero, D. Efetov, D.A. Abanin, L.S. Levitov, and P. Kim, *Electronic Transport and Quantum Hall Effect in Bipolar Graphene p-n-p Junctions*, *Phys. Rev. Lett.* 99, (2007), 166804.
- ³⁹ R. Geer, private communication of recent results.
- ⁴⁰ D.L. Miller, K.D. Kubista, G.M. Rutter, M. Ruan, W.A. de Heer, P.N. First, J.A. Stroscio, *Science* 324 (2009) 924-927.
- ⁴¹ A.C. Diebold, *Metrology for Emerging Materials, Devices, and Structures: Graphene as an Example*, *Frontiers of Characterization and Metrology for Nanoelectronics 2009*, AIP Conference Proceedings, in press.
- ⁴⁷ J. Chen, M.A. Reed, A.M. Rawlett, and J.M. Tour, *Science*, 286, 1550–1552 (1999).
- ⁴⁸ C.P. Collier, G. Mattersteig, E.W. Wong, et al., *Science* 289, 1172–1175 (2000).
- ⁴⁹ Richter, C.A., D.R. Stewart, D.A.A. Ohlberg, R.S. Williams, *Appl. Phys. A*, 80, 1355–1362 (2005).
- ⁵⁰ S.-M. Koo, A.-F. Fujiwara, J.-P. Han, E. Vogel, C. Richter, and J. Bonevich, *Nano Lett.*, Vol. 4, 2107–2111 (2004).